股票简称：长电科技　　证券代码：600584　　股票上市地点：上海证券交易所

江苏长电科技股份有限公司

重大资产购买报告书

（草案）

主要交易对方名称	住所与通讯地址
Singapore Technologies Semiconductors Pte Ltd	**60B Orchard Road #06-18 Atrium @ Orchard, The Singapore (238891)**

独立财务顾问

北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

2014 年 12 月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确和完整，并对本报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。

本次交易为公开市场要约收购，交易对方未就所提供信息的真实、准确、完整出具承诺。

中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本报告书有中文版及英文版，若英文译本与中文有异，以中文版本为准。

重大事项提示

本部分所述的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、本次交易方案概述

1、本公司与产业基金、芯电半导体将通过共同设立的子公司，以自愿有条件全面要约收购的方式，收购设立于新加坡并于新加坡证券交易所上市的星科金朋的全部股份。本次要约的对价将以现金支付：每股星科金朋股票收购价格为 0.466 新元。

若附生效条件的要约公告后，目标公司股票发生除权、除息等事项，则要约人保留对于要约价格进行相应调整的权利。

本次要约的总交易对价为 7.80 亿美元，约合 10.26 亿新加坡元（按照 2014 年 12 月 19 日美元对新元汇率中间价：1 美元折合 1.31505 新元计算）。

2、鉴于台湾地区对于陆资企业投资台湾半导体相关行业企业有一定的政策限制，而本次要约收购的同时，若不进行台湾子公司重组，收购完成后目标公司的台湾子公司将被陆资企业所间接控制。为避免对本次要约收购的实施产生影响，经长电科技与目标公司及其控股股东协商，拟在本次要约收购的同时进行台湾子公司重组。具体方案如下：星科金朋持有 52%股权的台湾子公司 SCT 1 向星科金朋收购其持有 100%股权的台湾子公司 SCT 3，收购对价约为 1,500 万美元，收购后 SCT 3 成为 SCT 1 的全资子公司。星科金朋将在新加坡设立一家新公司“Newco”，将 SCT 1 的 52%的股权以 7,412 万美元的对价转让给 Newco 持有，并获得 Newco 向其发行的股份；星科金朋再以减资的方式，向所有股东派发 Newco 的全部股权和总计约 1,500 万美元的现金，从而剥离台湾子公司，上述减资不会导致星科金朋发行在外的股份的注销，亦不会导致其总股本发生变化，仅会导致每股净资产减少。星科金朋的股东可以选择获得现金或者 Newco 的股份，但控股股东 STSPL 承诺将选择接受 Newco 的全部股票。Newco 的股票不会在任何证券交易所上市。上述台湾子公司重组构成星科金朋的减资，需经星科金朋股东大会审议通过，并经新加坡法院批准。根据中国台湾地区的相关规定，上述台湾子公司重组的相关事宜需经中国台湾地区投审会批准。此外，星科金朋两家台湾子公司之一 SCT 1 为台湾上市

公司，星科金朋持有其 52%的股权，星科金朋向 Newco 转让该部分股权需向投审会申请豁免 Newco 的要约收购义务。在台湾子公司重组的同时，SCT 3 将归还欠星科金朋的 1.27 亿美元的债务；同时，为保证台湾子公司重组后平稳过渡，星科金朋将与台湾子公司签署业务合同。

3、考虑到本次交易将导致星科金朋控股股东发生变化，星科金朋将根据其现有银行贷款及发行在外的优先票据的相关条款约定进行债务重组。截至本报告书出具之日，长电科技已经为可能发生的相关票据提前赎回或贷款提前偿还进行了债务重组安排，长电科技已与星展银行就债务重组安排签署了委任函，星展银行将通过向目标公司提供上限为 8.9 亿美元的过桥贷款对目标公司进行债务重组，该过桥贷款额度将足够覆盖目标公司全部的债务重组需求，后续星展银行将通过退出贷款及协助目标公司发行债券的方式进一步对目标公司的债务进行替换。

同时，为了配合上述债务重组并替换星科金朋现有的部分债务，星科金朋拟向所有股东配售永续证券，该永续证券规模为两亿美元，星科金朋控股股东 STSPL 承诺将认购最高两亿美元的永续证券并按约定时间缴纳认购款项。长电科技拟出具担保承诺，若星科金朋三年后仍无法赎回上述永续证券，永续证券持有人有权将所有永续证券出售给长电科技，长电科技作为永续证券担保人将按照出售价格偿付包括永续证券本金及所有应付未付的利息。但在任何情况下，永续证券持有人均不可在三年内要求向长电科技进行出售。上述担保须经长电科技股东大会审议通过，并在永续证券发行后生效。

4、根据新加坡的相关法规，若有效接受要约的目标公司股权占目标公司表决权达到 90%，则要约人可以执行法定强制程序，收购剩余股权；如果收购的股份比例未能达到前述比例，则目标公司无法实现退市。

5、2014 年 11 月 5 日，本公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了向星科金朋发出不具有法律约束力的收购提议的议案，拟收购星科金朋所有发行的股份。基于上述收购提议，星科金朋及其控股股东 STSPL 同意与本公司进行排他性谈判，并在此基础上进一步就收购提议进行磋商。2014 年 12 月 20 日，本公司第五届第二十二次临时董事会审议通过了本次交易涉及的《共同投资协议》等相关议案。2014 年 12 月 26 日，本公司第五届第二十三次临时董事会审议通过了本次重大资产收购的相关议案，拟向星科金朋发出附生效条件的要约。

6、星科金朋控股股东 STSPL 已向要约人出具了不可撤销承诺函，承诺无条件且不可撤销地以其现在持有的以及未来可能持有的全部星科金朋的股份接受本次要约。

7、由于本次收购的目标公司在新加坡注册，系国外独立法人实体，与本公司不存在股权关系，且本公司目前尚未完成对目标公司的收购，难以获得目标公司按照中国企业会计准则编制的详细财务资料进行审计，因而无法提供按照本公司适用的中国企业会计准则编制的目标公司财务报告及其相关的审计报告。

根据目标公司公开披露的年报和定期报告，目标公司 2012 和 2013 财政年度的财务报表按照新加坡财务报告准则（Singapore Financial Reporting Standards, FRS）进行编制，并经 PricewaterhouseCoopers LLP（普华古柏会计师事务所有限合伙）进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告；目标公司 2014 年财年前三季度财务报表按照新加坡财务报告准则进行编制，未经会计师事务所审计。

本公司在本报告书中披露了目标公司根据新加坡财务报告准则编制的 2012 财年、2013 财年经审计的以及 2014 财年前三季度未经审计的财务报表，针对目标公司所采用的主要会计政策和中国会计准则的差异及其对目标公司如果按中国会计准则编制财务报表的可能影响编制了差异情况表，并聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对该差异情况表出具了鉴证报告。根据星科金朋所使用的主要会计政策与中国会计准则的差异比较结果，本公司管理层得到的初步结论为：没有注意到任何事项使我们相信差异情况说明未能在所有重大方面反映 STATS ChipPAC 截至 2012 年 12 月 30 日止财务年度、截至 2013 年 12 月 29 日止财务年度和截至 2014 年 9 月 28 日止 9 个月期间根据新加坡财务报告准则编制的财务报表中披露的主要会计政策和中国企业会计准则相关规定的差异。本公司将在目标公司股权正式交割后三个月内完成并向投资者披露按照中国企业会计准则和本公司会计政策编制的目标公司财务报告和审计报告。

8、在收购完成之前，目标公司受上市监管及商业保密限制不能提供更为详细的财务资料，且本次收购的目标公司为在新加坡证券交易所上市的公司，公布盈利预测可能会引起目标公司的股价异动，并影响目标公司现有股东出售其股份的意愿，增加本次收购成功的不确定性，因此本次收购未进行盈利预测。

二、本次要约收购不构成关联交易

本次交易各方均为独立法人实体，其中本公司为中国独立法人实体，目标公司为新加坡独立法人实体，本公司及本公司控股股东与目标公司及其控股股东间不存在关联关系，因此本次要约收购不构成关联交易。

三、本次交易构成重大资产重组

目标公司 2013 年收入为 15.99 亿美元（约合人民币 98.27 亿元），本公司 2013 年收入为 51.02 亿元人民币，目标公司营业收入约占本公司营业收入的 192.6%。目标公司 2013 年末总资产为 23.78 亿美元（约合人民币 143.94 亿元），本公司 2013 年末总资产为 75.83 亿元人民币，本次收购的总对价约 10 亿新元（约合人民币 47.8 亿元），目标公司总资产约占本公司总资产的 189.8%。根据《重组办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。

四、本次交易不会导致公司控制权发生变化、不构成借壳上市

本次交易为现金收购，不涉及本公司股权变动。本次交易完成后，新潮集团仍为长电科技第一大股东，王新潮先生仍为长电科技实际控制人，本次交易不会导致本公司控制权发生变化。本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的借壳上市。

五、本次交易的定价方式

由于目标公司为新加坡证券交易所上市公司，本次收购的交易价格不以评估报告为依据，本次收购亦未进行资产评估。收购价格的确定因素包括目标公司净资产、市值、技术、品牌和渠道价值以及收购完成后的协同效应等。本次要约的总交易对价为 7.80 亿美元，约合 10.26 亿新加坡元（按照 2014 年 12 月 19 日美元对新元汇率中间价：1 美元折合 1.31505 新元计算）。

六、本次交易对上市公司影响的简要介绍

本次交易为现金收购，对长电科技股权结构无影响。

长期来看，本次收购有利于长电科技提升国际影响力及行业地位；拓展海外市场，

扩大客户基础；获得先进封装技术，提升研发实力，跻身全球一流封测企业。

短期来看，目标公司 2013 年及 2014 年前三季度出现亏损，主要原因是产能利用率不足及经营成本较高、同时搬厂等事件进一步影响了公司的盈利能力。目前目标公司处于亏损状态，本次交易完成后，整合到位需要一定的时间，标的公司可能持续亏损，并可能导致上市公司合并口径净利润下降。本公司目前尚未完成对目标公司的收购，难以获得目标公司按照中国企业会计准则编制的详细财务资料进行审计，亦无法编制备考合并财务报告，考虑到目标公司 2013 年度和 2014 年前三季度亏损额分别为 4,749 万美元和 2,528 万美元，初步预计若编制最近一年一期的备考合并报表，长电科技合并口径净利润将出现亏损，提请投资者注意投资风险。

七、本次交易尚需取得相关审批

本次收购尚需经过相关部门的备案或审批。在国内经过本公司董事会、股东大会批准后，需获得发改委、江苏省商务厅及所在地外汇管理部门的备案或审批，并需通过中国、美国、韩国等地的反垄断审查；同时本次收购需满足新加坡证券业协会（SIC）的相关法规要求；台湾子公司重组需获得台湾投审会的批准。在取得相关批准前，本次重组不得实施。提请广大投资者认真阅读本报告书的相关章节，并注意投资风险。

八、本次交易对中小投资者权益保护的安排

本次交易中，上市公司将采取如下措施，保护投资者合法权益：

1、在本次交易过程中，上市公司将严格按照《重组办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于加强与上市公司重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等相关法律、法规的要求，及时、完整地披露相关信息，切实履行法定的信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件以及本次交易的进展情况。

2、根据《重组办法》，本公司已聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易进行核查，并且已聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所出具鉴证报告。本公司聘请的独立财务顾问和法律顾问将根据相关法律法规要求对本次交易出具独立财务顾问报告和法律意见书。

3、本次交易相关事项在提交本公司董事会讨论时，本公司已获得独立董事对本次交易的事先认可，本公司的独立董事均已就本次交易相关事项发表了独立意见。

4、在审议本次交易的股东大会上，公司将通过交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东通过交易系统参加网络投票，以切实保护流通股股东的合法权益。

重大风险提示

本次重大资产收购存在如下风险：

1、 本次交易存在无法获得批准的风险

本次重大资产收购尚需取得必要备案或审批方可实施，包括但不限于：

（1）本公司股东大会批准本次交易及本次交易涉及的相关事宜；

（2）星科金朋股东大会批准减资及台湾子公司重组，以及根据永续证券条款修订星科金朋公司章程的相关事宜；

（3）新加坡法院批准星科金朋减资及台湾子公司重组；

（4）国家发改委、江苏省商务厅、所在地外汇管理部门关于本次交易的备案或审批；

（5）中国、美国、韩国等地的反垄断审查；

（6）台湾投审会批准台湾子公司剥离的相关事宜；

（7）其他必需的审批、备案或授权（如有）。

上述备案或核准事宜均为本次交易实施的前提条件，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得该等备案或审批的时间存在不确定性。因此，本次重大资产收购能否最终成功实施存在不确定性。如果本次交易无法获得批准，本次交易可能被暂停、中止或取消。

2、 本次交易的法律、政策风险

本次交易涉及新加坡、中国大陆及台湾的法律和政策。本公司为中国注册成立的上市公司，而目标公司为新加坡注册的上市公司，且交易涉及剥离台湾子公司，因此本次收购须符合各地关于境外并购、外资并购的政策及法规，存在一定的法律风险。

3、 业务整合风险

目标公司为一家境外公司，其主要资产、业务及工厂位于新加坡、韩国、台湾和上海，与本公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、公司管理制度、企业文化等经营管理方面存在差异。 此外，由于本次交易的涉及范围较广，待交易完成后，本公司在

产品销售、技术研发、人力资源、管理等方面的整合到位尚需一定时间，因此存在本公司无法在短期内完成业务整合或业务整合效果不佳的风险。

4、 公司国际化经营人才储备不足的风险

本次交易完成后，公司为满足国际化经营的需要，应当建立一支具有丰富国际企业管理经验的人才队伍。倘若在未来期间国际化经营人才储备不能满足战略发展需求，公司存在相关整合计划因缺乏有效执行无法顺利推进的风险。此外，本次交易完成后本公司规模迅速扩大，如果内部机构设置和管理制度不能迅速跟进，将会对本公司经营造成不利影响。

5、 行业波动的风险

本公司及目标公司的业务情况和盈利能力受半导体行业的景气状况影响较大，而半导体行业具有周期性波动的特点。

2008 年第四季度和 2009 年受金融危机影响，半导体行业景气度直线下降，跌至谷底；2010 年触底反弹，开始强劲复苏，而我国集成电路市场增速更领先于全球市场。2011 年受欧债危机影响，半导体行业全年景气度呈现前高后低的走势，2012 年延续 2011 年的低迷状态，行业整体在低谷徘徊。2013 年以来景气度有所回升。

半导体行业在发展过程中的波动会对本公司及目标公司的经营业绩产生一定影响。本公司将会密切关注市场需求动向，加快技术创新步伐，及时进行产品结构调整，降低行业波动给公司带来的经营风险。

6、 目标公司客户依赖风险

目标公司约有 70%的收入来源于美国市场，对大型客户存在一定的依赖性。如果收购完成后，不能和这些客户继续保持良好合作，目标公司销售将受到一定的影响。本次收购后，本公司将尽快与目标公司的现有主要客户展开沟通，确保客户关系的维持和平稳过渡。

7、 目标公司资产负债率较高的风险

目标公司资产负债率始终处于较高的水平，较高的利息支出也是导致其出现净亏损的原因之一。虽然长电科技不排除对目标公司进行债务替换，但相关方案仍有可能无法顺利实施，导致目标公司资本结构不能有效改善，存在目标公司短期内仍需负担较高的

债务利息，营运现金流紧张从而影响执行市场扩张战略的风险。

8、 股价波动的风险

除经营业绩和财务状况之外，本公司的股票价格还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、投资者预期和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资本公司的股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

9、 汇率波动风险

由于目标公司的日常运营中涉及美元、新元、欧元等多种货币，而本公司的合并报表采用人民币编制。伴随着人民币、美元、新元、欧元等货币之间的汇率变动，将可能给本次交易及公司未来运营带来汇兑风险。

10、 其他风险

本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

本公司在本报告书第十章“风险因素”披露了本次重大资产收购的风险，提醒投资者认真阅读，注意投资风险。

目 录

声 明 1

重大事项提示 2

重大风险提示 8

释 义 14

第一章 本次交易概述 18

一、本次交易背景和目的 18
二、本次交易的具体方案 21
三、本次要约收购不构成关联交易 29
四、本次交易构成重大资产重组 29
五、本次交易不会导致公司控制权发生变化、不构成借壳上市 29
六、本次交易的决策过程与批准情况 29
七、本次交易对上市公司的影响 31

第二章 上市公司基本情况 32

一、长电科技概况 32
二、长电科技历史沿革 32
三、长电科技最近三年的控制权变动 39
四、长电科技控股股东和实际控制人基本情况 39
五、长电科技最近三年重大资产重组情况 40
六、长电科技主营业务发展情况 40
七、长电科技最近三年及一期主要财务指标 43
八、长电科技最近三年未受到行政处罚或刑事处罚 44
九、本次交易的收购主体 44

第三章 本次收购的交易对方 47

一、交易对方概况 47
二、主要交易对方的基本情况 47
三、主要交易对方最近三年主要财务指标 48
四、关于主要交易对方的其他说明 49

第四章 目标公司基本情况 50

一、目标公司概况 50
二、目标公司主要历史沿革 50
三、目标公司股权结构 52
四、目标公司下属子公司情况 55
五、目标公司员工情况 56
六、目标公司主要资产负债情况 57
七、目标公司最近三年未受到行政处罚或刑事处罚 64

八、目标公司担保抵押、财务承诺与诉讼情况 64
九、目标公司持续经营活动 65
十、目标公司非持续经营活动 80
十一、目标公司最近两年及一期的主要财务指标 82

第五章 本次要约收购及相关协议的主要内容 86

一、本次要约收购的主要内容 86
二、永续证券的主要条款 90
三、共同投资协议的主要内容 91
四、分手费契约的主要内容 101

第六章 本次交易的合规性分析 104

一、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定 104
二、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件 104
三、本次交易所涉及资产定价公允，不存在损害本公司和股东合法权益的情形 105
四、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，不涉及债权债务转移的情况 105
五、本次交易有利于本公司增强持续经营能力，不存在可能导致收购完成后本公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形 106
六、本次交易有利于本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定 106
七、本次交易有利于本公司继续保持健全有效的法人治理结构 107

第七章 管理层讨论与分析 108

一、董事会对本次交易的定价依据及公平合理性的分析 108
二、董事会关于本次交易对本公司影响的讨论与分析 110

第八章 本次交易的其他重要信息 132

一、同业竞争及关联交易 132
二、资金、资产占用及关联担保情况 132
三、本次交易对公司负债结构的影响 132
四、最近十二个月内发生的资产交易情况 133
五、本次交易对公司治理机制的影响 133
六、本次交易对公司独立性的影响 135
七、保护投资者利益的相关安排 136
八、不存在泄露本次交易内幕信息及利用本次交易信息进行内幕交易的情况 137
九、上市公司利润分配政策的相关说明 138

第九章 目标公司财务会计信息 142

一、目标公司所采纳的会计政策和中国企业会计准则之间的主要差异的说明及国内审计机构出具的鉴证报告 142
二、目标公司主要会计政策与中国企业会计准则相关规定的差异情况比较表 144
三、目标公司主要会计政策摘要 168
四、目标公司最近两年及一期的财务报表 170

第十章 风险因素 175
一、本次交易相关的风险 175
二、业务整合风险 175
三、目标公司经营风险 176
四、其他风险 177
第十一章 独立董事及中介机构意见 178
一、独立董事对于本次交易的意见 178
二、中介机构对于本次交易的意见 179
第十二章 本次交易相关证券服务机构 180
一、独立财务顾问 180
二、中国法律顾问 180
三、会计师事务所 180
四、新加坡财务顾问 181
五、境外法律顾问 181
第十三章 董事会及相关中介机构声明与承诺 183
一、本公司董事声明 183
二、独立财务顾问声明 184
三、法律顾问声明 185
四、审计机构声明 186
第十四章 备查文件及备查地点 187
一、备查文件 187
二、备查文件查阅方式 187

释 义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列词汇具有如下特定含义：

本报告书	指	江苏长电科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
长电科技/本公司/上市公司	指	江苏长电科技股份有限公司
目标公司/星科金朋/ STATS ChipPAC	指	STATS ChipPAC Ltd.，该公司于新加坡证券交易所上市
本次收购/本次交易/本次要约收购/本次重大资产收购	指	长电科技与产业基金、芯电半导体通过共同设立的子公司，以自愿有条件全面要约收购的方式，收购新加坡证券交易所上市的星科金朋的全部股份
台湾子公司重组	指	星科金朋将在新加坡设立一家新公司“Newco”，将星科金朋下属两家台湾子公司的股权转由 Newco 持有；星科金朋再以减资的方式，向所有股东派发 Newco 的股权及现金，从而剥离台湾子公司
新潮集团	指	江苏新潮科技集团有限公司，本公司第一大股东
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司
芯电半导体	指	芯电半导体(上海)有限公司，中芯国际的全资子公司
产业基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
联合投资者	指	本次收购中与本公司进行联合投资的芯电半导体及产业基金
长电新科	指	长电科技与产业基金、芯电半导体为本次交易之目的在苏州工业园区设立的特殊目的公司苏州长电新科投资有限公司，即 HoldCo A
长电新朋	指	长电新科与产业基金为本次交易之目的在苏州工业园区设立的特殊目的公司苏州长电新朋投资有限公司，即 HoldCo B
要约人	指	长电新朋为本次交易之目的在新加坡设立的特殊目的公司 JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.，即 BidCo
淡马锡	指	Temasek Holdings (Private) Limited，为星科金朋控股

		股东的实际控制人
STSPL	指	星科金朋控股股东 Singapore Technologies Semiconductors Pte Ltd
附生效条件的要约	指	本公司所控制的要约人向星科金朋发出的附生效条件的自愿性现金要约
正式要约	指	附生效条件的要约的生效条件被满足或豁免后，本公司及联合投资者为本次交易之目的设立的特殊目的公司将对星科金朋发出自愿有条件现金要约，正式要约的条件如下：（1）有效接受要约的股份，与已经由要约人及其一致行动人持有、控制或即将收购的股份之和，占目标公司总股本的比例不低于50%；（2）完成台湾子公司重组；（3）永续证券的配售接纳表格已向星科金朋的股东发送。
截止日期	指	附生效条件的要约的生效条件需要获得满足或者豁免的最后日期，为附生效条件的要约公告后 6 个月，即新加坡时间 2015 年 6 月 30 日下午 5 点或某个经目标公司及要约人于咨询新加坡证券业协会后确定的更晚时间
台湾子公司	指	星科金朋拥有 52%股权的 STATS ChipPAC Taiwan Semiconductor Corporation 与星科金朋拥有 100%股权的 STATS ChipPAC Taiwan Co., Ltd.
SCT 1	指	星科金朋拥有 52%股权的 STATS ChipPAC Taiwan Semiconductor Corporation
SCT 3	指	星科金朋拥有 100%股权的 STATS ChipPAC Taiwan Co., Ltd.
星展银行	指	DBS Bank Ltd.
台湾投审会	指	台湾经济部投资审议委员会（IC）
新加坡证券业协会	指	Securities Industry Council of Singapore（SIC）
《新加坡收购与兼并守则》	指	the Singapore Code on Take-overs and Mergers
WSTS	指	World Semiconductor Trade Statistics，即世界半导体贸易统计协会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《财务顾问业务指引》	指	《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘一第二号 上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
独立财务顾问/中金公司	指	中国国际金融有限公司
法律顾问	指	江苏世纪同仁律师事务所
CAGR	指	Compound Annual Growth Rate 的缩写，是复合年均增长率
新元	指	新加坡元
WLCSP	指	圆片级芯片尺寸封装
Copper Pillar Bumping	指	铜柱凸点
SiP	指	系统级封装
FC	指	倒装芯片
MIS	指	预包封互连系统
分立器件	指	只具备单一功能的电路，主要包括各种二极管、三极管等晶体管器件
IC	指	集成电路（Integrated Circuit,简称 IC，俗称芯片）是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。
eWLB	指	内嵌式晶圆级凸点封装,专指英飞凌授权星科金朋

		使用的一种封装技术
泰瑞达平台	指	全球最大的集成电路自动测试设备供应商泰瑞达提供的测试平台
IPD	指	集成无源器件
TSV	指	硅穿孔
fcBGA	指	flip-chip Ball Grid Array，倒装球栅阵列封装
fcFBGA	指	flip-chip Fine-Pitch Ball Grid Array，指倒装细间距球栅阵列封装
fcLGA	指	flip-chip Land Grid Array，指倒装触点阵列封装

本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第一章 本次交易概述

一、本次交易背景和目的

（一）本次交易的背景

1、中国企业通过海外收购“走出去”，深度参与全球经济

本次交易符合中国企业加强跨国资源整合的大趋势，符合国家政策的战略导向。2014 年国务院《政府工作报告》中明确提出：“在走出去中提升竞争力。推进对外投资管理方式改革，实行以备案制为主，大幅下放审批权限。”改革开放以来，中国经济逐步发展，外商投资通过合资、合作、新设、兼并、收购等多元化的方式参与中国经济和中资企业成长；随着中国综合国力的提升和中国企业的发展，新形势促使中国企业寻求更多的发展空间，整合境内外资源并参与国际分工成为发展方式之一。

中国企业通过贸易活动、海外并购、跨国投资等方式参与全球经济，在全球范围配置资源；近年来，越来越多的中国企业通过对外直接投资的方式，将产业链和市场覆盖延伸到海外，为逐步发展成为全球性的跨国企业奠定基础。商务部等部门联合发布的 2013 年度中国对外直接投资数据显示：2013 年，中国对外直接投资流量创下 1,078.4 亿美元的历史新高，同比增长 22.8%，连续两年位列全球三大对外投资国；截至 2013 年底，中国对外直接投资累计净额（存量）达 6,604.8 亿美元，全球排名由第 13 位上升至第 11 位；中国非金融类对外直接投资存量达 5,434 亿美元。

本次交易将有助于长电科技更快速更有效地融入国际市场，符合中国企业“走出去”的发展趋势。

2、全球半导体产业复苏，中国需求旺盛

经过 2008-2012 年的低谷后，全球半导体行业规模在 2013 年开始进入复苏，首次突破 3,000 亿美元，达到 3,056 亿美元，有 4.8%的增幅。根据 WSTS 的预测，2014 年全球半导体市场仍保持增长势头，在移动互联市场等新兴市场兴起带动处理器芯片、存储器芯片需求增加的推动下，预计 2014 年将进一步攀升到 3,166 亿美元，并将于 2015 年达到 3,273 亿美元。中国半导体封装测试行业市场规模受到全球封测产能向中国转移、国内封测技术突破、国内半导体设备国产化需求上升和下游消费电子设备需求的增长等

额外因素的促动，保持了平稳增长，其规模已超过 1,000 亿元。目前，中国已成为世界第一大半导体消费市场，但半导体的自给率却不到 40%，大部分还是由国外企业提供。中国作为消费大国和生产潜力国，未来半导体市场的高增长还将持续，芯片国产化需求旺盛。

3、半导体行业战略地位凸显，国内企业综合竞争力有待提升

集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是培育发展战略性新兴产业、推动信息化和工业化深度融合的核心与基础，是转变经济发展方式、调整产业结构、保障国家信息安全的重要支撑，其战略地位日益凸显。本公司所在的集成电路封测产业是集成电路产业的重要组成部分；行业内企业大部分属于跟随发展的代加工模式，国内企业间竞争激烈且在与国际同行竞争的过程中处于相对劣势，发展模式亟待转型。

《集成电路产业“十二五”发展规划》指出：到“十二五”末，产业规模再翻一番以上，关键核心技术和产品取得突破性进展，结构调整取得明显成效，产业链进一步完善，形成一批具有国际竞争力的企业。但目前国内企业大部分规模较小且同质化竞争严重，总体是跟随发展模式；受自身技术、制作工艺水平限制，在与日韩、台湾地区同行的竞争中整体处于下风。对于半导体封测企业而言，一方面，劳动力成本呈现不断上升趋势，国内低成本优势逐渐减弱；另一方面，终端厂商对于技术以及设计工艺的严格把控，使得封测行业企业的盈利能力受到挤压。原有发展模式的转变需要较长时间与较大资本投入，跨境并购将给予国内企业较快学习境外先进技术并整合国际资源的机会，提升综合竞争力及全球话语权。

4、把握机遇，通过并购实现跨越发展式

目标公司主要从事半导体芯片委外封装及测试业务，是全球半导体封装及测试行业的主要经营者之一。目标公司管理总部位于新加坡，在新加坡、韩国、中国上海和台湾等四地经营半导体封装及测试业务，拥有 4 个制造测试中心和两个研发中心，同时在美国、韩国、日本、中国上海及台湾、新加坡和马来西亚拥有销售团队。

受终端市场疲软影响，目标公司近年业绩表现不佳，其控股股东希望出售公司股份。因此本公司有机会以合适的交易价格全面收购目标公司，通过并购实现跨越式发展。

（二）本次交易的目的

1、提升国际影响力及行业地位

本次交易将提升本公司的国际影响力，帮助本公司借助目标公司的品牌效应，迅速建立中国企业在海外市场的认知度。目标公司已在新加坡、美国、韩国、马来西亚及中国台湾等国家和地区设立分支机构，拥有超过 20 年的行业经验，按销售额计算是全球半导体委外封装测行业（OSAT）的第四大经营者，在先进封装技术领域处于领先地位，管理团队具备丰富的业务和管理经验。本次交易的达成将有效促进本公司的国际化进程，资源的协同将促进本公司提升全球行业地位。

目标公司具备提供涵盖封装设计、焊锡凸块、针探、组装、测试、配送等一整套半导体解决方案服务体系，依托现有的在倒装芯片、晶元、3D 封装等方面的技术优势，为客户提供创新与成本高效的半导体解决方案。若本次交易完成并后续整合顺利，目标公司的主要产品与技术将与本公司业务形成有效互补，有助于本公司提升技术和服务水平，实现规模优势。

2、拓展海外市场，扩大客户基础

本次交易将为本公司开拓海外市场，扩大海外高端客户群体奠定基础。目标公司在全球主要地区均有销售业务布局，拥有完整的专业销售服务团队，包括销售、项目管理、产品技术市场、客户服务等部门，提供一系列成体系的销售服务。目标公司在欧美地区的销售额占比较高，2013 年，目标公司美国业务收入占总收入的 69.2%，欧洲地区业务收入占总收入的 11.8%。目标公司的客户质量也较高，2013 年世界前 20 大半导体客户中的大约 11 个客户与目标公司有业务往来，对其余客户目标公司也有覆盖，本次交易的达成将有助于本公司迅速扩大在海外市场的业务覆盖，发挥协同效应，加强国际化布局。

3、获得先进封装技术，提升研发实力

本次交易将帮助本公司有效实施“适度发展传统封装，重点发展高端封装，加快发展特色封装”的产品发展战略。倒装是目标公司最重要的业务，前五大客户销售收入的 90%来自倒装，目标公司的业务特点与本公司的发展战略相契合。

目标公司在先进封装中占有领先地位，研发实力强，具备一套完善的研发流程与体

系。目标公司共计申请专利 2,594 项，分布于美国、新加坡、韩国、中国、台湾，其中76%的专利在集中于美国，与其销售市场以美国为重点相匹配；目标公司关键核心专利在 300 件左右，主要是 Fan-Out 与芯片凸点倒装方面的专利；目标公司技术或产品种类与本公司形成较高互补性，其较为完善的研发体系和清晰的技术战略与市场需求相匹配，有助于提升本公司研发实力，为本公司建成技术先进、管理成熟、业绩优良、国际一流的封测企业奠定基础。

二、本次交易的具体方案

（一）本次交易的具体方案

1、本次要约收购的基本情况

联合收购方：江苏长电科技股份有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体(上海)有限公司

收购主体：JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.（即要约人）

交易标的：STATS ChipPAC Ltd.（星科金朋）（不含台湾子公司）

交易对方：目标公司全体股东

收购方式：长电科技与产业基金、芯电半导体通过共同设立的子公司，以自愿有条件全面要约收购的方式，收购新加坡证券交易所上市的星科金朋的全部股份。

收购对价：本次要约的对价将以现金支付：每股星科金朋股票收购价格为 0.466 新元。

若附生效条件的要约公告后，目标公司股票发生除权、除息等事项，则要约人保留对于要约价格进行相应调整的权利。

总交易对价：如收购 100%股权，交易总对价为 7.8 亿美元，约合 10.26 亿新元（按照 2014 年 12 月 19 日美元对新元汇率中间价：1 美元折合 1.31505 新元计算），约合人民币 47.74 亿元（按照 2014 年 12 月 19 日美元对人民币汇率中间价：1 美元折合 6.1205 人民币计算）。

本次附生效条件的要约的生效条件包括：

（1） 长电科技股东大会批准本次交易及相关事宜；

（2） 目标公司股东大会批准减资及台湾子公司重组，以及根据永续证券条款修订星科金朋公司章程的相关事宜；

（3） 新加坡法院批准减资及台湾子公司重组；

（4） 在以下两个日期中的较早日期，目标公司合并口径的有息债务总额（银行贷款及已发行的票据及债券）不超过 12.8 亿美元：（1）正式要约公告之日，（2）2015 年 4 月 30 日；

（5） 所有与本次要约相关的备案、核准或授权均已获得并具有相关效力，包括但不限于：国家发改委、江苏省商务厅、所在地外汇管理局关于本次交易的备案或审批、台湾投审会批准台湾子公司重组的相关事宜；

（6） 通过中国、美国、韩国等地的反垄断审查；

（7） 获得其他必需的审批或授权（如有）。

只有当上述生效条件被全部满足或豁免后，要约人才会发出正式要约。如果截止日期（新加坡时间 2015 年 6 月 30 日下午 5 点或某个经目标公司及要约人于咨询新加坡证券业协会后确定的更晚时间）到达后，仍有生效条件未被满足且未获得豁免，正式要约将不会发出。

附生效条件的要约的生效条件被满足或豁免后，本公司间接控制的要约人将对星科金朋发出自愿有条件全面要约（即正式要约），正式要约的生效条件如下：

（1） 在要约到期日，有效接受要约的股份，与已经由要约人及其一致行动人持有、控制或即将收购的股份之和，占目标公司总股本的比例不低于 50%。此处总股本的计算基础为目标公司全面摊薄后的总股份数，包括在附生效条件的要约公告日已发行的期权计划下因行权而新发行的所有普通股股份；

（2） 台湾子公司重组完成。

（3） 永续证券的配售接纳表格已向星科金朋的股东发送。

2、台湾子公司重组的基本情况

鉴于台湾地区对于陆资企业投资台湾半导体相关行业企业有一定的政策限制，而本次要约收购的同时，若不进行台湾子公司重组，收购完成后目标公司的台湾子公司将被陆资企业所间接控制。为避免对本次要约收购的实施产生影响，经长电科技与目标公司及其控股股东协商，拟在本次要约收购的同时进行台湾子公司重组。具体方案如下：星科金朋持有 52%股权的台湾子公司 SCT 1 向星科金朋收购其持有 100%股权的台湾子公司 SCT 3，收购对价约为 1,500 万美元，收购后 SCT 3 成为 SCT 1 的全资子公司。星科金朋将在新加坡设立一家新公司“Newco”，将 SCT 1 的 52%的股权以 7,412 万美元的对价转让给 Newco 持有，并获得 Newco 向其发行的股份；星科金朋再以减资的方式，向所有股东派发 Newco 的全部股权和总计约 1,500 万美元的现金，从而剥离台湾子公司，上述减资不会导致星科金朋发行在外的股份的注销，亦不会导致其总股本发生变化，仅会导致每股净资产减少。星科金朋的股东可以选择获得现金或者 Newco 的股份，但控股股东 STSPL 承诺将选择接受 Newco 的全部股票。Newco 的股票不会在任何证券交易所上市。上述台湾子公司重组构成星科金朋的减资，需经星科金朋股东大会审议通过，并经新加坡法院批准。根据中国台湾地区的相关规定，上述台湾子公司重组的相关事宜需经中国台湾地区投审会批准。此外，星科金朋两家台湾子公司之一 SCT 1 为台湾上市公司，星科金朋持有其 52%的股权，星科金朋向 Newco 转让该部分股权需向投审会申请豁免 Newco 的要约收购义务。在台湾子公司重组的同时，SCT 3 将归还欠星科金朋的 1.27 亿美元的债务；同时，为保证台湾子公司重组后平稳过渡，星科金朋将与台湾子公司签署业务合同。

3、星科金朋债务重组及发行永续证券

考虑到本次交易将导致星科金朋控股股东发生变化，星科金朋将根据其现有银行贷款及发行在外的优先票据的相关条款约定进行债务重组。截至本报告书出具之日，长电科技已经为可能发生的相关票据提前赎回或贷款提前偿还进行了债务重组安排，长电科技已与星展银行就债务重组安排签署了委任函，星展银行将通过向目标公司提供上限为 8.9 亿美元的过桥贷款对目标公司进行债务重组，该过桥贷款额度将足够覆盖目标公司全部的债务重组需求，后续星展银行将通过退出贷款及协助目标公司发行债券的方式进一步对目标公司的债务进行替换。

同时，为了配合上述债务重组并替换星科金朋现有的部分债务，星科金朋拟向所有

股东配售永续证券，该永续证券规模为两亿美元，星科金朋控股股东 STSPL 承诺将认购最高两亿美元的永续证券并按约定时间缴纳认购款项。长电科技拟出具担保承诺，若星科金朋三年后仍无法赎回上述永续证券，永续证券持有人有权将所有永续证券出售给长电科技，长电科技作为永续证券担保人将按照出售价格偿付包括永续证券本金及所有应付未付的利息。但在任何情况下，永续证券持有人均不可在三年内要求向长电科技进行出售。上述担保须经长电科技股东大会审议通过，并在永续证券发行后生效。

4、强制挤出

根据新加坡的相关法规，若有效接受要约的目标公司股权占目标公司表决权达到90%，则要约人可以执行法定强制程序，收购剩余股权；如果收购的股份比例未能达到前述比例，则目标公司无法实现退市。

（二）要约收购的流程

本次要约收购流程如下：

1、长电科技召开董事会审议通过本次要约收购的具体方案及相关事宜、本次收购涉及的相关协议及信息披露文件。

2、长电科技披露《江苏长电科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关信息披露文件，目标公司发布本次附生效条件的要约的相关公告。

3、长电科技股东大会批准本次收购及相关事宜。

4、目标公司股东大会批准减资及台湾子公司重组，以及根据永续证券条款修订星科金朋公司章程的相关事宜；新加坡法院批准减资及台湾子公司重组。

5、长电科技获得发改委、江苏省商务厅、所在地外汇管理部门等相关监管部门的备案或审批。

6、完成本次交易所涉及的反垄断审查或申报。

7、附生效条件的要约的生效条件得以全部满足或豁免，公告正式要约。

8、星科金朋向全体股东发送长电科技提交的正式要约文件、股东通函及永续证券的配售接纳表格。

9、完成台湾子公司的剥离；STSPL 接受本次要约，星科金朋其他股东决定是否接受要约。

10、正式要约的生效条件达成，要约宣告为无条件。

11、要约收购完成。

12、若正式要约的接纳比例超过 90%，星科金朋进入退市程序。

（三）本次交易的预计时间表

以下是正式要约发出前的示意性时间表，具体时间安排以公司公告为准：

时　间	内　容
2014 年 12 月 26 日	长电科技召开董事会，审议通过本次要约收购的具体方案及相关事宜、本次收购涉及的相关协议及信息披露文件
2014 年 12 月 30 日	长电科技披露《江苏长电科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关信息披露文件，目标公司发布本次附生效条件的要约的相关公告
2015 年 2 月底前	长电科技召开股东大会
2015 年 6 月中旬（实际时间取决于相关生效条件获得满足的进度）	附生效条件的要约的生效条件得以全部满足或豁免，公告正式要约

（四）交易结构和融资方案

1、交易结构

长电科技为本次收购之目的在苏州工业园区成立了一家特殊目的公司长电新科，产业基金和芯电半导体将根据《共同投资协议》的约定对其进行增资；长电新科为本次收购之目的在苏州工业园区设立了长电新朋，产业基金将根据《共同投资协议》的约定对其进行增资；长电新朋为本次收购之目的在新加坡设立 JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.作为融资平台进行并购贷款融资，并作为本次收购的实施主体，即要约人。收购完成后 JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.持有星科金朋最多 100%的股权，而本公司间接控股星科金朋。

2、融资方案

在长电新科层面，长电科技、产业基金及芯电半导体均以现金方式出资，总计拟出资 5.1 亿美元等额人民币，具体出资情况如下：

1) 长电科技拟以现金出资 2.6 亿美元等额人民币；

2) 产业基金拟以现金出资 1.5 亿美元等额人民币；

3) 芯电半导体拟以现金出资 1 亿美元等额人民币；

在长电新朋层面，长电新科与产业基金总计拟出资 5.2 亿美元等额人民币，具体出资情况如下：

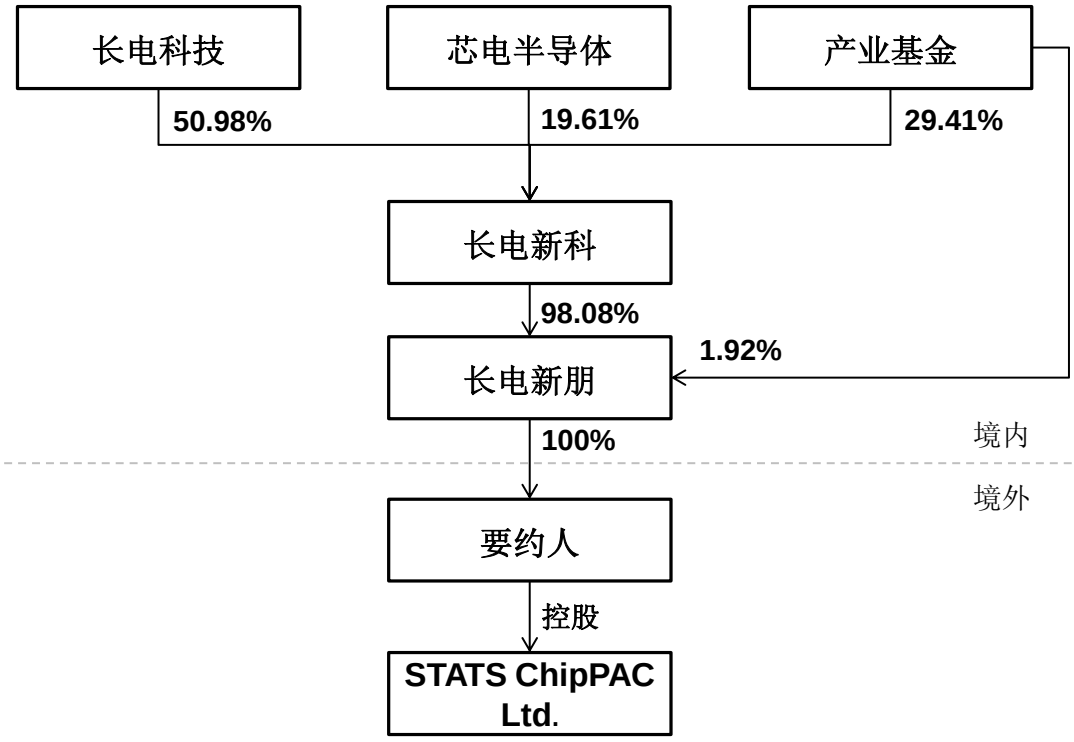
1) 长电新科拟以现金出资 5.1 亿美元等额人民币；

2) 产业基金拟以现金出资 0.1 亿美元等额人民币；

3) 此外，产业基金还将向长电新朋提供股东贷款 1.4 亿美元等额人民币，该部分股东贷款可根据双方约定进行转股。

长电新朋拟将上述 6.6 亿美元等额人民币向要约人 JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.出资，剩余收购款项将由 JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.通过银行贷款的方式获得。长电科技已于 2014 年 12 月 27 日，获得中国银行无锡分行出具的 1.2 亿美元的贷款承诺函。根据该贷款承诺函，若满足相关条件，中国银行承诺为本次收购提供融资安排，该并购贷款期限为首次提款后的 48 个月，融资的条款和条件尚未最终确定。长电科技将为此并购贷款提供担保。

本次交易的融资方案如下图所示：



上述出资中，长电科技的出资来源于自有资金及非公开发行的部分募集资金（5.9亿人民币）变更用途，其中，变更前次非公开发行的募集资金用途尚需经长电科技股东大会批准。

（五）联合投资方基本情况

1、产业基金

企业名称：国家集成电路产业投资基金股份有限公司

企业性质：股份有限公司

成立日期：2014 年 9 月 26 日

注册地：北京

主要办公地点：北京经济技术开发区景园北街 2 号 BDA 企业大道 52 幢 7 层 718

法定代表人：王占甫

经营情况：国家集成电路产业投资基金股份有限公司成立于 2014 年 9 月，募集总规模约 1300 亿元。基金将运用多种形式投资集成电路行业内企业，重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。受基金公司委托，华芯投

资管理有限责任公司负责项目的遴选、投资和退出等投资业务管理工作。产业基金和长电科技无任何关联关系。

3、芯电半导体

企业名称：芯电半导体(上海)有限公司

成立日期：2009 年 3 月 3 日

注册地：上海

主要办公地点：上海市浦东新区张江路 18 号

法定代表人：邱慈云

第一大股东：芯电半导体(香港)有限公司

经营情况：芯电半导体(上海)有限公司系芯电半导体(香港)有限公司在上海浦东新区投资成立的外资企业。芯电半导体成立于 2009 年 3 月 3 日，经营期限为 50 年，主要从事半导体(硅片及各类化合物半导体)集成电路芯片制造、针测及测试，与集成电路有关的开发、设计服务、光掩膜制造、测试封装、销售自产产品(涉及行政许可的，凭许可证经营)。芯电半导体注册资本为 1,200 万美元，最终控股股东为中芯国际集成电路制造有限公司。

中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业。中芯国际向全球客户提供 0.35 微米到 28 纳米晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于上海，在上海建有一座 300mm 晶圆厂和一座 200mm 超大规模晶圆厂。另外，中芯拥有多样化的实验室和工具，可用于化学和原材料分析、产品失效分析、良率改进、可靠性检验与监控，以及设备校准等。在整个制作过程及从研发到量产的全程服务中，中芯整合了全面的品质与控制系统。中芯国际还在美国、欧洲、日本和台湾地区设立营销办事处、提供客户服务，同时在香港设立了代表处。

（六）目标公司的持续管理与经营

本公司保证目标公司在交易完成后将继续其现有的经营活动，同时本公司目前无意对目标公司的业务活动进行重大改变；将根据本公司及目标公司的发展战略，对目标公司现有组织架构及人员做适当调整。长电科技将提供必要的资源和支持以使目标公司进

一步持续发展，同时尽可能地挖掘双方的协同效应。

三、本次要约收购不构成关联交易

本次交易各方均为独立法人实体，其中本公司为中国独立法人实体，目标公司为新加坡独立法人实体，本公司及本公司控股股东与目标公司及其控股股东间不存在关联关系，因此本次要约收购不构成关联交易。

四、本次交易构成重大资产重组

目标公司 2013 年收入为 15.99 亿美元（约合人民币 98.27 亿元），本公司 2013 年收入为 51.02 亿元人民币，目标公司营业收入约占本公司营业收入的 192.6%。目标公司 2013 年末总资产为 23.78 亿美元（约合人民币 143.94 亿元），本公司 2013 年末总资产为 75.83 亿元人民币，本次收购的总对价约 10 亿新元（约合人民币 47.8 亿元），目标公司总资产约占本公司总资产的 189.8%。根据《重组办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。

五、本次交易不会导致公司控制权发生变化、不构成借壳上市

本次交易为现金收购，不涉及本公司股权变动。本次交易完成后，新潮集团仍为长电科技第一大股东，王新潮先生仍为长电科技实际控制人，本次交易不会导致本公司控制权发生变化。本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的借壳上市。

六、本次交易的决策过程与批准情况

（一）本次交易的决策过程

2014 年 11 月 5 日，本公司召开了第五届第二十次临时董事会，审议通过了向星科金朋发出不具有法律约束力的收购提议的议案。2014 年 12 月 20 日，本公司第五届第二十二次临时董事会审议通过了本次交易涉及的《共同投资协议》等相关议案。2014

年 12 月 26 日，本公司第五届第二十三次临时董事会审议通过了本次要约收购的具体方案及相关事宜、本次收购涉及的相关协议及信息披露文件，同意公司进行本次收购，并向星科金朋发出附生效条件的要约。本次收购及相关事宜尚需提交本公司股东大会审议通过。

本次收购中，台湾子公司重组涉及星科金朋的减资，且需根据永续证券的条款修订星科金朋的公司章程，上述事宜尚需提交星科金朋股东大会审议通过。

（二）本次交易尚需获得的授权、批准和备案

1、中国境内相关审批或备案

（1）发改委

根据《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发改委 2014 年第 9 号）的相关规定，地方企业实施的中方投资额 3 亿美元及以上境外投资项目，由国家发展改革委备案。

（2）商务部门

根据《境外投资管理办法》（商务部令 2014 年第 3 号）第六条和第九条的规定，本次收购需报江苏省商务厅备案。

根据《中华人民共和国反垄断法》及《国务院关于经营者集中申报标准的规定》（中华人民共和国国务院令第 529 号）的规定，本次经营者集中达到相关标准，应当事先向商务部申报。

（3）外汇管理部门

根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，本公司及联合投资者向境外子公司增加投资总额用于本次收购，需到所在地外汇管理局办理境外直接投资外汇登记手续。

2、本次交易涉及的其他审批或备案

（1）除了需向中国商务部进行经营者集中的申报以外，本次收购还需通过美国、韩国等地的反垄断审查或申报。

（2）本次收购所涉及的台湾子公司重组的相关事宜需经中国台湾地区投审会批准。此外，星科金朋两家台湾子公司之一 SCT 1 为台湾上市公司，星科金朋持有其 52%的股权，星科金朋向 Newco 转让该部分股权需向投审会申请豁免要约收购义务。

（3）星科金朋拟通过减资的方式实施台湾子公司重组，需经新加坡法院批准。

七、本次交易对上市公司的影响

长期来看，本次收购有利于长电科技提升国际影响力及行业地位；拓展海外市场，扩大客户基础；获得先进封装技术，提升研发实力，跻身全球一流封测企业。

短期来看，目标公司 2013 年及 2014 年前三季度出现亏损，主要原因是产能利用率不足及经营成本较高、同时搬厂等事件进一步影响了公司的盈利能力。目前目标公司处于亏损状态，本次交易完成后，整合到位需要一定的时间，标的公司可能持续亏损，并可能导致上市公司合并口径净利润下降。

本公司目前尚未完成对目标公司的收购，难以获得目标公司按照中国企业会计准则编制的详细财务资料进行审计，亦无法编制备考合并财务报告，考虑到目标公司 2013 年度和 2014 年前三季度亏损额分别为 4,749 万美元和 2,528 万美元，初步预计若编制最近一年一期的备考合并报表，长电科技合并口径净利润将出现亏损，提请投资者注意投资风险。

第二章 上市公司基本情况

一、长电科技概况

法定中文名称：江苏长电科技股份有限公司

法定英文名称：Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd.

注册资本：人民币 98,457.0000 万元

法定代表人：王新潮

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：长电科技

股票代码：600584

注册地址：江苏省江阴市澄江镇长山路 78 号

办公地址：江苏省江阴市滨江中路 275 号

邮政编码：214431

电话号码：0510-86856061

传真号码：0510-86199179

公司网址：www.cj-elec.com

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：研制、开发、生产、销售半导体、电子元件、专用电子电气装置、销售本企业自产机电产品及成套设备，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，开展本企业进料加工和“三来一补”业务。

二、长电科技历史沿革

（一）公司设立及改制

长电科技前身为江阴长江电子实业有限公司，由江阴长江电子实业公司、江阴长江电子实业公司工会委员会、厦门永红电子有限公司、宁波康强电子有限公司、连云港华威电子集团有限公司于 1998 年 11 月 6 日共同出资设立。江阴诚信会计师事务所对各出

资人出资情况进行了验证，并出具诚信验（1998）102 号《验资报告》，确认出资人资金到位。

2000 年，经江阴长江电子实业有限公司董事会、股东会决议通过，并经江苏省人民政府苏政复（2000）227 号文批准，江阴长江电子实业有限公司以 2000 年 10 月 31 日为审计基准日，以经审计后的净资产额为 12,787 万元，按 1:1 的折股比例，将有限公司依法整体变更为股份有限公司，2000 年 12 月 6 日发行人召开创立大会暨首届股东大会，2000 年 12 月 12 日在江苏省工商行政管理局完成变更登记手续，注册资本 12,787 万元，注册号为 3200001105008。江苏公证会计师事务所有限公司于 2000 年 12 月 7 日出具了锡会 B（2000）0168 号验资报告。

设立时股东持股情况如下：

股东名称	股权性质	持股数（股）	比例（%）
江阴市新潮科技有限公司	法人股	43,777,546	34.24
上海华易投资有限公司	法人股	29,977,278	23.44
上海恒通资讯网络有限公司	法人股	21,767,512	17.02
江阴长江电子实业公司	法人股	9,745,632	7.62
厦门永红电子有限公司	法人股	6,853,832	5.36
杭州士兰微电子股份有限公司	法人股	6,730,000	5.26
宁波康强电子有限公司	法人股	4,689,464	3.67
连云港华威电子集团有限公司	法人股	4,328,736	3.39
合计		**127,870,000**	**100.00**

（二）公司历次股权结构变动情况

（1）2003 年首次公开发行 A 股股票并上市

经中国证监会证监发行字（2003）40 号文核准，长电科技于 2003 年 5 月 19 日发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 7.19 元，共募集资金 39,545 万元，扣除发行费用 1,755.1445 万元后，募集资金净额为 37,789.8555 万元，其中 5,500 万元计入股本，注册资本增至 18,287 万元。江苏公证会计师事务所有限公司于 2003 年 5 月 23 日出具了苏公 W（2003）第 B080 号验资报告。长电科技首次公开发行完毕后的股本结构情况如下表所示：

股份类别	数量（股）	比例（%）

发起人股（非流通股）	127,870,000	69.92
其中：江阴市新潮科技有限公司	43,777,546	23.94
上海华易投资有限公司	29,977,278	16.39
上海恒通资讯网络有限公司	21,767,512	11.90
江阴长江电子实业公司	9,745,632	5.33
厦门永红电子有限公司	6,853,832	3.75
杭州士兰微电子股份有限公司	6,730,000	3.68
宁波康强电子有限公司	4,689,464	2.56
连云港华威电子集团有限公司	4,328,736	2.37
社会公众股	55,000,000	30.08
合计	**182,870,000**	**100.00**

（2）2004 年资本公积金转增股本

2004 年 4 月 19 日，经 2003 年年度股东大会审议通过，长电科技以 2003 年 12 月 31 日总股本 182,870,000 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 6 股，合计转增股本 109,722,000 股，转增后长电科技总股本增至 292,592,000 股。2004 年 4 月 30 日，江苏公证会计师事务所有限公司对此次转增出具了苏公 W（2004）第 B065 号验资报告。本次转增后，股本结构如下：

股份类别	数量（股）	比例（%）
发起人股（非流通股）	204,592,000	69.92
其中：江阴新潮科技集团有限公司	70,044,074	23.94
上海华易投资有限公司	47,963,645	16.39
上海恒通资讯网络有限公司	34,828,019	11.90
江阴长江电子有限公司	15,593,011	5.33
厦门永红电子有限公司	10,966,131	3.75
杭州士兰微电子股份有限公司	10,768,000	3.68
宁波康强电子有限公司	7,503,142	2.56
连云港华威电子集团有限公司	6,925,978	2.37
社会公众股	88,000,000	30.08
股份总额	**292,592.000**	**100.00**

（3）2005 年股权分置改革

2005 年 12 月 7 日，长电科技召开股权分置改革相关股东大会审议通过了全体非流通股股东向全体流通股股东每 10 股支付 3.2 股股票的股权分置改革方案，非流通股股东共支付给流通股股东 2,816 万股股票，以此换取所持有非流通股股份的上市流通权。2005 年 12 月 23 日，长电科技刊登《股权分置改革方案实施公告》。股权分置改革方案实施后，股本结构如下：

股份类别	数量（股）	比例（%）
有限售条件的流通股	176,432,000	60.30
其中：江阴新潮科技集团有限公司	58,425,348	19.97
上海华易投资有限公司	40,007,562	13.67
江阴长江电子有限公司	13,006,484	4.45
厦门永红电子有限公司	9,147,098	3.13
江苏法泰投资有限公司	10,914,010	3.73
苏州工业园区海竞置业有限公司	10,914,009	3.73
杭州士兰微电子股份有限公司	8,981,833	3.07
青岛海协信托投资有限公司	8,000,000	2.73
宁波康强电子股份有限公司	6,258,541	2.14
连云港华威电子集团有限公司	5,777,115	1.97
江苏瑞华投资发展有限公司	5,000,000	1.71
无限售条件的流通股	116,160,000	39.70
股份总额	**292,592,000**	**100.00**

（4）2007 年非公开发行股票

2006 年 8 月 18 日，经 2006 年第二次临时股东大会审议通过并经中国证监会证监发行字（2007）2 号文核准，长电科技于 2007 年 1 月 16 日完成了非公开发行股票的实施工作，发行价格为 8.01 元/股，发行数量为 8,000 万股，募集资金金额为 64,080 万元，募集资金净额为 63,271 万元。长电科技于 2007 年 1 月 30 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。发行完成后，股本总额增加至 37,259.20 万股。2007 年 1 月 17 日江苏公证会计师事务所有限公司对此次转增出具了苏公 W（2007）第 B001 号验资报告。本次非公开发行完成后，股权结构如下：

股份类别	数量（股）	比例（%）
有限售条件的流通股	198,631,329	53.31
无限售条件的流通股	173,960,671	46.69
股份总额	**372,592,000**	**100.00**

本次发行完成后，前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	限售 A 股（股）	流通 A 股（股）	合计数量（股）	比例（%）
1	江苏新潮科技集团有限公司	58,425,348	0	58,425,348	15.68
2	上海华易投资有限公司	25,377,962	2,881,275	28,259,237	7.58
3	厦门永红电子有限公司	10,000,000	7,252,098	17,252,098	4.63
4	无锡宝联投资有限公司	15,000,000	0	15,000,000	4.03
5	信诚精粹成长证券投资基金	9,000,000	5,062,701	14,062,701	3.77
6	江苏法泰投资有限公司	10,914,010	0	10,914,010	2.93
7	苏州海竞信息科技集团有限公司	10,914,009	0	10,914,009	2.93
8	江阴长江电子有限公司	10,000,000	0	10,000,000	2.68
9	浙江硅谷天堂鲲诚创业投资有限公司	10,000,000	0	10,000,000	2.68
10	普丰证券投资基金	0	9,988,888	9,988,888	2.68

（5）2008 年资本公积金转增股本、送股

2008 年 4 月 18 日，2007 年度股东大会审议通过利润分配方案。长电科技以 2007 年 12 月 31 日总股本 37,259.20 万股为基数，每 10 股送红股 2 股，同时转增 8 股，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份总额 37,259.20 万股。此次分配完成后，总股本由 37,259.20 万股变更为 74,518.40 万股，该方案于 2008 年 5 月 29 日正式实施完毕。2008 年 4 月 30 日，江苏公证会计师事务所有限公司对此次转增、送股出具了苏公 W（2008）第 B062 号验资报告。本次转增、送股完成后，股本结构如下：

股份类别	数量（股）	比例（%）
有限售条件的流通股	145,011,920	19.46
无限售条件的流通股	600,172,080	80.54
股份总额	**745,184,000**	**100.00**

（6）2010 年配股

2010 年 1 月 15 日，长电科技 2010 年第一次临时股东大会审议通过了配股预案，即以 2009 年 12 月 31 日发行人股本总额 745,184,000 股为基数，按 10:1.5 比例向全体股东配售股份，配股价格为每股 5.69 元，长电科技控股股东新潮集团承诺以现金方式全额认配其可配售的股份数。2010 年 9 月 20 日，本次配股获得中国证监会证监许可〔2010〕1328 号文核准。

本次配股完成后，股本增加 107,949,610 股，募集资金总额为 61,423.33 万元，扣除发行费用后募集资金净额 59,671.16 万元，长电科技总股本增至 853,133,610 股。2010 年 10 月 22 日江苏公证天业会计师事务所有限公司对此次配股出具了苏公 W（2010）第 B106 号验资报告。配股完成后，股本结构如下：

股份类别	数量（股）	比例（%）
有限售条件的流通股	0	0
无限售条件的流通股	853,133,610	100.00
股份总额	**853,133,610**	**100.00**

本次发行完成后，前十大股东持股情况如下：

序号	股份名称	数量（股）	比例（%）
1	江苏新潮科技集团有限公司	138,927,411	16.28
2	宁波康强电子股份有限公司	6,670,000	0.78
3	中原证券股份有限公司	5,500,000	0.64
4	滕燕清	2,161,770	0.25
5	中国工商银行股份有限公司—广发中证500 指数证券投资基金（LOF）	2,004,667	0.23
6	陈华明	1,840,000	0.22
7	中国工商银行股份有限公司—上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金	1,747,281	0.20
8	北京中电兴发科技有限公司	1,700,000	0.20
9	任昕	1,615,290	0.19
10	易会盛	1,592,889	0.19

（7）2014 年 9 月非公开发行股票

根据长电科技第五届第十次临时董事会决议、第五届第十一次临时董事会决议和 2013 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】874 号《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，长电科技获准非公开发行不超过 235,404,896 股新股。

2014 年 9 月 24 日江苏公证天业会计师事务所有限公司对此次配股出具了苏公 W（2014）第 B103 号验资报告。截至 2014 年 9 月 23 日止，长电科技发行人民币普通股（A 股）131,436,390 股，发行价格为 9.51 元/股，应募集资金总额为 1,249,960,068.90 元，募集资金净额：1,186,332,625.62 元。本次非公开发行后累计实收资本（股本）由人民币 853,133,610.00 元变为 984,570,000.00 元。

本次发行对象及限售期

序号	发行对象名称	认购数量（股）	限售期
1	无锡坤然股权投资企业（有限合伙）	26,288,117	12 个月
2	易方达基金管理有限公司	21,030,494	12 个月
3	王世忱	21,030,494	12 个月
4	兴业全球基金管理有限公司	14,931,650	12 个月
5	财通基金管理有限公司	13,144,058	12 个月
6	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	13,144,058	12 个月
7	国泰基金管理有限公司	13,144,058	12 个月
8	国联安基金管理有限公司	8,723,461	12 个月
合　　计		131,436,390	

本次发行完成后，前十大股东持股情况如下：

序号	股份名称	数量（股）	比例（%）
1	江苏新潮科技集团有限公司	138,927,411	14.11
2	无锡坤然股权投资企业（有限合伙）	26,288,117	2.67
3	王世忱	21,530,494	2.19
4	全国社保基金五零二组合	21,030,494	2.14
5	中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	18,400,000	1.87

6	泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	17,208,205	1.75
7	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	13,144,058	1.34
8	兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	12,243,105	1.24
9	中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	8,852,721	0.90
10	国联安基金-工商银行-华融信托-华融·海西晟乾 2 号权益投资集合资金信托计划	8,723,461	0.89

三、长电科技最近三年的控制权变动

本公司最近三年的控制权未发生变动，第一大股东为江苏新潮科技集团有限公司，实际控制人为王新潮先生。

四、长电科技控股股东和实际控制人基本情况

（一）控股股东基本情况

公司名称：江苏新潮科技集团有限公司

企业性质：有限公司（自然人控股）

成立日期：2000 年 9 月 7 日

注册地址：江阴市滨江开发区澄江东路 99 号

法定代表人：王新潮

注册资本：5,435 万元

经营范围：一般经营项目：光电子、自动化设备、激光器、应用产品、模具的研制、开发、生产、销售；机械精加工；对电子、电器、机电等行业投资。

（二）实际控制人情况

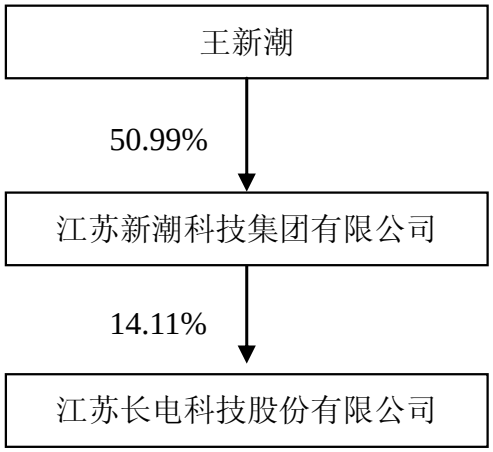
江苏长电科技股份有限公司董事长王新潮先生持有江苏新潮科技集团有限公司 50.99%的股权，为新潮集团的控股股东，新潮集团持有长电科技 138,927,411 股，占股本总额的 14.11%，为长电科技第一大股东，王新潮先生为长电科技的实际控制人。

王新潮，董事长，男，1956 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，博士，高级经济

师，东南大学兼职研究员，兼任集成电路封测产业链技术创新战略联盟理事长，高密度集成电路封装技术国家工程实验室理事长，中国半导体行业协会副理事长。历任江阴市晶体管厂党总支书记、副厂长，江阴长江电子实业公司总经理、党总支书记，江阴长江电子实业有限公司董事长、总经理、党总支书记，江苏长电科技股份有限公司董事长、董事。2005 年被国家信息产业部评为半导体行业九大领军人物之一，信息产业系统全国劳动模范。2009 年评为中国电子元器件行业十大风云人物，江阴市时代先锋，2011 年中国专利金奖发明人、江阴市十佳科技创新创业人才。

（三）实际控制人与本公司之间的股权控制关系

实际控制人与本公司之间的股权控制关系如下图所示：



五、长电科技最近三年重大资产重组情况

本公司最近三年未进行重大资产重组。

六、长电科技主营业务发展情况

作为国内第一家半导体封装测试行业上市企业，长电科技业务规模持续增长，位居世界前列。长电科技已经掌握一系列高端集成电路封装测试技术，特别是 WLCSP、Copper Pillar Bumping、SiP、FC、MIS 等封装技术在同行业中处于领先地位。长电科技小型分立器件制造基本达到国际一流水平，产品具有较强的竞争能力和广阔的市场前景。长电科技主要面向的客户为国际芯片设计制造厂商，产品则主要定位于消费电子、电源管理和汽车电子等应用领域。

（一）按业务划分的营业收入构成

本公司最近三年一期按业务性质划分的营业收入构成及其变化情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月		2013 年		2012 年		2011 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	469,159.60	99.69%	508,076.17	99.58%	442,053.35	99.65%	371,823.05	98.83%
其他业务收入	1,475.14	0.31%	2,129.84	0.42%	1,562.62	0.35%	4,420.20	1.17%
合计	**470,634.74**	**100.00%**	**510,206.01**	**100.00%**	**443,615.97**	**100.00%**	**376,243.25**	**100.00%**

资料来源：公司定期报告

近三年及一期，本公司营业收入总额分别为 376,243.25 万元、443,615.97 万元、510,206.01 万元和 470,634.74 万元，同比呈现逐步上升的趋势，其中各期主营业务收入占营业收入总额的比例均在 98%以上，本公司主营业务突出。

（二）按区域划分的主营业务收入构成

本公司最近三年一期按区域划分的主营业务收入构成及其变化情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月		2013 年		2012 年		2011 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
境内	174,740.81	37.25%	214,186.75	42.16%	171,158.42	38.72%	157,060.87	42.24%
境外	294,418.79	62.75%	293,889.42	57.84%	270,894.93	61.28%	214,762.18	57.76%
合计	**469,159.60**	**100.00%**	**508,076.17**	**100.00%**	**442,053.35**	**100.00%**	**371,823.05**	**100.00%**

资料来源：公司定期报告

从主营业务收入区域构成分析，最近三年，本公司境外销售收入占比相对较高。报告期各期，境外销售收入分别为 214,762.18 万元、270,894.93 万元、293,889.42 万元和 294,418.79 万元，占主营业务收入的比例分别为 57.76%、61.28%、57.84%和 62.75%。

（三）按产品划分的主营业务收入构成

最近三年一期本公司按产品划分的主营业务收入构成及其变化情况如下：

单位：万元

产品	2014 年 1-9 月		2013 年		2012 年		2011 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
引线框类集成电路	170,228.11	36.29%	175,918.41	34.62%	169,337.19	38.31%	132,935.76	35.75%
分立器件	103,323.61	22.02%	126,580.90	24.91%	126,501.04	28.62%	121,518.25	32.68%
圆片级集成电路	96,559.90	20.58%	91,842.23	18.08%	76,321.62	17.27%	72,372.02	19.46%
基板类集成电路	52,741.16	11.24%	64,853.05	12.76%	38,607.92	8.73%	17,467.26	4.70%
摄像头模组	26,540.31	5.66%	21,261.55	4.18%	4,072.42	0.92%	-	-
芯片销售	19,766.51	4.21%	27,620.04	5.44%	27,213.15	6.16%	27,529.75	7.40%
合计	469,159.60	100.00%	508,076.17	100.00%	442,053.35	100.00%	371,823.05	100.00%

资料来源：公司定期报告

最近三年及一期，本公司主营业务收入分别为 371,823.05 万元、442,053.35 万元、508,076.17 万元和 469,159.60 万元，主营业务收入稳步提升。

引线框类集成电路和分立器件作为本公司传统主导产品，在主营业务收入中占比较高，报告期各期该两类产品收入总额分别达到 254,454.02 万元、295,838.22 万元、302,499.31 万元和 273,551.71 万元，占各期主营业务收入比例均在 55%以上。

圆片级集成电路作为本公司最具竞争力的优势产品，是主营业务的重要组成部分，报告期各期该类产品收入总额分别达到 72,372.02 万元、76,321.62 万元、91,842.23 万元和 96,559.90，占各期主营业务收入比例均在 17%以上。

基板类集成电路及摄像头模组作为本公司产品结构调整中重点开发的高端产品，报告期内各期该两类产品规模出现快速增长，占营业收入比例逐步提升。报告期各期该两类产品收入总额分别达到 17,467.26 万元、42,680.35 万元、86,114.60 万元和 79,281.47，占主营业务收入比例分别为 4.70%、9.66%、16.94%和 16.90%。

芯片销售是本公司运用芯片封测技术进行芯片产业链自主品牌开发的产品，报告期内，芯片销售收入相对稳定，分别为 27,529.75 万元、27,213.15 万元、27,620.04 万元和 19,766.51 万元。

七、长电科技最近三年及一期主要财务指标

根据本公司 2011 年、2012 年、2013 年经审计的财务报告及 2014 年前三季度未经审计的财务报告，本公司最近三年及一期的主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产总额	1,001,115.69	758,252.66	701,037.93	601,648.32
其中：货币资金	264,679.25	86,925.11	69,529.97	62,794.20
负债总额	603,029.84	494,263.02	441,482.10	345,968.21
其中：流动负债合计	496,658.93	393,770.25	384,135.56	274,475.42
股东权益	398,085.85	263,989.64	259,555.82	255,680.11
归属于母公司股东权益	373,383.31	243,235.16	242,276.73	241,236.05

资料来源：公司定期报告

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年	2012 年	2011 年
营业总收入	470,634.74	510,206.01	443,615.97	376,243.25
营业利润	18,186.38	2,680.48	-15,025.63	683.54
利润总额	20,608.51	7,850.98	6,061.90	10,330.60
归属于母公司股东的净利润	12,689.78	1,112.22	1,041.00	6,731.71

资料来源：公司定期报告

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年	2012 年	2011 年
经营活动产生的现金流量净额	59,639.60	81,032.23	50,625.23	48,459.33
投资活动产生的现金流量净额	-59,810.38	-114,452.63	-101,952.45	-153,519.52

项目	2014 年 1-9 月	2013 年	2012 年	2011 年
筹资活动产生的现金流量净额	177,957.81	39,666.07	54,800.35	95,938.29
现金及现金等价物净增加额	177,672.85	4,513.11	3,433.92	-9,890.81

资料来源：公司定期报告

（四）主要财务指标

单位：元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年	2012 年	2011 年
基本每股收益（元）	0.15	0.01	0.01	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-0.0006	-0.20	-0.04
加权平均净资产收益率（%）	5.10	0.46	0.43	2.80
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	2.84	-0.02	-7.16	-1.57
每股经营活动产生的现金流量净额	0.61	0.95	0.59	0.57
归属于母公司股东的每股净资产	3.79	2.85	2.84	2.83

资料来源：公司定期报告

八、长电科技最近三年未受到行政处罚或刑事处罚

长电科技未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，亦未涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；最近三年未受到行政处罚或刑事处罚。

九、本次交易的收购主体

长电科技为本次收购之目的在苏州工业园区成立了一家特殊目的公司长电新科，产业基金和芯电半导体将根据《共同投资协议》的约定对其进行增资；长电新科为本次收购之目的在苏州工业园区设立了长电新朋，产业基金将根据《共同投资协议》的约定对其进行增资；长电新朋为本次收购之目的在新加坡设立 JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.作为融资平台进行并购贷款融资，并作为本次收购的实施主体，即要约人。长电新科、长

电新朋、JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.基本情况如下：

1、长电新科

名称：苏州长电新科投资有限公司

注册号：320594000363375

住所：苏州工业园区旺墩路 188 号建屋大厦二层 201-5 室

法定代表人：王新潮

注册资本：1000 万元整

成立日期：2014 年 11 月 19 日

经营范围：实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、长电新朋

名称：苏州长电新朋投资有限公司

注册号：320594000365657

住所：苏州工业园区旺墩路 188 号建屋大厦二层 201-6 室

法定代表人：王新潮

注册资本：1000 万元整

成立日期：2014 年 11 月 27 日

经营范围：实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.

本次交易将以本公司间接控股之 JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.作为收购主体，该公司具体情况如下：

英文名称：JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.

主要营业范围：投资控股

注册资本：1 美元

成立时间：2014 年 12 月 19 日

注册证号：201437735C

注册地址：10 COLLYER QUAY #10-01，OCEAN FINANCIAL CENTRE，SINGAPORE (049315)

第三章 本次收购的交易对方

一、交易对方概况

本次交易方式为要约收购，即本公司与联合投资者通过为本次交易之目的所设立的子公司 JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.收购目标公司全体股东持有的全部股份。由于目标公司为一家在新加坡证券交易所上市的公司，因此交易对方为目标公司的所有股东，其最大的股东为淡马锡全资子公司 STSPL，持有目标公司 1,845,715,689 股普通股，占目标公司目前总股份数的 83.8%。

二、主要交易对方的基本情况

持有目标公司 5%以上普通股的股东仅有 Singapore Technologies Semiconductors Pte Ltd 一家，其基本情况如下：

企业名称： Singapore Technologies Semiconductors Pte Ltd

企业性质： 淡马锡全资持有的非上市公司

成立日期： 1995 年 4 月 29 日

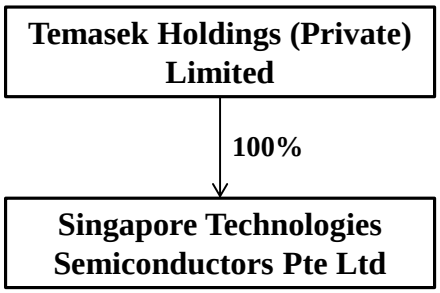
注册地：新加坡

主要办公地点：60B Orchard Road #06-18 Atrium @ Orchard, The Singapore (238891)

董事： Leong Wai Leng、Khoo Ken Hui

控股股东：Temasek Holdings (Private) Limited

Singapore Technologies Semiconductors Pte Ltd 股权结构如下：



经营情况：STSPL 为一家投资持股公司。公司最近三年注册资本未发生变动。公

司实际控制人淡马锡成立于 1974 年 6 月 25 日，是一家设立在新加坡的投资公司，由新加坡财政部全资持有。淡马锡在全球拥有 11 个办事处，截止于 2014 年 3 月 31 日，淡马锡拥有的投资组合价值高达 2,230 亿新元，主要集中在新加坡和亚洲地区。淡马锡投资了包括中国银行、中国工商银行、太平洋保险、新加坡航空、昆仑能源在内的诸多世界一流企业。

三、主要交易对方最近三年主要财务指标

主要交易对方 2011 年、2012 年、2013 年母公司主要财务数据如下：

（一）资产负债表主要数据

单位：百万美元

项目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产总额	996.08	1,127.37	1,342.96
负债总额	34.98	34.82	34.63
股东权益	961.10	1,092.55	1,308.33

资料来源：ACRA[1]

（二）利润表主要数据

单位：百万美元

项目	2013 年	2012 年	2011 年
收入	-	-	-
管理费用	0.16	0.19	0.13
其他费用	131.29	215.59	834.40
税前利润	(131.45)	(215.78)	(834.52)
所得税费用	-	-	-
净利润	(131.45)	(215.78)	(834.52)

资料来源：ACRA

[1] ACRA：The Accounting and Corporate Regulatory Authority，即新加坡会计与企业管理局，是新加坡企业实体和公共会计的国家监管机构，新加坡所有企业均需在 ACRA 进行注册，并在其网站披露相关信息

（三）现金流量表主要数据

单位：百万美元

项目	2013 年	2012 年	2011 年
经营活动产生的现金流量净额	-	-	(0.02)
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	0.02
现金及现金等价物净增加额	-	-	-

资料来源：ACRA

四、关于主要交易对方的其他说明

（一）主要交易对方与长电科技的关联关系说明

上述主要交易对方与本公司不存在任何关联关系，也不存在向本公司推荐董事或高级管理人员的情况。

（二）主要交易对方及其主要管理人员最近五年内受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

截至本报告书签署日，STSPL 及其主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。

第四章 目标公司基本情况

一、目标公司概况

法定名称：STATS ChipPAC Ltd.

注册地址：10 Ang Mo Kio Street 65, # 05-17/20, Techpoint, Singapore (569059)

办公地址：10 Ang Mo Kio Street 65, # 05-17/20, Techpoint, Singapore (569059)

首席执行官：Tan Lay Koon

注册资本：2,343,908,031.29 新加坡元

注册号：199407932D

成立日期：1994-10-31

上市地：新加坡交易所(SGX-ST)

证券代码：STATSChP

公司网址：http://www.statschippac.com/

主营业务：提供涵盖封装设计、焊锡凸块、针探、组装、测试、配送等一整套半导体解决方案

二、目标公司主要历史沿革

（一）目标公司成立

1994 年 10 月 31 日，目标公司前身 ST Assembly Test Services, Ltd（简称“STATS”）成立，主要从事半导体封装测试业务。

（二）ChipPAC, Inc 成立并上市

1997 年，ChipPAC, Inc（简称“ChipPAC”）成立，办公地址位于加利弗尼亚的费利蒙市，并在纳斯达克挂牌交易（纳斯达克交易代码：CHPC）。ChipPac 经营半导体测试和封装业务，是可满足包括覆晶、芯片级和堆叠芯片技术在内的用于无线通信的半导体需求的先进封装服务领域的公司。

（三）STATS 上市

2000 年 1 月，STATS 在纳斯达克全国市场和新加坡证券交易所挂牌上市（纳斯达克交易代码：STTS ；新加坡证券交易所代码：ST Assembly）。

（四）STATS 收购 Winstek

2001 年 8 月，STATS 宣布完成对台湾 Winstek Semiconductor Corporation（简称“Winstek”）51%股权的收购。Winstek 是一家具有光纤、混合信号、数字和无线频率（RF）器件的测试能力的公司，并能够提供包括晶圆检测、最终测试、交钥匙承包在内的服务并可直接向客户交货。该公司在台湾新竹县有一座 220,000 平方英尺的 4 层楼工厂，并在加利福尼亚的圣何塞市设有一个技术支持办事处。STATS 和 ChipPAC 合并后，目标公司将 Winstek 改名为 STATS ChipPAC Taiwan Semiconductor Corporation。

（五）STATS 收购 Conexant Systems 公司位于圣地亚哥的测试业务

2002 年 12 月 20 日，STATS 通过其子公司 FastRamp Test Services（简称“FastRamp”）收购 Conexant Systems（简称“Conexant”）公司在圣地亚哥的测试工厂，获得其宽带通讯测试平台业务，其中主要资产包括：混合信号测试仪、测试操作器以及探针设备。该交易还包括 Conexant 和 FastRamp 之间的长期测试服务合同。

（六）STATS 与 ChipPac, Inc 合并

2004 年 8 月，STATS 和 ChipPac, Inc 合并，同时目标公司名称由 STATS 变更为 STATS ChipPAC Ltd.，从而形成全球领先的独立半导体封装和测试解决方案公司。合并后，目标公司产品组合囊括最先进的测试和封装技术，如：混合信号测试、条式测试、芯片级、堆叠芯片、倒装、晶圆级和系统级封装技术以及晶圆凸块批量生产能力。

（七）目标公司台湾子公司在台湾交易所上市

2005 年 8 月，目标公司子公司 STATS ChipPAC Taiwan Semiconductor Corporation 在台湾交易所柜台买卖市场（OTC）IPO 挂牌交易。

（八）淡马锡要约收购目标公司

2007 年 3 月，淡马锡通过全资子公司 STSPL 向目标公司发出收购全部已发行股份的要约，并最终以每股 1.75 新元完成要约收购。要约收购后，淡马锡持股比例由 35.6%

上升至 83.1%。

（九）目标公司收购 LSI Corp.位于泰国的测试和组装业务

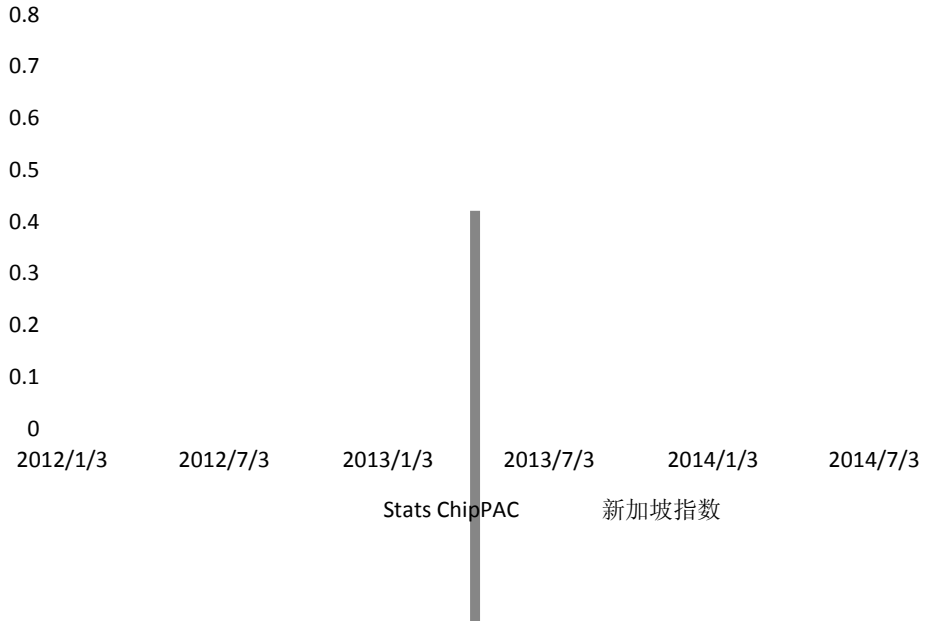
2007 年 10 月，目标公司以 1 亿美元收购 LSI Corp.位于泰国的组装和测试业务。

（十）目标公司最近三年增减资情况及股价走势

目标公司为新加坡上市公司，最近三年未发生增减资，亦不涉及评估或改制的情况。

截至 2014 年 12 月 19 日，目标公司股价为 0.435 新加坡元/股，市值为 9.58 亿新加坡元，对应 2013 年市净率为 0.82，市销率为 0.47，因 2013 年亏损，相应市盈率无参考价值。目标公司股价走势如下图：

图：2012 年起目标公司股价走势



数据来源：Bloomberg，新加坡指数数据经标准化处理

三、目标公司股权结构

（一）收购前目标公司股权结构

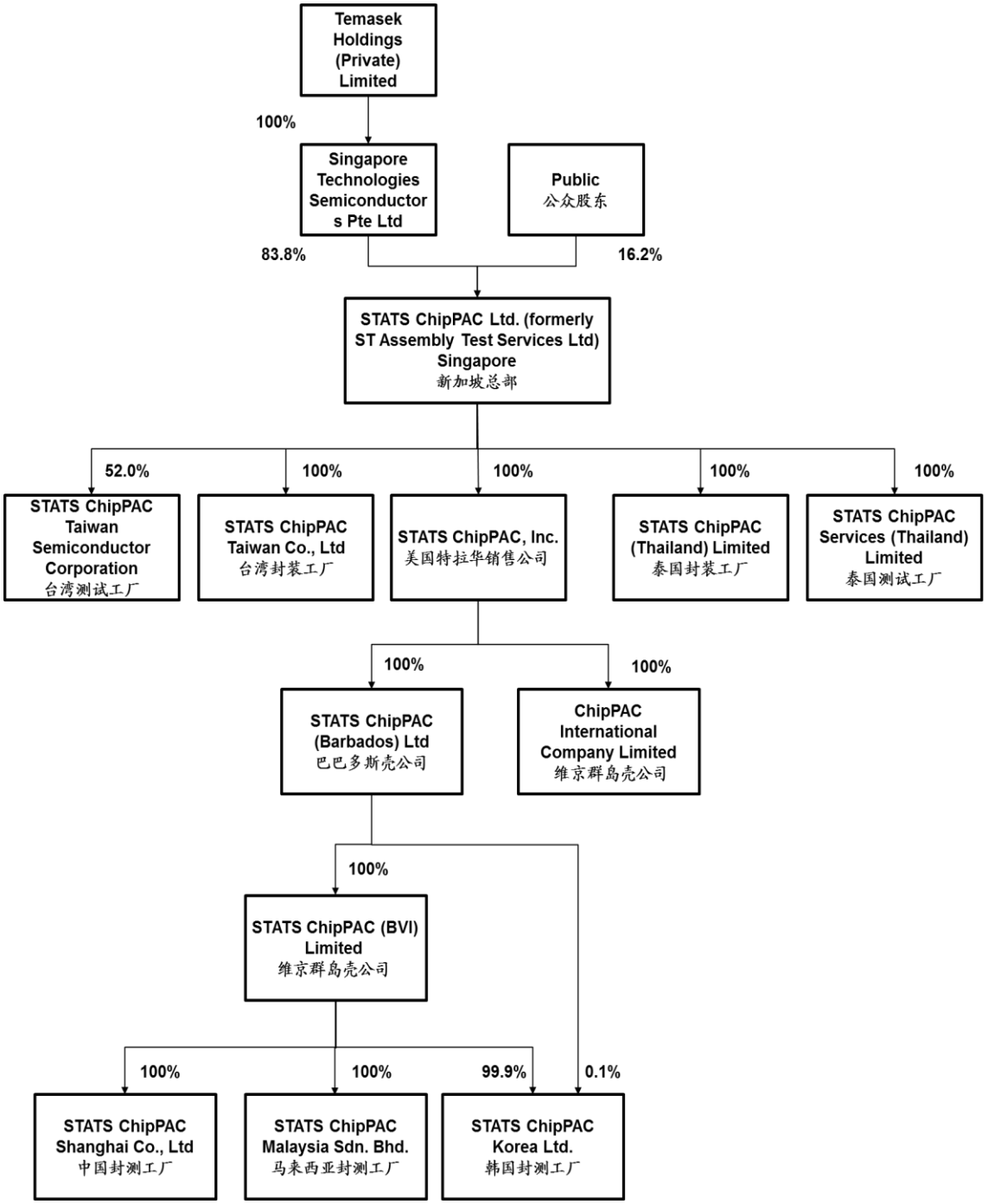
截至本报告书出具之日，目标公司已发行的股份总数为 2,202,218,293 股。

根据法律尽调结果，目标公司不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。

1、持有目标公司 5%以上普通股股东

截至本报告书出具之日，持有目标公司 5%以上普通股的股东仅 STSPL 一家。STSPL 是淡马锡的全资子公司，持有目标公司 83.8%的股份。在 2000 年 STATS 上市时，淡马锡持有目标公司共计 72.1%的股。2004 年 8 月 STATS 与 ChipPAC 换股合并之后，STSPL 持股比例降至 36.7%。在 2007 年 3 月要约收购前，STSPL 持股比例为 35.6%。以每股 1.75 新元完成要约收购后，STSPL 持股比例上升至 83.1%。之后通过可转债行权，于 2008 年年末淡马锡持股比例上升为 83.8%，之后未发生重大变化。

2、收购前目标公司及其主要子公司组织架构图

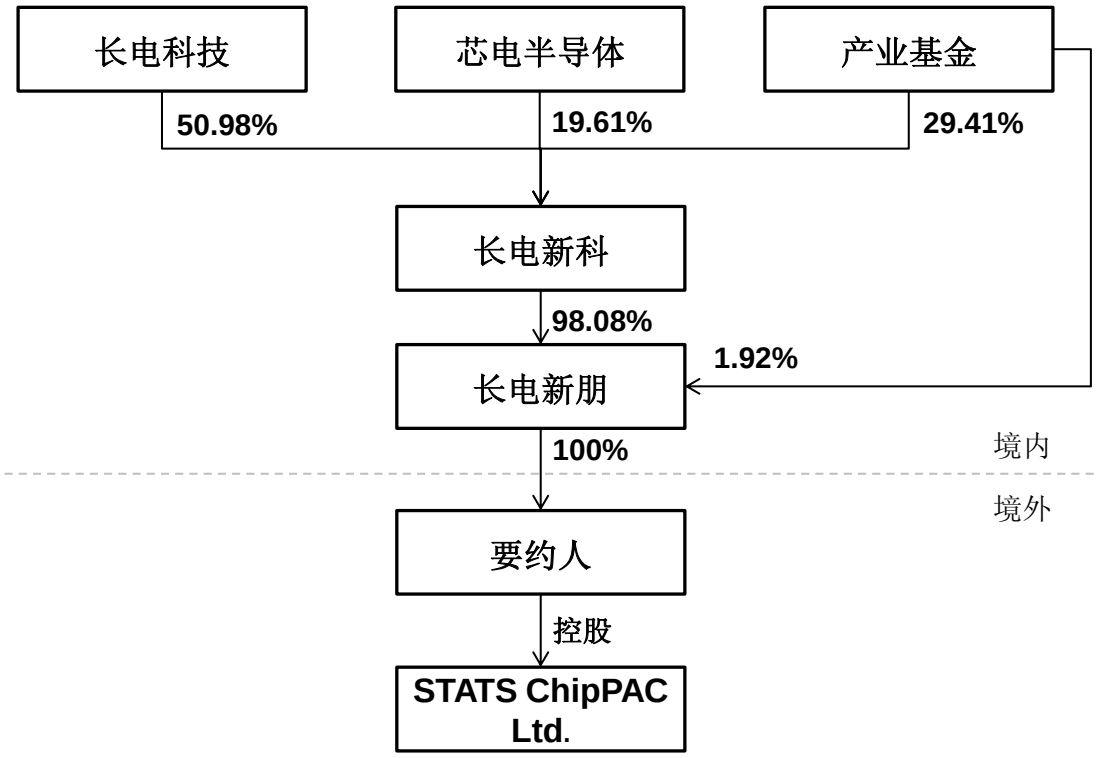


资料来源：目标公司年报

注：上图仅包括了目标公司的主要子公司，未包括所有子公司；目标公司泰国两家工厂、马来西亚工厂处于待关闭状态

（二）收购完成后目标公司股权结构

本次交易完成后，如果目标公司实现退市，则本次要约收购的主体 JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.将持有目标公司 100%股权。JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.为长电新朋的全资子公司，长电新朋的股东为长电新科及产业基金，其中长电新科持有长电新朋 98.08%的股权，产业基金持有长电新朋 1.92%的股权。长电科技将持有长电新科 50.98%的股权，为长电新科控股股东，产业基金持有长电新科 29.41%的股权，芯电半导体持有长电新科 19.61%的股权，收购完成后，目标公司股权结构如下图所示：



四、目标公司下属子公司情况

（一）目标公司下属主要子公司架构

目标公司管理总部位于新加坡，在新加坡、韩国、中国上海、中国台湾和马来西亚经营 5 个半导体封装制造及测试工厂和 2 个研发中心，同时在美国、韩国、日本、中国、新加坡、马来西亚、台湾和瑞士拥有销售团队。

截至本报告书出具之日，目标公司在新加坡、美国、中国、韩国等地有 14 家子公

司，其中 13 家为 100%持股。

（二）主要子公司情况

1、目标公司主要子公司基本情况

公司名称	注册地	持股比例	主营业务
STATS ChipPAC (Barbados) Ltd.	巴巴多斯	100%	持股公司
STATS ChipPAC (BVI) Limited	英属维尔京群岛	100%	持股公司、半导体封装测试、仓储服务以及直达货运服务输
STATS ChipPAC Korea Ltd.	韩国	100%	半导体封装及测试、研发、仓储服务以及直达货运服务输
STATS ChipPAC Shanghai Co., Ltd	中国	100%	半导体封装（含倒装）及测试、仓储服务以及直达货运服务输
STATS ChipPAC, Inc.	美国特拉华	100%	销售、市场营销及研发
STATS ChipPAC Malaysia Sdn. Bhd.	马来西亚	100%	半导体封装及测试、仓储服务以及直达货运服务输
STATS ChipPAC Taiwan Co., Ltd.	中国台湾	100%	封装服务（含晶圆级封装及倒装）
STATS ChipPAC Taiwan Semiconductor Corporation	中国台湾	52%	测试服务、研发、仓储服务以及直达货运服务

资料来源：目标公司定期报告

五、目标公司员工情况

目标公司员工由直接人工、间接人工、行政管理人员和研发人员四大类人员组成，其人员结构以生产人员为主，占人员总数的 90%以上。各类员工具体分布情况如下表所示：

	2012 年末	2013 年末	2014 年 6 月末
直接人工	6,642	7,013	7,026
间接人工	2,659	2,767	2,791
行政管理员工	656	679	699
研发人员	366	294	277
合计	**10,323**	**10,753**	**10,793**

资料来源：目标公司管理层提供

注：直接人工指公司在生产产品过程中，直接从事产品生产的工人。间接人工指车间管理人员等非直接从事产品生产的工人。直接、简介人工划分依据是生产工人是否与所生产的产品直接相关。

截至 2014 年 6 月，各地区员工人数如下：

地区	新加坡	韩国	中国	马来西亚	中国台湾	美国	泰国
员工数	3,055	2,226	3,545	979	841	112	35
占比	*28.3%*	*20.6%*	*32.8%*	*9.1%*	*7.8%*	*1.0%*	*0.3%*

资料来源：目标公司管理层提供

六、目标公司主要资产负债情况

（一）主要资产情况

1、资产概况

根据星科金朋公布的三季报，截至 2014 年 9 月 28 日，目标公司总资产 263,210.4 万美元，其中流动资产 54,318.6 万美元，非流动资产 208,891.8 万美元。

目标公司流动资产包括货币资金、短期定期存款、应收账款和存货等；非流动资产主要为长期定期存款、固定资产、递延所得税资产、商誉和无形资产。具体构成如下：

单位：千美元

项目	2014 年 9 月末	2013 年末	2012 年末
流动资产			
货币资金	115,609	129,136	170,558
短期定期存款	61,987	42,042	39,601
应收账款	229,728	238,441	258,043

项目	2014 年 9 月末	2013 年末	2012 年末
其他应收款	33,785	15,239	20,726
存货	77,888	71,055	90,203
预付费用以及其他流动资产	24,189	18,970	24,559
流动资产合计	543,186	514,883	603,690
非流动资产			
长期定期存款	425	11,604	489
固定资产净值	1,668,817	1,431,247	1,242,950
无形资产	34,599	35,117	36,361
商誉	381,487	381,487	381,487
递延所得税资产	185	186	-
预付费用以及其他非流动资产	3,405	3,146	3,299
非流动资产合计	2,088,918	1,862,787	1,664,586
资产总计	2,632,104	2,377,670	2,268,276

资料来源：目标公司定期报告

2、固定资产

截至 2014 年 6 月末，目标公司固定资产账面净值 158,689.7 万美元，主要包括自有土地、土地使用权、房屋建筑、机械及电子设备以及其他设备。目标公司固定资产明细如下表所示：

单位：千美元

项目	2012 年末	2013 年末	2014 年 6 月末
原值：			
自有土地	9,946	9,738	9,738
土地使用权	19,864	19,864	19,864
房屋建筑、在建工程、机械及电子设备	362,227	433,589	513,684
设备	2,915,156	3,139,803	3,327,063
小计	3,307,193	3,602,994	3,870,349
减：累计折旧	2,064,243	2,171,747	2,283,452

项目	2012 年末	2013 年末	2014 年 6 月末
固定资产净值	1,242,950	1,431,247	1,586,897

资料来源：目标公司定期报告及管理层提供数据（目标公司未提供截至 2014 年 9 月末的数据）

截至 2014 年 6 月末，目标公司总部及各子公司土地、房屋建筑（含在建工程和机械及电子设备）账面价值情况如下：

单位：千美元

项目	账面原值	累计折旧/摊销	账面净值
自有土地（所在地）			
STATS ChipPAC Taiwan Semiconductor Corporation（台湾）	6,504	-	6,504
STATS ChipPAC Korea Ltd.（韩国）	3,234	-	3,234
合计	**9,738**	-	**9,738**
土地使用权（所在地）			
STATS ChipPAC Shanghai Co., Ltd（上海）	4,042	1,631	2,411
STATS ChipPAC Malaysia Sdn. Bhd.（马来西亚）	15,822	7,889	7,933
合计	**19,864**	**9,520**	**10,344**
房屋建筑、在建工程、机械及电子设备（所在地）			
STATS ChipPAC Limted.（新加坡）	170,754	71,436	99,318
STATS ChipPAC Korea Ltd.（韩国）	127,737	19,046	108,691
STATS ChipPAC Shanghai Co., Ltd（上海）	133,629	40,339	93,290
STATS ChipPAC Malaysia Sdn. Bhd.（马来西亚）	28,752	25,133	3,619
STATS ChipPAC, Inc.（美国）	4,148	4,063	85
STATS ChipPAC Taiwan Co., Ltd（台湾）.	20,339	10,321	10,018
STATS ChipPAC Taiwan Semiconductor Corporation（台湾）	28,325	20,206	8,119
合计	**513,684**	**190,544**	**323,140**

资料来源：目标公司管理层提供

上述资产中，自有土地及土地使用权的相关信息如下：

不动产地址	所有权情况	面积（平方英尺）	用途
No. 176-5, 6 Lin, Hualung Chun, Chiung Lin, 307 Hsin-Chiu Hsien, Taiwan	自有土地	224,879	半导体测试服务、研发、仓储服务以及直达货运服务
342-1 Gakpyong-Ri, Majang-Myeon, Icheon Si, Gyeonggi Province, Korea	自有土地	212,143	半导体封装测试服务、研发、仓储服务以及直达货运服务
中国青浦区华徐公路 188 号	土地使用权	983,276	半导体封装（含倒装）及测试、仓储服务以及直达货运服务
73 Lorong Enggang, Ulu Klang Free Trade Zone 54200 Kuala Lumpur	土地使用权	488,448	半导体封装及测试、仓储服务以及直达货运服务

资料来源：目标公司管理层提供

此外，目标公司在新加坡、韩国、马来西亚和美国有不动产租赁，其中目标公司位于新加坡的不动产租赁具体情况如下表所示：

不动产所在地	合同（租赁/许可）*	开始日	到期日
5 Yishun Street 23, Singapore 768442	租赁	1996 年 3 月 1 日	2026 年 3 月 1 日
	许可	1996 年 3 月 1 日	2026 年 3 月 1 日
2 Woodlands Sector 1, #01-20, Singapore 738068	租赁	2014 年 10 月 23 日	2017 年 10 月 22 日
	许可	2014 年 10 月 23 日	2017 年 10 月 22 日
10 Ang Mo Kio Street 65, #15-17/20, Singapore 569059	租赁	2012 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日

*注：此处租赁是指对土地、厂房的租赁，许可是指该处物业被许可用作工业用途；10 Ang Mo Kio Street 65, #15-17/20, Singapore 569059 不涉及工业用途，故无对应许可。

资料来源：目标公司管理层提供

其中目标公司位于韩国的不动产租赁具体情况如下表所示：

不动产所在地	合同（租赁/许可）	出租方	开始日	到期日
Gonghang-dong-ro, Jung-gu, Incheon Metropoitan City	租赁	Incheon Int'l Airport Corp.	2013 年 5 月 16 日	2063 年 5 月 15 日
Part of Gyeongchung-dae-ro 2091, Bubal Eup, Icheon-si, Gyeonggi-do	租赁	Hydis Technologies Co., Ltd.	2013 年 11 月 1 日	2017 年 10 月 31 日

不动产所在地	合同（租赁/许可）	出租方	开始日	到期日
1F(part) and 5F, Ami-ri San 136-1, Bubal Eup, Icheon-si, Gyeonggi-do	租赁	Hydis Technologies Co., Ltd.	2014 年 5 月 1 日	2017 年 10 月 31 日
Ami-ri San 136-1, Bubal Eup, Icheon-si, Gyeonggi-do	租赁	SK Hynix Inc.	2005 年 7 月 1 日	2015 年 6 月 31 日
Part of Gyeongchung-dae-ro 2091, Bubal Eup, Icheon-si, Gyeonggi-do	租赁	SK Hynix Inc.	2014 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日

资料来源：目标公司管理层提供

其中目标公司位于马来西亚的不动产租赁具体情况如下表所示：

不动产所在地*	合同（租赁/许可）
PN 7128, Lot 7716, Mukim Ulu Kelang, Gombak, Selangor	租赁
HS (M) 2601, Lot 7666, Mukim Ulu Kelang, Gombak, Selangor	租赁

*注：马来西亚租赁性产权（leasehold）租赁期为 99 年，目标公司两处不动产属于租赁性产权，距到期日仍有较长时间。

资料来源：目标公司管理层提供

其中目标公司位于美国的不动产租赁具体情况如下图所示：

不动产所在地	合同（租赁/许可）	出租方	开始日	到期日
46429 Landing Parkway, Fremont, Alameda, 94538	租赁	Fremont Ventures，LLC	2014 年 4 月 1 日	2020 年 3 月 31 日
Suite 117, 1711 West Greentree Drive in Tempe, Arizona, 85284	租赁	Agave Property Center, LLC	2013 年 3 月 1 日	2018 年 8 月 31 日
9710 Scranton Road, Suite 360, San Diego, 92121	租赁	AZNL-Centrewest, LLC	2014 年 2 月 1 日	2017 年 3 月 31 日
5316 Highway 290 West, Suite 320 Austin, Texas 78735	租赁	Goldstar Investments LTD. & LTM Investments L.P.	2012 年 7 月 1 日	2015 年 7 月 31 日

资料来源：目标公司管理层提供

3、无形资产

目标公司将与并购、开发或购买专利权和用于经营的技术专利相关的直接支出资本

化，形成无形资产原值。截至 2012 年年末、2013 年年末及 2014 年 6 月末，目标公司无形资产账面净值分别为 3,636.1 万美元、3,511.7 万美元、3,479.9 万美元。目标公司截至 2013 年末的无形资产明细表如下表所示：

单位：千美元

	2012 年末			2013 年末			2014 年 6 月末		
	原值	累计摊销	净值	原值	累计摊销	净值	原值	累计摊销	净值
专利、软件及其他	63,430	32,136	31,294	68,814	35,564	33,250	84,184	49,652	34,532
客户关系	99,300	99,300	-	99,300	99,300	-	99,300	99,300	-
技术及知识产权	32,000	26,933	5,067	32,000	30,133	1,867	32,000	31,733	267
商标	7,700	7,700	-	7,700	7,700	-	7,700	7,700	-
合计	**202,430**	**166,069**	**36,361**	**207,814**	**172,697**	**35,117**	**223,184**	**188,385**	**34,799**

资料来源：目标公司定期报告及管理层提供数据（目标公司未提供截至 2014 年 9 月末的数据）

4、商誉

目标公司的商誉来源于 2001 年收购 STATS ChipPAC Taiwan Semiconductor Corporation 及 2004 年收购 ChipPAC, Inc.，并分别于 2011 年及 2012 年对涉及泰国及马来西亚的商誉计提了 2,450 万美元及 2,410 万美元减值准备。由于目标公司于 2013 年开始进行业务重组，逐步将不同地区工厂的同类生产线进行合并，因此目标公司于 2013 年改变了分地区进行商誉减值测试的方法，变更为将全部地区视为单一业务部门（全套半导体芯片委外封装及测试服务）整体进行减值测试。目标公司历史结算日商誉明细如下表所示：

千美元	2012 年末	2013 年末	2014 年 9 月末
韩国	247,747	381,487	381,487
中国	70,305		
马来西亚	53,114		
台湾	1,321		
合计	381,487		

资料来源：目标公司管理层提供

（二）主要负债情况

截至 2014 年 9 月 28 日，目标公司总负债 168,813.4 万美元，其中流动负债为 56,159.8

万美元，非流动负债为 112,653.6 万美元。具体构成如下：

单位：千美元

项目	2014 年 9 月末	2013 年末	2012 年末
流动负债			
应付账款及其他应付款	185,181	138,004	164,301
应付固定资产相关款项	183,681	141,998	42,746
预提费用	105,189	124,640	113,476
应交所得税	14,518	18,207	13,155
短期借款	73,000	37,947	50,690
应付关联方款项	29	100	28
流动负债合计	561,598	460,896	384,396
非流动负债			
长期借款	1,064,314	874,281	792,609
递延所得税负债	46,559	47,476	47,141
其他非流动负债	15,663	24,228	21,532
非流动负债合计	1,126,536	945,985	861,282
负债总计	1,688,134	1,406,881	1,245,678

资料来源：目标公司定期报告

目标公司的非流动负债中包括已发行的总计 8.11 亿美元的优先票据，其中包括将于 2016 年到期的 2 亿美元优先票据，票面利率为 5.375%；以及将于 2018 年到期的 6.11 亿美元优先票据，票面利率为 4.5%。

考虑到本次交易将导致星科金朋控股股东发生变化，星科金朋将根据其现有银行贷款及发行在外的优先票据的相关条款约定进行债务重组。截至本报告书出具之日，长电科技已经为可能发生的相关票据提前赎回或贷款提前偿还进行了债务重组安排，长电科技已与星展银行就债务重组安排签署了委任函，星展银行将通过向目标公司提供上限为 8.9 亿美元的过桥贷款对目标公司进行债务重组，该过桥贷款额度将足够覆盖目标公司全部的债务重组需求，后续星展银行将通过退出贷款及协助目标公司发行债券的方式进一步对目标公司的债务进行替换。

七、目标公司最近三年未受到行政处罚或刑事处罚

目标公司未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，亦未涉嫌违法违规被中国证监会或新加坡证券交易所或新加坡证券业协会立案调查；最近三年未受到行政处罚或刑事处罚。

八、目标公司担保抵押、财务承诺与诉讼情况

（一）目标公司对外担保和抵押情况

截至本报告书签署日，目标公司无对外担保或抵押。

（二）目标公司重大财务承诺情况

截至 2014 年 6 月末，目标公司的合同承诺义务金额约为 5.55 亿美元，具体汇总情况如下表所示：

单位：千美元

	1 年以内	1 至 3 年	3 至 5 年	5 年以上	合计
资本性承诺	246,943	-	-	-	246,943
经营租赁承诺	36,744	19,285	12,644	94,547	163,220
原材料采购承诺	124,211	-	-	-	124,211
专利权及许可权承诺	4,349	8,698	7,634	-	20,681
合计	**412,247**	**27,983**	**20,278**	**94,547**	**555,055**

资料来源：目标公司管理层提供

1、资本性承诺

上述资本性承诺中，约有 1.18 亿美元与韩国工厂搬迁及新工厂的建设相关。

2、经营租赁承诺

目标公司在新加坡、韩国及美国签订了生产及办公场所的租赁合同，同时在韩国、马来西亚和中国签订了土地租赁合同。经营租赁承诺中，大部分与在建的韩国新工厂租赁的土地及机器设备相关，一年以内、一至三年、三至五年以及五年以上相应的金额约分别为 430 万美元、1,030 万美元、1,030 万美元以及 8,960 万美元。

3、原材料采购承诺

目标公司与部分供应商签订无条件的原材料采购合同，通常这些无条件采购合同期限都在一年以内。

4、专利权及许可权承诺

目标公司签订了一系列专利权许可合同。

（三）目标公司诉讼情况

1、目标公司与 Tessera Inc.的诉讼情况

2006 年 2 月，Tessera Inc.（简称“Tessera”）起诉目标公司侵犯其专利权。目标公司于 2013 年 1 月与对方签订了和解协议，结束了两者之间的专利诉讼。Tessera 同意授予目标公司为期 5 年的半导体封装技术专利权使用许可。

2、目标公司与 U-Freight Singapore Pte Ltd 的诉讼情况

2013 年，目标公司指控由 U-Freight Singapore Pte Ltd（简称“U-Freight”）运输的设备造成损坏，并要求赔偿 204,319 新加坡元。目标公司已经从相关保险获得补偿，并正在帮助保险公司起诉 U-Freight。截至 2014 年 6 月末，被告还未做出任何反诉。

3、目标公司与 ERS electronic GMBH 的诉讼情况

2014 年 10 月 7 日，目标公司发布公告称，德国企业 ERS Electronic GMBH（简称“ERS”）指控目标公司的两台焊接机侵犯了该企业的专利权。关于此次诉讼的预审会议于 2014 年 11 月 26 日召开，目标公司已经聘请了辩护律师应对此次诉讼。此诉讼将于 2015 年 1 月 28 日再次召开预审会议。

九、目标公司持续经营活动

（一）业务概况

目标公司是世界排名前列的半导体封装测试公司，提供涵盖封装设计、焊锡凸块、针探、组装、测试、配送等一整套半导体解决方案。依托现有的在倒装芯片、晶元、3D 封装等方面的技术优势，目标公司为客户提供创新与成本高效的半导体解决方案。

目标公司总部位于新加坡，主要收入来源为美国，2013 年美国的收入占总收入的69.2%，亚洲地区收入占 19.0%，欧洲地区收入占 11.8%。2013 年目标公司封装收入占总收入的 77.7%，其中先进封装占总收入的 46.9%，焊线接合封装占总收入的 30.8%，另外 22.3%来自测试收入。

2012 年，目标公司实现总收入 17.02 亿美元，同比下滑 0.3%；2013 年，目标公司实现总收入 15.99 亿美元，同比下滑 6.1%；2014 年前三季度，目标公司实现总收入 11.79 亿美元，同比下滑 2.0%。从目标公司层面看，一方面是受高端智能手机、个人电脑等终端市场需求增速放缓的影响，另一方面是由于半导体封装行业逐步由焊线封装转向先进封装，对目标公司焊线封装业务进一步造成冲击。另外，从外部大环境看，全球半导体产业整体增速放缓，产业结构面临调整，产能在区域上重新进行分配，也对目标公司经营产生负面影响。

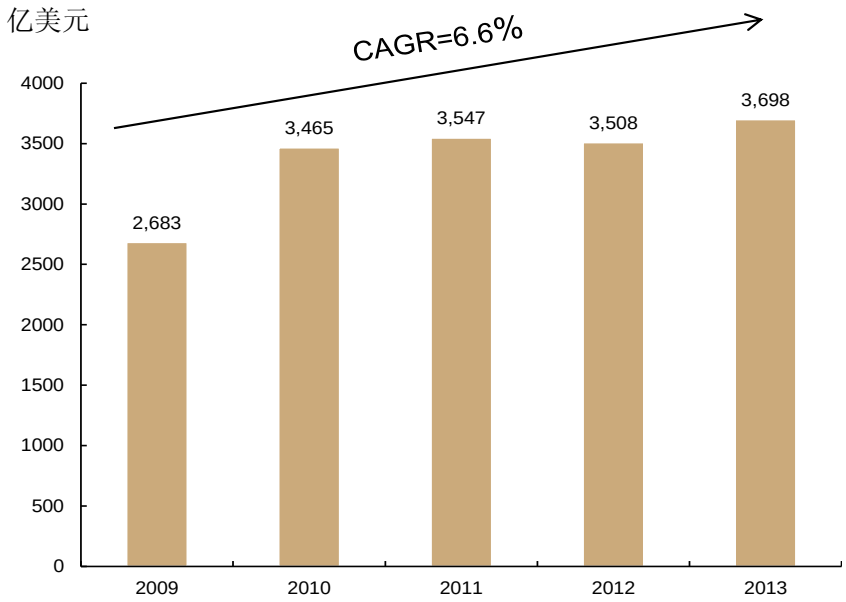
2012 年、2013 年、2014 年前三季度，目标公司分别实现毛利 2.88 亿美元、2.18 亿美元、1.34 亿美元。目标公司毛利率由 2012 年的 16.9%降至 2013 年的 13.6%，主要原因是生产设备开工不足，产能利用率由 2012 年的 75%下降至 2013 年的 66%，从而导致折旧摊销等固定成本较高。

（二）集成电路封测行业概况

1、半导体行业概况

1) 世界半导体产业开始复苏

全球半导体产业在经济危机造成的全球经济继续低迷中渡过了 2012 年，全球半导体产业规模约为 3,508 亿美元，较 2011 年的 3,547 亿美元减少 1.1%。经过 2012 年的低谷后，全球半导体行业在 2013 年开始进入复苏，产业规模回升到 3,698 亿美元，较 2012 年有 5.4%的增幅。总体来说，世界半导体产业稳定增长，2009 年到 2013 年 CAGR 达到 6.6%。2009 年至 2013 年世界半导体销售额情况如下图所示：



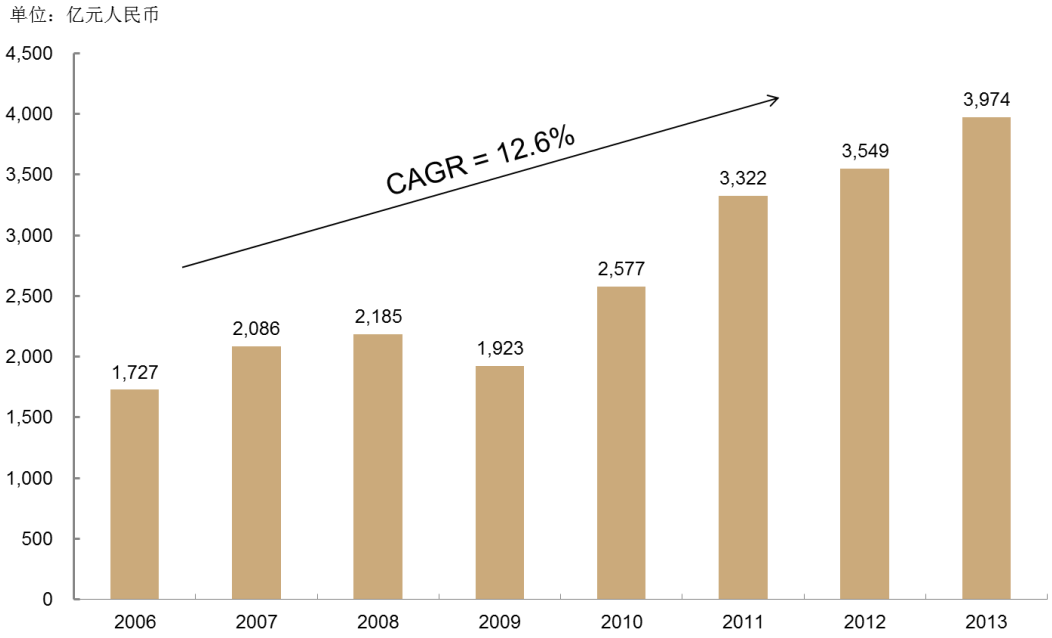
数据来源：Marketline

地区市场方面，2012 年全球所有区域的销售皆面临萎缩，其中美国半导体市场总销售值为 544 亿美元，比 2011 年下降了 1.5%；日本半导体市场销售值为 411 亿美元，比 2011 年下降了 4.3%；欧洲半导体市场销售值为 332 亿美元，比 2011 年下降了 11.3%；亚洲区半导体市场销售值为 1,630 亿美元，比 2011 年下降了 0.6%。

2013 年美国半导体市场总销售额回升到 696 亿美元，欧洲销售额达到 380 亿美元，亚洲升幅最大，增长 52%，于 2013 年达到 2,481 亿美元。

2) 中国半导体行业不断增长，需求旺盛

国外半导体市场增幅放缓，但中国半导体市场表现出强健的抗风险能力和旺盛的市场需求。2013 年全年中国半导体产业规模为 3,974 亿元，同比增长 12.0%，2006 年到 2013 年，8 年内 CAGR 达到 12.6%，明显高于全球半导体市场增速。2006 年至 2013 年中国半导体产业规模情况如下图所示：



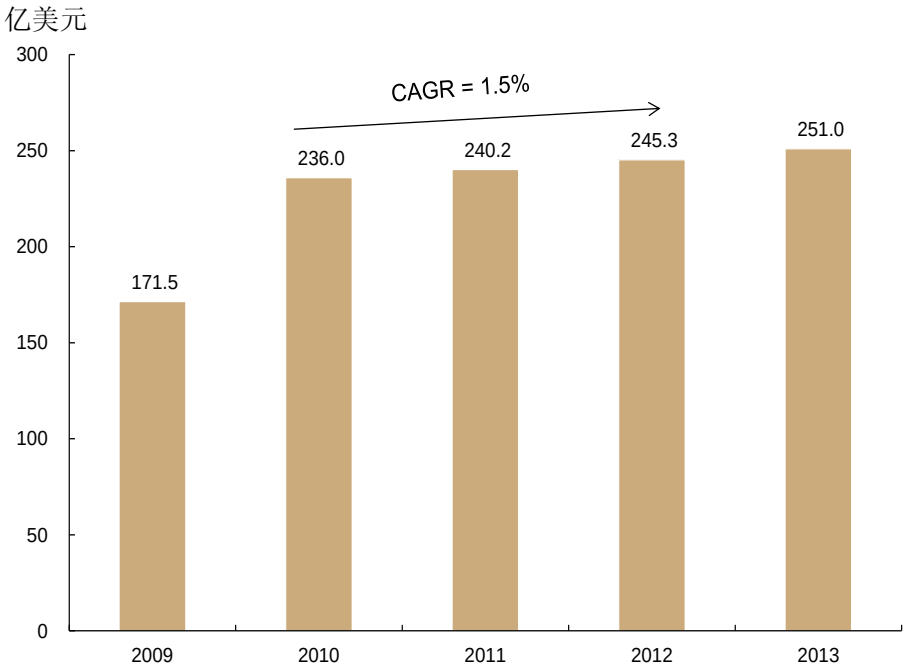
数据来源：中国半导体行业协会

2、半导体封装测试行业现状

半导体行业产业链自上而下分为芯片设计、晶圆代工、封装测试以及下游需求四个环节。设计公司研发人员首先完成芯片的寄存器级的逻辑设计和晶体管级的物理设计，验证通过的电路版图交付给代工厂；晶圆代工厂专门从事半导体晶圆制造生产，接受 IC 设计公司委托制造，自身不从事设计，其产品是包含成百上千颗晶粒（每颗晶粒就是一片 IC）的晶圆；接着，封装厂通过多道封装工序引出晶粒 I/O 焊盘上的电子信号并制作引脚/焊球，实现芯片与外界的电气互连；测试环节是 IC 制造的最后一步，作用是验证 IC 是否能按设计功能正常工作，位于产业链下游。

1) 世界半导体封装测试行业增长放缓

从全球角度来看，2012 年除中国外的整体封测产能都在收缩，全球半导体封测市场需求低迷，到 2013 年有所回升。2013 年，全球半导体封测市场总收入 251 亿美元，较 2012 年增长 2.3%。在经历了 2009 年到 2010 年的大幅上升后，2010 年到 2012 年 3 年 CAGR 仅为 1.5%。2009 年至 2013 年世界半导体封测业增长状况如下图所示：



数据来源：Gartner（单位：亿美元）

目前，在集成电路封装测试行业，高端技术和高端产品的市场份额仍然由国际巨头占据，如台湾日月光（ASE）、美国安科（Amkor）、台湾矽品（SPIL）、星科金朋（STATS）等世界大封装企业。

2013 年，全球半导体封测市场总收入 251 亿美元，较 2012 年增长 2.3%。日月光营业收入占比仍然居第一位，长电科技已进入世界集成电路封测行业第六名，是企业规模唯一进入世界封测行业排名前十的中国大陆封测企业。全球前十大封装测试公司及其市场份额如下表所示：

公司名称	2013 年市场份额 (根据营业收入)
日月光	19%
Amkor	12%
矽品	9%
星科金朋	6%
力成科技	5%
长电科技	4%
J-Devices	3%
UTAC	3%

公司名称	2013 年市场份额 (根据营业收入)
ChipMOS	3%
Chiobond	2%

数据来源：Gartner

2) 中国半导体封装测试行业市场需求长期增长，行业景气度高

中国封测行业在半导体行业紧缩周期中逆势扩张，相应 2010 年到 2012 年的 CAGR 达到 18.1%，远远高于世界水平的 1.5%。2012 年中国封测厂房面积总体增长 5%，但是全球其他地区的封测厂房面的下降了 2%。而中国的封测产能已经占到了世界 21%。

中国半导体封装测试行业市场规模主要由四个方面驱动：全球封测产能向中国转移，国内封测技术突破，国内半导体设备国产化需求上升和下游消费电子设备需求的增长。2012 年，国内封装测试行业保持了平稳增长，其规模已超过 1000 亿元，达到 1035.67 亿元，同比 2011 年的 975.7 亿元，增速为 6.1%。从国内主要封装测试企业 2012 年的销售额来看，这些企业大多保持了业绩增长的势头，10 大封装测试企业的进入门槛已经达到 20 亿元人民币的水平。

3) 中国国家政策鼓励半导体封装测试行业发展

国家颁布了多项政策积极鼓励和发展半导体封装环节，《信息产业科技发展“十一五规划”和 2020 年中长期规划纲要》提出重点发展集成电路关键技术，包括 MEMS 技术和新型、高密度集成电路封装测试。2011 年工信部和商务部将线宽 65nm 以下的芯片封装归入当前优先发展的高技术产业领域；此外，2011 年《集成电路产业“十二五”发展规划》指出大力发展先进封装和测试技术，推进高密度堆叠型 3D 封装产品进程，支持封装工艺技术升级和产能扩充。

4) 集成电路产业下游消费电子设备需求快速增长

国内半导体封装测试行业主要受益于下游消费电子设备需求的不断增长，其中，高端装备制造、智能电网等都需要电子元器件，特别是智能移动终端、LED 照明市场可获得持续增长。

此外，随着移动互联网时代的来临，我国移动智能终端产业发展迅速，市场快速扩大，拥有巨大发展潜力。未来几年内，智能机依然可以保持两位数的增长，平板电脑很大程度上能够弥补 PC 需求下滑的影响。同时，全球 4G 布局加快，航天探测热潮重启

利于工业等领域内半导体市场的发展。

（三）目标公司产品及整体解决方案

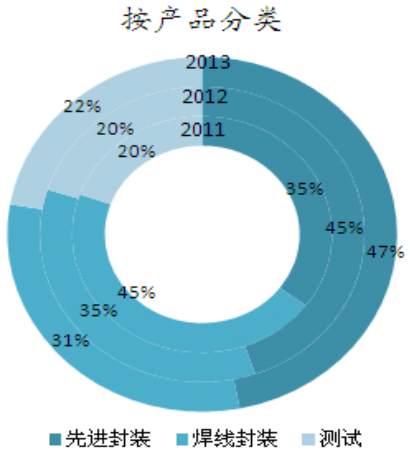
目标公司提供半导体封装和测试的综合解决方案，业务按照产品类型主要分为先进封装（Advanced Packaging），焊线接合封装（Wirebond Packaging）和测试服务（Test Services）三块。从终端用户市场看，目标公司业务主要分为通信（Communication），消费者、多应用及其他（Consumer, Multi-applications & Others）以及个人电脑（Personal Computers）。从地域分布来看，目标公司的业务主要在美国、欧洲和亚洲开展。2011年-2013 年目标公司业务结构如下：

先进封装（Advanced Packaging）：目标公司使用了包括晶圆凸块、倒装芯片、扇出型晶圆级封装，内嵌式晶圆级凸点封装（eWLB）等在内的先进集成电路封装技术。先进封装业务发展迅速，在目标公司整体收入的比重由 2011 年的 35%提高到 2013 的 47%，在三块业务中占比最高，是目标公司未来发展的重要增长力，主要表现在晶圆级封装在生产中的应用已经趋近成熟并被广泛采用，并且 eWLB 技术正在吸引越来越多的客户。

焊线封装（Wirebond Packaging）：目标公司使用了包括引线封装、层压封装等在内的焊线集成电路封装技术，2013 年焊线封装贡献了目标公司总体收入的 31%。

测试（Test Services）：目标公司提供包括晶圆针探、最终测试等在内的服务，特别是在混合信号、射频等电子设备的测试方面实力突出，2013 年测试业务贡献目标公司全部收入的 22%。

2013 年，目标公司先进封装业务的收入同比下降 1.4%至 7.5 亿美元，主要是受无线通信市场封装需求量下降的影响；2013 年，目标公司焊线封装业务的收入同比大幅下降 17.8%至 4.92 亿美元，主要是由于个人电脑以及其他电子设备封装需求下降，此外，半导体封装行业的整体发展趋势是由焊线封装转向先进封装，对目标公司的焊线封装业务也产生不利影响；2013 年，目标公司测试服务业务表现抢眼，同比逆势增长 4.2%至 3.56 亿美元。2013 年，先进封装、焊线封装、测试三者占总营业收入比重分别为 47%、31%、22%。最近三个财年目标公司主营收入构成比例如下图所示：



数据来源：目标公司年报

2011-2013 年目标公司按产品细分收入情况如下表所示：

百万美元	2011	2012	2013
先进封装	602	761	750
同比增长率	-	*26.3%*	*-1.4%*
焊线封装	771	599	492
同比增长率	-	*-22.4%*	*-17.8%*
测试	333	342	356
同比增长率	-	*2.8%*	*4.2%*

数据来源：目标公司年报

（四）目标公司产品策略

1、先进封装

目标公司牢牢把握住先进封装产品未来广阔的市场前景，在倒装芯片方面，将无线通讯视为可能的新增长点，专注外观尺寸和成本相关的问题，深度开发倒装芯片细间距球栅阵列、超高清等技术。在晶圆级封装技术方面，目标公司主要针对 300mm 的晶圆，并将扇出型晶圆级封装作为发展重点。

未来，在倒装芯片方面，目标公司将持续推进成本效率，专注于智能手机和平板市场，重点推动与有限网络和消费板块相关的倒装芯片和球栅阵列技术。在晶圆级产品方面，重点发展 FlexLine 技术流程，推动市场需求并完成产能扩张，目标公司也将持续发展 eWLB 技术及相关产品。

2、焊线接合封装

在焊线接合封装方面，目标公司注重芯片尺寸封装，包括芯片堆叠细间距球栅阵列封装和方形扁平无引脚封装，专注于扩大目标公司在堆叠晶片领域的领导地位。

目标公司计划在 2015 年前将焊线接合封装工厂由五家整合至两家，包括将马来西亚工厂迁至中国以及韩国部分业务转移至中国。目标公司将继续推动金线回填、模拟以提高旧型焊线机的利用率，并依据核心客户的需求，适当考虑扩张铜线的产能，专注于智能手机市场。

3、测试服务

在测试服务方面，目标公司专注于泰瑞达平台，以避开内存测试和小众平台，实施先进的 IT 解决方案，提高效率并降低成本。此外，目标公司还有针对性地增加对纯测试业务的支持，专注于填补未被充分利用的资产。

未来目标公司计划根据选项卡管理增长平台，针对选定的新增纯测试业务，重新为其配置销售和营销团队。

4、目标公司主要产品的质量控制情况

目标公司的质量控制目前为总部统一管理模式，体系完整，且质量控制管理层的从业经验较为丰富。目标公司质量事件报警和追踪，质量管理方面的信息化程度较高。

（五）目标公司市场及销售策略

1、目标市场概述

1) 按终端用户市场分类

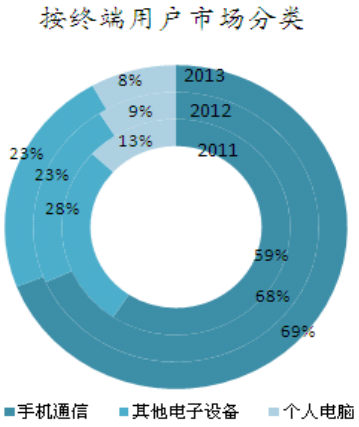
目标公司为包括移动端、个人电脑等在内的设备提供封装及测试服务，主要的终端市场是手机通信市场，2013 年贡献目标公司全部收入的 69%，其他电子设备和个人电脑分别贡献收入的 23%和 8%。2014 年第三季度，目标公司收入中 66%来自通信市场，8%来自个人电脑市场，剩余 26%来自其他电子设备。相比于 2013 年，目标公司产品终端市场更为分散。

2010－2012 年，目标公司在手机通信市场的业务连续增长，2013 年智能手机市场分化明显，目标公司之前表现良好的高端智能机需求量下降，而低端智能机市场增长迅

速，由于目标公司在低端智能机市场的影响力一般，2013 年目标公司在手机通信市场的收入同比下滑 5%。

目标公司在个人电脑市场的业务范围主要是磁盘驱动及其他，目标公司磁盘驱动业务收入占整体个人电脑收入的半数以上。此外，由于个人电脑市场销售情况的低迷，对目标公司业绩产生了不利影响，2013 年，目标公司在个人电脑市场的收入同比下滑 15%。2014 年个人电脑业务占总收入比重与上年持平。

2011-2013 年不同终端用户市场收入占比情况如下图所示：



数据来源：目标公司年报

2011-2013 年按终端用户市场细分收入情况如下表所示：

单位：百万美元

	2011	2012	2013
手机通信	1012	1162	1103
同比增长率	-	*14.8%*	*-5.1%*
其他电子设备	471	386	366
同比增长率	-	*-18.0%*	*-5.2%*
个人电脑	224	153	129
同比增长率	-	*-31.5%*	*-15.4%*

数据来源：目标公司年报

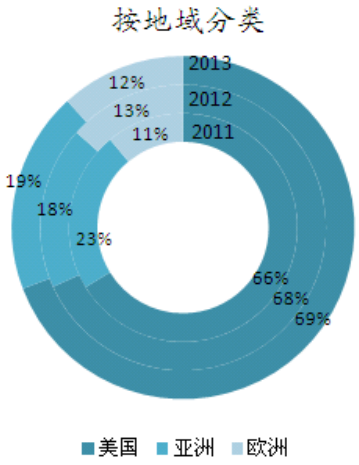
2013 年目标公司前五大客户销售额合计 7.95 亿美元，目标公司总收入的 49.7%。

目标公司董事、监事、高级管理人员未在目标公司前五名供应商或客户中占有权益。

2) 按地域分类

目标公司的业务主要集中在美国市场。2013 年，受市场整体以及目标公司自身经营的影响，目标公司在亚洲、美国市场的收入分别小幅下滑 3%和 5%，欧洲市场降幅较大，收入同比下滑 17%。

目标公司注重开拓新兴市场，在发展中国家的业务实力不断提升，2014 第三季度目标公司在亚洲区的收入占总体收入的比重提升到 26.6%，较 2013 年第三季度同比增加 7.4%，较 2014 年第二季度环比回落 2.2%。2011-2013 年不同地域收入占比情况如下图所示：



数据来源：目标公司年报

2011-2013 年按地域细分收入情况如下表所示：

百万美元	2011	2012	2013
美国	1130	1160	1106
同比增长率	-	*2.7%*	*-4.7%*
亚洲	387	313	304
同比增长率	-	*-19.2%*	*-3.0%*
欧洲	188	228	189
同比增长率	-	*21.5%*	*-17.3%*

数据来源：目标公司年报

2、市场销售策略及模式

目标公司客户订单由各业务部门经理负责处理，接到订单后按照相应的封装需求（先进封装、传统封装）向相应工厂分配订单。工厂发货给客户之后，由业务部门负责货款的收取。

目标公司相应的销售部门分布为：4 个美国销售部门、1 个欧洲销售部门、1 个大中华/台湾销售部门、1 个韩国销售部门和 1 个日本销售部门。

（六）目标公司供应链策略及模式

目标公司将供应商分为两大类，分别为生产性供应商和环境供应商。其中生产性供应商指提供目标公司生产过程中所需要的原料、物料、委外加工、设备、工具的供应商；环境供应商指提供目标公司生产活动过程中所产出的废弃物处置的施工商。

1、目标公司供应链运作模式

目标公司供应链运作模式较为成熟，具体由八大策略分工组成，如下表所示：

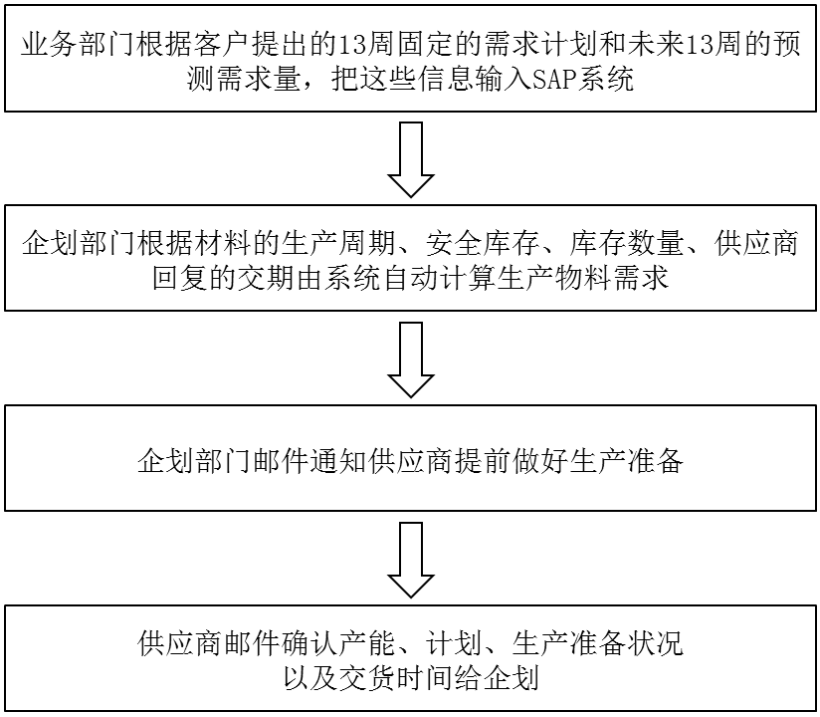
策略名称	具体措施
开发策略	1. 遵循低成本原则制定集团供应商开发规划 2. 前期实施供应商双重开发 3. 实施中国供应商开发 4. 减轻和降低材料采购（BOM）风险
供应商管理	1. 供应商交期和生产能力在线管理 2. 供应商价格参照 3. 供应商周期性评定 4. 减轻和降低材料采购（BOM）风险 5. 平衡其他成本和费用
谈判策略	1. 结合季度和临时谈判 2. 采用双方报价策略 3. 实施新的商业材料成本管理 4. 替代材料定价策略 5. 关注成本降价趋势 6. 开发低成本供应商
价值工程和	1. 开发供应商合作项目

策略名称	具体措施
最佳 BOM 策略	2. 推进新产品设计 3. 协助供应商采用低成本工艺 4. 减少金线的使用和采购 5. 减少金线线径和长度 6. 增加铜线产品 7. 重新设计引线框和基板
SDE 策略	1. 开放具有有效成本控制战略的供应商 2. 锁定材料的入门价格，制定成本的路线图
供应商发展计划	1. 提供供应商在线技术支持 2. 采用新的技术支持
技术开发	1. 寻找低成本材料 2. 发挥与战略供应商合作开发项目的杠杆作用
供应商门户策略	1. 提高供应链可见性，促进与供应商的合作 2. 预测需求计划 3. 保证采购订单的执行及确认 4. 提前装运通知 5. 提高供应商能力的可见性 6. 实施供应商 WIP 状态监控 7. 报价能见度的要求和跟踪

资料来源：目标公司管理层提供

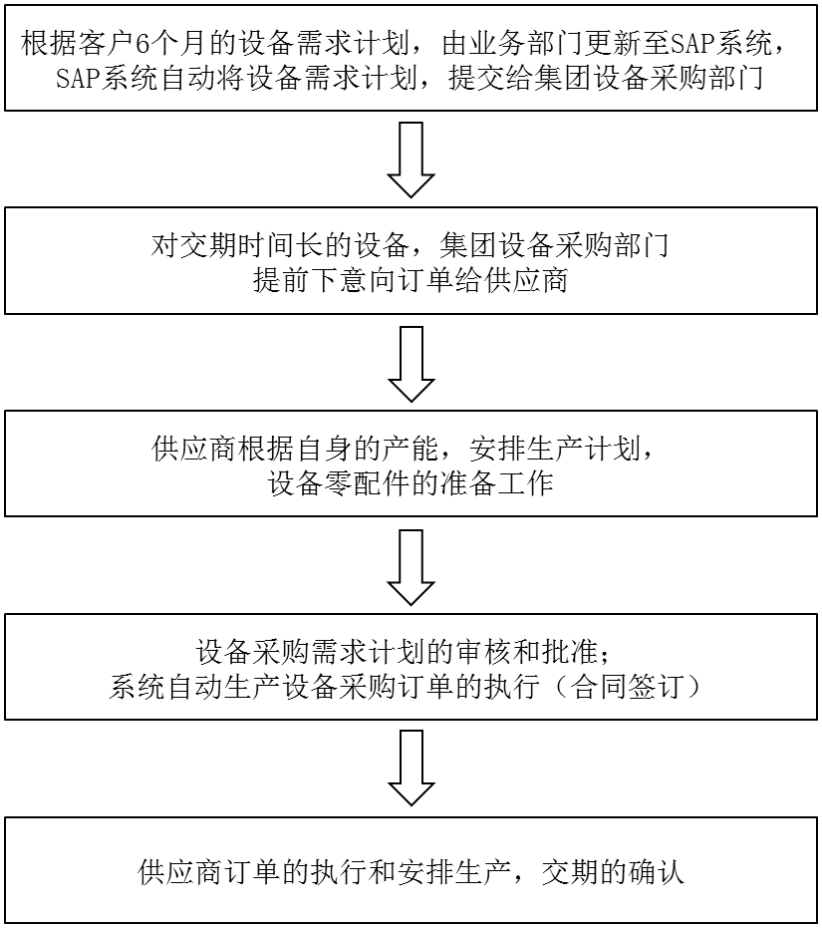
2、目标公司采购流程

1) 材料的采购流程



资料来源：目标公司管理层提供

2) 设备的采购流程



资料来源：目标公司管理层提供

（七）目标公司研发情况

目标公司注重提高生产过程的技术含量，重视研究开发，2012 年研发费用占目标公司总体收入 3.0%，2013 年占比 2.9%。目标公司洞察性地抓住半导体封装行业未来倾向于先进封装的大趋势，积极开发相关技术，在先进晶圆级封装领域取得显著成果，特别是 eWLB 技术，目前该技术在移动通信市场应用越来越广泛。

目标公司已经具备了一套完善的研发流程和体系，所有新技术的选取、研发和投入都需要进入流程体系之内进行严格的审阅和管控，并且相应的研发成果都需要上传到专门的信息系统中。在这套研发体系下，目标公司从 2010 年到 2014 年发表的技术白皮书数量如下：

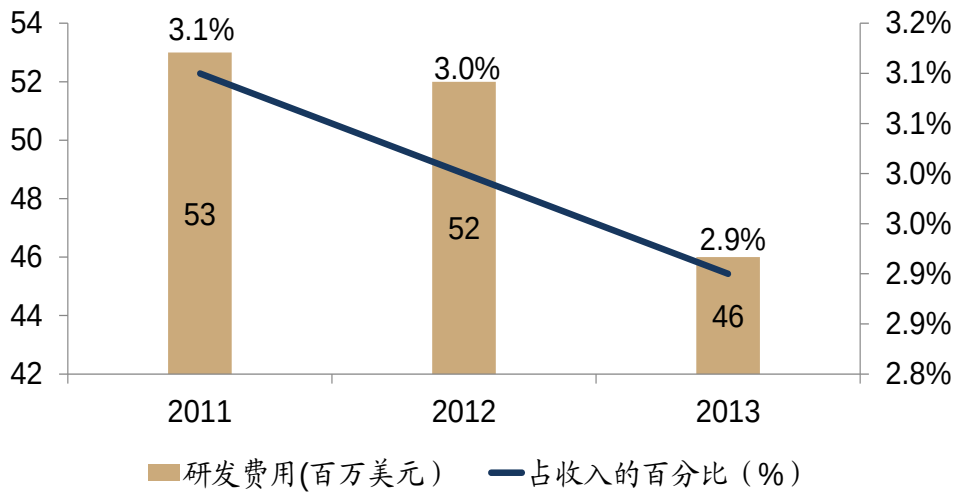
技术分类	技术白皮书数量
晶圆级封装技术	29
倒装封装技术	25

技术分类	技术白皮书数量
3D 封装技术	18
铜焊线封装技术	4

资料来源：目标公司管理层提供

同时研发体系也较好地将研发团队与技术市场团队结合到一起，由技术市场部门负责市场需求研究，明确技术需要，研发部门负责研发得到可以满足需求的新技术，并通过内部流程体系完成相关的验证和资料的收集，之后由技术市场部门进行相应的市场推广。

2011-2013 年，目标公司研发支出占收入的平均百分比为 3%，研发费用及其占收入的百分比情况如下图所示：



资料来源：目标公司定期报告

十、目标公司非持续经营活动

（一）目标公司关闭马来西亚工厂

目标公司于 2013 年 6 月宣布关闭马来西亚工厂，计划将马来西亚的封装测试业务整合至中国工厂内，以扩大中国业务运营规模并优化成本结构。目标公司管理层表示，马来西亚业务整合关闭计划于 2013 年和 2014 年分几个阶段进行，并将于 2014 年底前完成。

马来西亚业务的大部分客户已经同意将产品订单转移至目标公司中国工厂，客户关系转移于 2014 年 9 月底前全部完成。

目标公司管理层对马来西亚工厂的固定资产可用性进行了分析：对于尚可使用的设备，将全部转移至中国工厂；对于可对外出售的房屋建筑，将出售处置；对于不能使用或不能出售的厂房建筑及设备的账面净值计提减值准备。马来西亚工厂已于 2012 年和 2013 年共计提了固定资产减值准备 2,154.9 万美元。截至 2014 年 6 月末，马来西亚工厂固定资产账面净值 3,073.1 万美元，包括可供出售的房屋建筑约 1,000 万美元和将转移至中国工厂的设备约 2,000 万美元，根据目标公司定期报告，该部分资产不需计提减值准备。

（二）目标公司关闭泰国两家工厂

目标公司于 2012 年 2 月宣布计划终止并关闭泰国封装工厂及测试工厂的运作。泰国两家工厂已于 2012 年停产并进入资产处置程序。

泰国两家工厂于 2011 年度遭受洪灾致其厂房及设备遭受了严重的损失，因此对固定资产计提了美元 1,631.3 万美元减值准备。同时，目标公司 2012 年、2013 年分别确认了 2,674 万美元和 1,958 万美元与泰国水灾相关的保险赔偿收入。

（三） 非持续经营活动处置利润/损失情况

单位：千美元	2012 年	2013 年	2014 年中期
马来西亚工厂关闭成本	-	36,909	-
马来西亚工厂关闭的其他成本	-	288	397
债券提前赎回溢价及债务重组指出	-	15,701	-
水灾相关应对方案费用	10,061	3,000	-
冲销债券发行成本	-	2,392	-
离职补偿	5,715	1,886	-
商誉/资产减值损失	27,919	-	2,261
投资损失/（收益）	739	-	-
处置固定资产损失/（收入）	(661)	(1,161)	(541)
水灾损失保险赔偿	(26,741)	(19,582)	-
汇兑损失/(收入)	（1,023）	(3,065)	350
ANST 损失/（收入）	(2,756)	-	-
其他营业外费用/（收入）	21,298	2,200	15
总计	**34,551**	**38,568**	**2,482**

资料来源：目标公司管理层提供

十一、目标公司最近两年及一期的主要财务指标

（一）目标公司两年及一期主要财务数据

目标公司 2012 和 2013 财年财务数据根据新加坡会计准则编制，并经 PricewaterhouseCoopers LLP (普华古柏会计师事务所有限合伙)审计；目标公司 2014 年三季度财务数据未经审计。

1、简明合并资产负债表

单位：千美元

项目	2014 年 9 月末	2013 年末	2012 年末
流动资产	543,186	514,883	603,690
非流动资产	2,088,918	1,862,787	1,664,586
总资产	2,632,104	2,377,670	2,268,276
流动负债	561,598	460,896	384,396
非流动负债	1,126,536	945,985	861,282
总负债	1,688,134	1,406,881	1,245,678
归属母公司股东权益	890,475	917,432	970,809

2、简明合并利润表

单位：千美元

项目	2014 年前三季度	2013 财年	2012 财年
销售收入	1,179,160	1,598,522	1,701,549
毛利	134,409	217,581	287,504
经营利润（非经常项目前）	27,619	55,030	79,190
净利润	(19,174)	（39,079)	23,857
归属于母公司股东的净利润/(损失)	(25,280)	(47,493)	16,563
基本每股收益(美元)	(0.01)	(0.02)	0.01

3、简明合并现金流量表

单位：千美元

项目	2014 年前三季度	2013 财年	2012 财年
经营活动产生的现金流量净额	243,131	380,496	375,199

项目	2014 年前三季度	2013 财年	2012 财年
投资活动产生的现金流量净额	(436,080)	(412,681)	(371,375)
筹资活动产生的现金流量净额	179,392	(9,221)	(28,059)
现金及现金等价物净增加额	(13,557)	(41,406)	(24,235)
期末现金及现金等价物余额	115,609	129,136	170,558

（二）目标公司母公司最近两年及一期主要财务数据

1、母公司简明资产负债表

单位：千美元

项目	2014 年 9 月末	2013 年末	2012 年末
流动资产	590,625	632,037	659,882
非流动资产	1,287,738	1,253,687	1,179,744
总资产	1,878,363	1,885,724	1,839,626
流动负债	231,480	332,706	316,168
非流动负债	966,248	854,709	799,561
总负债	1,197,728	1,187,415	1,115,729
股东权益	680,635	698,309	723,897

2、母公司简明利润表

单位：千美元

项目	2014 年上半财年	2013 财年	2012 财年
销售收入	241,319	439,775	451,408
毛利	45,708	93,132	115,304
经营利润（非经常项目前）	7,623	7,968	39,088
净利润	(10,284)	(25,235)	(13,214)

注：目标公司未披露 2014 年前三季度的母公司简明利润表

3、母公司简明现金流量表

单位：千美元

项目	2014 年上半财年	2013 财年	2012 财年
经营活动产生的现金流量净额	22,933	113,505	236,631
投资活动产生的现金流量净额	(131,106)	(103,203)	(182,953)

项目	2014 年上半财年	2013 财年	2012 财年
筹资活动产生的现金流量净额	87,482	(32,957)	(23,229)
现金及现金等价物净增加额	(20,691)	(22,655)	30,449
期末现金及现金等价物期末余额	40,862	61,549	84,204

注：目标公司未披露 2014 年前三季度的母公司简明现金流量表

（三）目标公司主要会计政策及相关会计处理

由于本次收购的目标公司在新加坡注册，系国外独立法人实体且在新加坡交易所上市，与本公司无股权关系，同时本公司目前尚未完成对目标公司的协议收购，因此无法提供按本公司的会计制度和会计政策编制的目标公司的财务报告和审计报告。本公司将在目标公司股权正式交割后三个月内按相关监管部门要求完成并向投资者披露按照中国企业会计准则和本公司会计政策编制的目标公司的财务报告和审计报告。关于目标公司主要会计政策及相关会计处理详见本报告书“第九章 目标公司财务会计信息”。

1、收入的确认原则和计量方法

目标公司收入主要来自晶圆测试、晶圆凸块以及半导体集成电路的封装测试。收入净额按照销售的产品或提供的服务的发票金额减去预计退货及折让并减去产品及服务税的金额列示。

当产品或服务相关的所有主要风险及报酬转移给客户时，目标公司确认收入。通常，当客户确认收到产品并没有争议时，目标公司认为产品或服务相关的主要风险及报酬已转移。

目标公司通常不获取客户提供半导体产品的所有权，因为这些材料只是委托给目标公司的。因此客户提供材料的价值没有包含在营业收入或营业成本内。

目标公司根据历史经验、对客户最终销售数量和客户付款时点的估计对预计销售退回及销售数量折让和现金折让计提准备，并作为营业收入的抵减项。个别的退回或折让在已知及金额可以估计时确认。

2、编制基础、合并和子公司

除在目标公司的会计政策中另有披露外，目标公司财务报表按照历史成本法编制。

合并财务报表包括目标公司和其拥有多数权益的子公司，即被其控制的公司的合并

财务报表。这个控制通常被指当目标公司能够决定一个公司的财务和经营政策，从而从它的活动受益，或目标公司直接或间接地拥有一个公司的多数投票股权，或通过合同协议控制，除非在特殊情况下，有证据表明所有权不构成控制。

子公司从其被收购日期开始合并，即目标公司取得控制的日期，并一直合并直至该控制权终止之日。合并财务报表里的母公司及子公司的会计年度相同，且对子公司可能采用的与目标公司会计政策的不同进行调整。目标公司内所有的公司间往来、交易，包括由于集团内公司间交易产生的未实现利润，都予以全部抵消。未实现亏损也予以抵消，除非相应的成本无法回收。

少数股东损益和权益代表非由目标公司持有的子公司的综合收益和净资产。

3、目标公司所采纳的会计政策和中国企业会计准则之间的主要差异

本公司针对目标公司所采用的主要会计政策和中国会计准则的差异及其对目标公司如果按中国会计准则编制财务报表的可能影响编制了差异情况表，并聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对该差异情况表出具了鉴证报告。根据星科金朋所使用的主要会计政策与中国会计准则的差异比较结果，本公司管理层得到的初步结论为：没有注意到任何事项使我们相信差异情况说明未能在所有重大方面反映 STATS ChipPAC 截至 2012 年 12 月 30 日止财务年度、截至 2013 年 12 月 29 日止财务年度和截至 2014 年 9 月 28 日止 9 个月期间根据新加坡财务报告准则编制的财务报表中披露的主要会计政策和中国企业会计准则相关规定的差异。相关内容详见本报告书“第九章 目标公司财务会计信息”。

第五章 本次要约收购及相关协议的主要内容

一、本次要约收购的主要内容

长电科技、要约人及星科金朋就本次要约的主要条款签署了《要约执行协议》。本次要约收购的基本情况如下：

（一）交易主体

联合收购方：长电科技、产业基金、芯电半导体

要约人：JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.

目标公司：STATS ChipPAC Ltd.（不含台湾子公司）

（二）交易标的

目标公司发行在外的全部普通股股份，不包括目标公司自己持有的库存股，但包括在本次附生效条件的要约公告日已发行的期权计划下因行权而新发行的所有普通股股份。

（三）收购方式

在附生效条件的要约的生效条件全部满足或者得到豁免的情况下，由要约人在新加坡证券交易所以自愿有条件全面要约的方式收购目标公司的全部股份。本次要约将遵循《新加坡收购与兼并守则》的相关规定。

（四）收购对价

本次要约的对价将以现金支付：每股星科金朋股票收购价格为 0.466 新元。

若附生效条件的要约公告后，目标公司股票发生除权、除息等事项，则要约人保留对于要约价格进行相应调整的权利。

本次要约的总交易对价为 7.80 亿美元，约合 10.26 亿新加坡元（按照 2014 年 12 月 19 日美元对新元汇率中间价：1 美元折合 1.31505 新元计算）。

若附生效条件的要约公告后，出现竞争要约或类似情形，要约人保留调整要约价格的权利。

（五）台湾子公司重组

鉴于台湾地区对于陆资企业投资台湾半导体相关行业企业有一定的政策限制，而本次要约收购的同时，若不进行台湾子公司重组，收购完成后目标公司的台湾子公司将被陆资企业所间接控制。为避免对本次要约收购的实施产生影响，经长电科技与目标公司及其控股股东协商，拟在本次要约收购的同时进行台湾子公司重组。具体方案如下：星科金朋持有 52%股权的台湾子公司 SCT 1 向星科金朋收购其持有 100%股权的台湾子公司 SCT 3，收购对价约为 1,500 万美元，收购后 SCT 3 成为 SCT 1 的全资子公司。星科金朋将在新加坡设立一家新公司“Newco”，将 SCT 1 的 52%的股权以 7,412 万美元的对价转让给 Newco 持有，并获得 Newco 向其发行的股份；星科金朋再以减资的方式，向所有股东派发 Newco 的全部股权和总计约 1,500 万美元的现金，从而剥离台湾子公司，上述减资不会导致星科金朋发行在外的股份的注销，亦不会导致其总股本发生变化，仅会导致每股净资产减少。星科金朋的股东可以选择获得现金或者 Newco 的股份，但控股股东 STSPL 承诺将选择接受 Newco 的全部股票。Newco 的股票不会在任何证券交易所上市。

上述台湾子公司重组构成星科金朋的减资，需经星科金朋股东大会审议通过，并经新加坡法院批准。根据中国台湾地区的相关规定，上述台湾子公司重组的相关事宜需经中国台湾地区投审会批准。此外，星科金朋两家台湾子公司之一 SCT 1 为台湾上市公司，星科金朋持有其 52%的股权，星科金朋向 Newco 转让该部分股权需向投审会申请豁免 Newco 的要约收购义务。

在台湾子公司重组的同时，SCT 3 将归还欠星科金朋的 1.27 亿美元的债务；同时，为保证台湾子公司重组后平稳过渡，星科金朋将与台湾子公司签署业务合同。

（六）STSPL 不可撤销承诺

本次交易中，星科金朋控股股东 STSPL 已向要约人出具了不可撤销承诺，其主要内容如下：

1. 承诺以其现在持有的以及未来可能持有的全部星科金朋的股份在约定时间内接纳本次要约；

2. 除了接受本次要约外，不得对全部或部分已持有的星科金朋股份进行出售、转

移或任何其他处理；

3. 无论法律是否允许，均不得撤回接受要约的承诺；

4. 不会接受任何竞争要约，无论该竞争要约价格是否高于本次交易的要约价格；

5. 承诺在星科金朋审议台湾子公司重组的股东大会上投出赞成票；

6. 承诺在星科金朋以减资的方式分派 Newco 股权及现金时，选择获得 Newco 的全部股权；

7. 承诺在星科金朋审议根据永续证券条款修改公司章程的股东大会上投出赞成票；

8. 承诺按股权比例认购永续证券，并且在其他股东放弃认购的情况下，承诺认购所有未被其他股东认购的部分，并按约定时间缴付认购款，即 STSPL 将认购最高 2 亿美元的永续证券。

（七）新潮集团不可撤销承诺

新潮集团已向 STSPL 出具不可撤销承诺函，主要内容如下：

1. 新潮集团将促使长电科技在 2015 年 2 月底（或经双方协商同意延长后的时间）之前召开股东大会审议通过本次交易及相关事宜。

2. 在长电科技审议本次交易及相关事宜的股东大会上，新潮集团将投出赞成票。

（八）适用法律、法规

本次交易主要适用新加坡相关法律、法规以及新加坡证券交易所、新加坡证券业协会的相关规定。

（九）附生效条件的要约

本公司间接控制的要约人向星科金朋发出了附生效条件的要约，其生效条件包括：

1. 长电科技股东大会批准本次交易及相关事宜；

2. 目标公司股东大会批准减资及台湾子公司重组，以及根据永续证券条款修订星科金朋公司章程的相关事宜；

3. 新加坡法院批准减资及台湾子公司重组；

4. 在以下两个日期中的较早日期，目标公司合并口径的有息债务总额（银行贷款及已发行的票据及债券）不超过 12.8 亿美元：（1）正式要约公告之日，（2）2015 年 4 月 30 日；

5. 所有与本次要约相关的备案、核准或授权均已获得并具有相关效力，包括但不限于：国家发改委、江苏省商务厅、所在地外汇管理局关于本次交易的备案或审批、台湾投审会批准台湾子公司重组的相关事宜；

6. 通过中国、美国、韩国等地的反垄断审查；

7. 获得其他必需的审批或授权（如有）。

只有当上述生效条件被全部满足或豁免后，要约人才会发出正式要约。如果截止日期（新加坡时间 2015 年 6 月 30 日下午 5 点或某个经目标公司及要约人于咨询新加坡证券业协会后确定的更晚时间）到达后，仍有生效条件未被满足且未获得豁免，正式要约将不会发出。

（十）自愿有条件全面要约

附生效条件的要约的生效条件被满足或豁免后，本公司间接控制的要约人将对星科金朋发出自愿有条件全面要约（即正式要约），正式要约的生效条件如下：

1. 在要约到期日，有效接受要约的股份，与已经由要约人及其一致行动人持有、控制或即将收购的股份之和，占目标公司总股本的比例不低于 50%。此处总股本的计算基础为目标公司全面摊薄后的总股份数，包括在附生效条件的要约公告日已发行的期权计划下因行权而新发行的所有普通股股份；

2. 台湾子公司重组完成。

3. 永续证券的配售接纳表格已向星科金朋的股东发送。

本次交易中，STSPL 持有目标公司 1,845,715,689 股普通股，约占目标公司总股份数的 83.8%。由于 STSPL 已向本公司出具了不可撤消承诺函，当 STSPL 有效接受本次要约、目标公司完成台湾子公司重组，且星科金朋向股东发送了永续证券的配售接纳表格时，正式要约即宣告为无条件。

（十一）强制挤出条款

本次要约以实现星科金朋私有化为目的。本次要约中，若要约人获得的股份数不低于总股数（不含要约人及其关联方持有的股份及目标公司的库存股）的 90%时，要约人有权根据新加坡公司法赋予的强制购买权，按照与本次要约相同的条件强制购买不接受要约的股东所持有的股份，以实现私有化。

二、永续证券的主要条款

考虑到本次交易将导致星科金朋控股股东发生变化，星科金朋将根据其现有银行贷款及发行在外的优先票据的相关条款约定进行债务重组。为配合上述债务重组并替换星科金朋现有的部分债务，星科金朋拟向所有股东配售永续证券，该永续证券规模为两亿美元。

根据星科金朋控股股东 STSPL 出具的不可撤销承诺函，STSPL 将承诺认购最高两亿美元的永续证券。

上述永续证券的主要条款如下：

1. 利率安排：自发行日起，前三年每年单利 4%，第四年起上升到 8%，此后每年上升 1%，最高达到 12%。星科金朋有权选择延期支付利息。若星科金朋在第四年年初仍未偿还该永续证券，则该笔永续证券将转为复利计息。

2. 如果星科金朋违反该永续证券的条款规定，触发违约，或者星科金朋的其他债务发生违约（即交叉违约的情况），那么该永续证券的利率将立刻上升至 12%。

3. 在永续证券存续期间，未获得合计持有 50%以上永续证券面值的持有人的同意的情况下，星科金朋和其子公司均不能分红、不能支付优先级低于该永续证券的其他债务的利息，也不能偿还优先级低于该永续证券的其他债务的本金。

4. 星科金朋还需要满足以下条件：1）向包括 STSPL 在内的永续证券持有人及时提供星科金朋的年度及季度财务信息，该财务信息需要按照新加坡会计准则或其他适用的准则进行编制，并于会计年度结束后及时向永续证券持有人提供由国际认可的独立审计师出具的审计报告；2）在发生关联交易的情况下，需按约定告知永续证券持有人；3）

在替换星展银行过桥贷款时，需要尽合理努力争取赎回永续证券，但若无法赎回，亦不构成违约。

5. 该永续证券无固定赎回日期，星科金朋随时有权赎回该永续证券。

6. 若星科金朋发生违约或者三年后仍未偿还本金，永续证券持有人有权按照持有的永续证券规模占所有债务规模的比例向星科金朋委派董事，委派董事的数量向下取整，但至少一名，且不得超过半数董事。且对于所有需要星科金朋股东表决的事项，均需事先获得合计持有 50%以上永续证券面值的持有人的书面同意。

长电科技拟出具担保承诺，若星科金朋三年后仍无法赎回上述永续证券，永续证券持有人有权将所有永续证券出售给长电科技，长电科技作为永续证券担保人将按照出售价格偿付包括永续证券本金及所有应付未付的利息。永续证券持有人均不可在三年内要求向长电科技进行出售。上述担保须经长电科技股东大会审议通过，并在永续证券发行后生效。

三、共同投资协议的主要内容

本次交易中，长电科技、产业基金和芯电半导体共同签署了《共同投资协议》，长电科技、新潮集团与产业基金签署了《售股权协议》，长电科技、新潮集团与芯电半导体签署了《投资退出协议》，产业基金、长电新科（即 HoldCo A）与长电新朋（即 HoldCo B）签署的《债转股协议》。

（一）《共同投资协议》主要内容

《共同投资协议》签署于 2014 年 12 月 22 日。

协议签署方：长电科技、芯电半导体、产业基金（芯电半导体、产业基金单独或合称为“投资方”）

1、各方拟通过共同设立的公司收购星科金朋部分或者全部股份。根据各方协商一致，由长电科技、芯电半导体、产业基金共同出资在境内设立公司 HoldCo A，HoldCo A 与产业基金在中国境内设立 100%持股的 HoldCo B （HoldCo A 和 HoldCo B 以下统称“HoldCo”），再由 HoldCo B 于新加坡设立全资子公司 BidCo，作为未来拟实施本次收

购的主体。

2、本次收购的实施基于以下先决条件的实现：

（1）就本次收购行为，各方已经分别取得了必要的批准和授权，包括董事会、股东（大）会及有关主管部门的批准、备案或授权；

（2）BidCo 向星科金朋所发出的附条件的收购要约和正式收购要约的先决条件（若有）已获得满足或被有权豁免方予以豁免。

3、长电科技以 26,000 万美元等值人民币认购 HoldCo A 50.98%的股权，芯电半导体以 10,000 万美元等值人民币认购 HoldCo A 19.61%的股权，产业基金以 15,000 万美元等值人民币认购 HoldCo A29.41%的股权。

4、HoldCo B 的认缴出资结构为：HoldCo A 认购出资 51,000 万美元等值人民币，产业基金认购出资 1,000 万美元等值人民币。产业基金还将向 HoldCo B 提供股东贷款 14,000 万美元等值人民币，并享有将贷款转为对 HoldCo B 股本的权利。

5、本次收购所需的全部款项由 BidCo 利用 HoldCo B 的出资款及向金融机构贷款的方式取得。若相关金融机构要求对 BidCo 贷款提供担保，则由本公司向其提供。

6、在本次收购实施完毕满 3 年后的任何时间，产业基金有权选择将其向 HoldCo B 提供的股东贷款转为对 HoldCo B 的出资，该贷款转为出资后对应的股权比例为：[股东贷款本金/（转股前 HoldCo B 注册资本金额+股东贷款本金）]。

7、在本次收购实施完毕满 5 年后，如果产业基金未选择行使《共同投资协议》规定的转股权利，Holdco B 应支付从产业基金提供该股东贷款之日至本次收购实施满 5 年期间的利息，年利率 10%（按每年 365 天计算），于本次收购实施满 5 年后的 60 日内支付。该等利息在本次收购实施满 5 年后一次性计提，之后，Holdco B 应按季度支付利息，并应在本次收购实施完毕 7 年届满之日前偿还全部本息,还款日由产业基金指定。虽有前述规定，在该 5 年期限未届满时，如果本公司违反其与产业基金签署的《售股权协议》，前述股东贷款的利息支付时间应提前至《售股权协议》约定的时间，且前述利率将调整为 15%。如果 HoldCo B 未能还本付息，本公司将承担连带保证责任。

8、在本次收购实施完毕之日（以 BidCo 成为目标公司的股东之日为准）起 24 个月内（以下简称“锁定期”），任何一方向任何第三方转让其持有的 HoldCo A、HoldCo B

的股权应获得其他各方的事先书面同意。前述约定不适用于：(1)一方向其关联方转让；为本协议之目的，关联方是指直接或间接控制本协议任何一方或受该方控制或与该方处于共同控制之下的企业或其它实体；“控制”一词指拥有企业或其它实体百分之五十（50%）以上拥有表决权的股权，或通过合同或其他方式有权决定该企业或其他实体的人事、财务或经营决策（包括拥有任命该企业或其它实体多数董事会成员或总经理或其它主要负责人的权力）；(2)芯电半导体根据《投资退出协议》转让；(3)产业基金根据《售股权协议》转让。

9、受限于《共同投资协议》对长电科技出售和股权的限制，在上述锁定期届满后，芯电半导体和产业基金有权向任何第三方转让其持有的 HoldCo A 的部分或全部股权，但在同等条件下，HoldCo A 的其他股东有优先受让权。

10、受限于《共同投资协议》对长电科技出售和股权的限制，在上述锁定期届满后，若芯电半导体或产业基金拟向第三方转让其持有的 HoldCo A 的股权的，且 HoldCo A 的其他股东不行使优先受让权的，则 HoldCo A 的其他股东有权要求按照同等条件一同向第三方转让其持有的 HoldCo A 的股权。

11、各方进一步同意，在投资方仍持有 HoldCo A 的股权的情形下，长电科技不得转让其持有的 HoldCo A 的股权。

当投资方根据本协议、《投资退出协议》或《售股权协议》的约定向长电科技转让 HoldCo A 及/或 HoldCo B 的股份并成为长电科技股东的情况下，投资方承诺其对于持有的长电科技的股权将遵守适用法律及中国证券监督管理委员会监管规则所确定的限售期的相关规定。

同时，产业基金承诺在持有长电科技股权的期间，在涉及长电科技日常经营管理事项上与长电科技目前第一大股东江苏新潮科技集团有限公司保持一致行动，可另行签署一致行动协议。

12、HoldCo 和 BidCo 的董事会各由七位董事组成。其中，本公司有权在 HoldCo 和 BidCo 的董事会各委派四名董事，产业基金有权在 HoldCo 和 BidCo 的董事会各委派两名董事，芯电半导体有权在 HoldCo 和 BidCo 的董事会各委派一名董事。经各方协商一致，可以对董事会董事数量及构成进行调整。HoldCo 和 BidCo 董事会应当各选举一

名董事担任董事长，董事长由长电科技委派的董事担任。

（二）长电科技与芯电半导体、新潮集团签署的《投资退出协议》主要内容

《投资退出协议》签署于 2014 年 12 月 22 日。

协议签署方：长电科技、新潮集团、芯电半导体

鉴于：长电科技和芯电半导体、国家集成电路产业投资基金股份有限公司（“产业基金”）产业基金已签订了投资协议，根据投资协议，芯电半导体出资 10,000 万美元，认购 HoldCo A 19.61%的股权（“标的股权”），并通过 HoldCo A 所直接或间接持股的认购主体投资新加坡上市公司相应股份。

现各方经友好协商，就投资退出事宜，达成协议如下：

1、投资方退出指本次收购实施完毕后，长电科技收购芯电半导体持有的苏州长电新科投资有限公司（即 HoldCo A）19.61%的股权。投资方退出方式如下：

（1）经长电科技及芯电半导体协商一致同意进行投资退出的，长电科技收购标的股权的方式由长电科技及芯电半导体协商后通过发行证券方式、支付现金方式或中国证券监管部门认可的其他方式进行，长电科技收购标的股权的价格将在综合考虑境内外同行业上市公司估值水平的基础上，反映相关股权的公允价值，且不考虑《共同投资协议》中产业基金向 HoldCo B 提供的股东贷款的利息，由长电科技及芯电半导体协商确定。

（2）芯电半导体出售权

（i）若长电科技及芯电半导体按照本协议约定经过友好协商后未能就长电科技收购标的股权的价格达成一致的，芯电半导体有权决定将持有的全部标的股权向长电科技出售，且有权在中国证券监管部门许可的范围内选择长电科技收购对价的支付方式，长电科技不得拒绝，长电科技收购价格按照下列公式确定，且应当自收到芯电半导体发出出售通知之日起 6 个月内与其签订相关的股权转让协议；

（ii）出售价格=出资额*（1+Rp）^{n}；

（iii）其中：Rp 不低于 10%，不高于 12%；n 表示芯电半导体的投资资金全部支付至 HoldCo A 至长电科技及芯电半导体就上述投资退出事宜签署协议之日之间的天数除以 365 天。对于签署协议之日与交割日之间，芯电半导体应享有的收益同样按上述方

式计算，具体为：出资额* $[(1+Rp)^m-(1+Rp)^n]$，其中：m 表示芯电半导体的投资资金全部支付至 HoldCo A 至投资退出涉及的标的股权过户全部完成交割之日之间的天数除以 365 天，由长电科技以现金方式另行向芯电半导体进行支付。

（3）长电科技及芯电半导体应积极配合尽快通过发行证券方式使标的股权在星科金朋股份交割完毕后转换为长电科技股份。

2、如长电科技采取发行证券方式收购标的股权，则新增股份的发行价格应在符合届时有效的中国法律法规的规定、中国证券监管部门的监管要求及中国证券市场的交易惯例的原则下，以下列价格中较低者为准：（1）本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日长电科技股票交易均价的 90%；（2）本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 60 个交易日长电科技股票交易均价的 90%；（3）本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前者 120 个交易日长电科技股票交易均价的 90%。

3、若在长电科技收购标的股权事项公告后 18 个月内长电科技未能取得股东大会或中国证券监管部门就上述事项的批准的，则芯电半导体有权不经长电科技同意向任何其他方转让其所持股份，或要求新潮集团以支付现金的方式协议收购芯电半导体持有的全部标的股权，长电科技及新潮集团不得拒绝。协议收购的对价按本协议约定的公式计算，如果由于长电科技或新潮集团原因导致长电科技未能取得股东大会或中国证券监管部门就上述事项的批准的，Rp 应调整为 15%。

4、若长电科技的股东大会最终未批准根据本协议发生的投资退出交易，则芯电半导体除了有权不经长电科技同意向任何其他方（包括长电科技的竞争对手）转让其所持股份，或要求新潮集团依上述规定以支付现金的方式协议收购全部标的股权以外，还有权要求长电科技向其支付出资额的 5%作为赔偿金，长电科技不得拒绝。

4、在芯电半导体行使本协议约定的出售权后 18 个月内，如长电科技（或其关联方）转让目标公司股权的作价高于长电科技收购标的股权的收购对价，则长电科技收购标的股权的收购对价应自动上调至该较高的作价（按照同期银行贷款利率计算的时间成本导致的价格提高除外）。

5、在本协议的同时或之后，芯电半导体之外的任何第三方如以优于本协议项下的收购收益率予以投资的，芯电半导体应比照相应年化收益率条件自动享受同等待遇。

（三）长电科技、新潮集团与产业基金签署的《售股权协议》主要内容

《售股权协议》签署于 2014 年 12 月 22 日。

协议签署方：长电科技、新潮集团、产业基金

鉴于：

1、长电科技和产业基金、芯电半导体已签订了共同投资协议，根据共同投资协议，产业基金出资 15,000 万美元，认购 HoldCo A 29.41%的股权（“标的股权 A”），并通过 HoldCo A 及 HoldCo B 所直接或间接持股的 BidCo 投资星科金朋相应股份。

2、根据投资协议，产业基金向 HoldCo B 出资 1,000 万美元，向 HoldCo B 提供股东贷款 14,000 万美元（“股东贷款”），并有权将股东贷款转换为对 HoldCo B 的出资（该两笔出资形成的产业基金持有的 HoldCo B 的股权称为“标的股权 B”，与标的股权 A 单独或合计称为“标的股权”）。

3、各方希望订立本协议，对售股权作出规定，产业基金有权按《售股权协议》条款的规定，要求长电科技向产业基金购买标的股权。

各方达成协议如下：

1、售股权

产业基金应享有选择权（“售股权”），要求长电科技按本协议条款规定，向产业基金收购其持有的 HoldCo A 和 HoldCo B 的股权，长电科技有义务按本协议条款规定收购标的股权，如长电科技未按照约定收购标的股权，产业基金有权要求长电科技承担赔偿责任。

2、售股权行使时间

（1）收购股份交割满一年后，产业基金有权行使关于标的股权 A 的售股权。

（2）如果收购股份交割满一年之前出现下述情况，产业基金有权在出现下述情况时行使关于标的股权 A 的售股权：

1）芯电半导体根据投资协议要求长电科技回购芯电持有目标公司的全部或部分股

权；

2）星科金朋在收购股份交割后，在财务、融资、知识产权、重大合同的延续等方面出现或预期出现重大不利变化。

（3）本次收购股份交割满三年后，产业基金有权行使关于标的股权 B 的售股权。

（4）如果本次收购股份交割满三年之前出现下述情况，产业基金有权在出现下述情况时行使关于标的股权 B 的售股权：

1）长电科技第一大股东或实际控制人发生变化；

2）星科金朋在收购股份交割后，在财务、融资、知识产权、重大合同的延续等方面出现或预期出现重大不利变化；

3）星科金朋 2017 年度的经营状况未达到董事会届时要求的合理目标。

（5）长电科技及产业基金应积极配合尽快通过发行证券方式使标的股权在星科金朋股份交割完毕后转换为长电科技股份，如条件允许，星科金朋股份交割完毕后也可早于本协议约定时间转换为长电科技股份。

3、售股权收购对价支付方式

产业基金在行使售股权时有权要求长电科技以向产业基金发行股份或其他证券方式支付标的股权收购对价（“发行证券方式收购”），也有权直接要求长电科技以现金方式支付标的股权收购对价（“支付现金方式收购”）。

4、发行证券方式收购

如产业基金要求发行证券方式收购，则各方应按照如下要求操作：

（1）各方确定的长电科技的收购对价及收购方式应符合届时有效的中国法律法规的规定、中国证券监管部门的监管要求，各方应本着有利于实施长电科技收购的原则，友好协商，对相关事项进行调整。

（2）长电科技和产业基金应就收购对价进行协商，并在综合考虑境内外同行业上市公司估值水平的基础上达成一致，反映标的股权公允价值。长电科技和产业基金应在对标的股权公允价值（该等公允价值应考虑产业基金已分担的中介费用）达成一致后 90 日内签订股权转让协议。

（3）长电科技发行证券的发行价格应在符合届时有效的中国法律法规的规定、中国证券监管部门的监管要求的原则下，以下列价格中较低者为准：（1）发行证券方式收购的董事会决议公告日前 20 个交易日长电科技股票交易均价的 90%；（2）发行证券方式收购的董事会决议公告日前 60 个交易日长电科技股票交易均价的 90%；（3）发行证券方式收购的董事会决议公告日前 120 个交易日长电科技股票交易均价的 90%；（4）届时中国法律法规的规定、中国证券监管部门的监管要求允许的更低价格。

5、支付现金方式收购

如产业基金要求支付现金方式收购，则各方应按照如下要求操作：

（1）长电科技和产业基金按协议规定确定标的股权公允价值（该等公允价值应考虑产业基金已分担的中介费用）。

（2）长电科技和产业基金应在对标的股权公允价值达成一致后 90 日内签订股权转让协议。

（3）长电科技应尽最大努力履行支付现金方式收购必要的内部议事程序及审批手续，包括但不限于获得长电科技董事会、股东大会（如需）批准。

6、约定回报价格收购

（1）在如下情形发生时，产业基金有权要求长电科技按照协议约定的回报价格以现金方式收购标的股权（“约定回报价格收购”）：

1）产业基金要求发行证券方式收购后 18 个月内，发行证券方式收购未能获得长电科技股东大会批准、中国证券监管部门批准或者由于其他原因未能完成，且产业基金不同意延长时间；

2）产业基金要求支付现金方式收购或发行证券方式收购后 90 日内，产业基金与长电科技未能就收购对价达成一致或未能在收购对价达成一致后 90 日内签署股权转让协议。

（2）回报价格为如下价格中的较高者

1）按照出资额*（1+R）^{n} 计算的固定价格

其中：R=10%；

n 表示产业基金将出资额汇入 HoldCo 账户之日（含当日）至股权转让交割日（含当日）之间的天数除以 365 天。

2)如果芯电半导体要求长电科技回购芯电半导体持有 HoldCo A 股权的回报价格年化收益率超过本协议约定的回报价格（就该回报价格对应的 HoldCo 整体公允价值而言），该较高的回报价格自动适用于产业基金。

7、18 个月内收购对价调整机制

（1）在长电科技以支付现金方式收购标的股权的股权转让交割日后 18 个月内，如长电科技（或其关联方）转让 HoldCo 股权（或以资产出售、转让 HoldCo 下属公司股权等方式达到前述类似效果）的作价高于长电科技收购标的股权的收购对价(但时间成本造成价格差异除外)，则长电科技收购标的股权的收购对价应自动上调至该较高的作价。

（2）如长电科技已经按照协议约定的回报价格支付收购对价的，应将上述回报价格与按照前款自动调整后的价格的差额部分按照产业基金要求的时间以现金方式支付给产业基金，产业基金应给予长电科技合理的准备时间。

8、新潮集团的保证

（1）新潮集团对长电科技在本协议项下的义务和责任承担连带保证责任，担保范围包括但不限于：

1）长电科技按照本协议约定与产业基金签署股权转让协议，收购标的股权的义务；

2）长电科技按照本协议约定向产业基金支付收购对价的义务；

3）长电科技按照本协议约定应承担的违约责任；

4）产业基金主张本协议约定的权利发生的合理费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

（2）长电科技和新潮集团同意，如果由于长电科技或新潮集团原因导致就标的股权 A 出现本协议约定的情形（产业基金要求发行证券方式收购后 18 个月内，发行证券方式收购未能获得长电科技股东大会批准、中国证券监管部门批准或者由于其他原因未

能完成，且产业基金不同意延长时间），新潮集团应当将持有权益用于为 HoldCo B 对产业基金提供的股东贷款的本息偿还和支付义务提供质押担保，且股东贷款的利息应成为立即应支付，年利率从 10%调升至 15%。

8、长电科技的董事和股份结构

（1）长电科技和新潮集团同意，在产业基金就标的股权 A 行使售股权而成为长电科技股东且持有股份不低于长电科技总股本的 3%时，将根据有关法律法规和监管规则，将支持产业基金向长电科技提名的 2 名人士选举为董事；在产业基金就标的股权 B 行使售股权时，提名董事人数不增加。若产业基金股份少于长电科技总股本的 3%，则应退出董事席位。本次共同投资完成后至产业基金就标的股权 A 行使售股权前，产业基金有权向长电科技提名 1 名董事。

（2）产业基金在就标的股权 B 行使售股权前，将作出妥善安排，以保证在长电科技的实际拥有、支配的股份表决权比例不超过新潮集团，包括但不限于在不违反有关法律法规和监管规则的前提下对股份的减持、投票权委托、一致行动作出安排。

（四）产业基金、长电新科（即 HoldCo A）与长电新朋（即 HoldCo B）签署的《债转股协议》主要内容

《债转股协议》签署于 2014 年 12 月 22 日。

协议签署方：产业基金、长电新科（即 HoldCo A）与长电新朋（即 HoldCo B）

1、债转股选择权行使时间

（1）收购股份交割满三年后，产业基金有权行使债转股选择权。

（2）如果收购股份交割满三年之前出现下述情况之一的，产业基金有权行使债转股选择权：

1）长电科技第一大股东或实际控制人发生变化；

2）星科金朋在收购股份交割后，在财务、融资、知识产权、重大合同的延续等方面出现或预期出现重大不利变化；

2、未行使债转股选择权时的股东贷款偿还

产业基金未在收购股份交割五年内行使债转股选择权的，HoldCo B 应按照如下约定计算并向产业基金偿还和支付股东贷款本息，本协议另有约定的除外：

（1）自产业基金提供股东贷款之日至本次收购股份交割满五年之日期间，股东贷款利息按照年利率 10%（按每年 365 天计算）以及前述期间的实际天数计算。HoldCo B 应于收购股份交割满五年之日起 60 日内支付该等利息；

（2）本次收购股份交割满五年后，HoldCo B 应按季度支付利息。其中，本次收购股份交割满五年之日起每三个月届满为一个季度；股东贷款利息按照年利率 10%（按每年 365 天计算）以及每个季度的实际天数计算。HoldCo B 应在前述每个季度届满后 10 日内支付该季度利息；

（3）股东贷款本金应在本次收购股份交割满 7 年之日还本付息。

3、股东贷款的提前偿还

（1）收购股份交割满五年之前，若出现《售股权协议》约定的情形（即产业基金要求发行证券方式收购标的股权 A 后 18 个月内，发行证券方式收购由于长电科技或新潮集团原因未能获得长电科技股东大会批准、中国证券监管部门批准或者由于其他原因未能完成，且产业基金不同意延长时间的情形），HoldCo B 应立即偿还股东贷款本息，并且股东贷款利息及支付时间按照下述方式相应调整：

1）计息期间自产业基金提供股东贷款之日至股东贷款利息实际支付完毕日期间的实际天数计算；

2）股东贷款利息按照年利率 15%（按每年 365 天）计算。

4、股东贷款的担保

长电科技、新潮集团为 HoldCo B 在本协议项下股东贷款本息的偿还责任提供连带责任担保。HoldCo B 应在本协议签署同时向产业基金提供长电科技关于上述担保的担保函。

四、分手费契约的主要内容

本次交易中，长电科技、新潮集团与星科金朋签署了《关于分手费的契约》及《关

于分手费的补充契约》，其主要内容如下：

1、长电科技分手费安排

（1）长电科技分手费安排（A）

若在截止日期（附生效条件的要约公告后 6 个月），存在以下情形：

1）仍未取得根据现行有效的相关法律法规，本次收购所需取得的中国相关监管部门的审批或备案；或上述中国相关监管部门的审批或备案在截止日期已失效；或

2）要约人未就本次交易所涉及的美国、韩国反垄断审查事宜进行相关申报；或因申报不完整而被相关监管机构拒绝受理；或要约人撤回了相关申报；

则长电科技将向目标公司支付 2,340 万美元的分手费。前述中国相关监管部门的审批或备案包括发改委、江苏省商务厅、所在地外汇管理局对于本次交易的备案或核准，但不包括中国商务部对于本次交易涉及的经营者集中事宜的审查。

（2）长电科技分手费安排（B）

若在截止日期（附生效条件的要约公告后 6 个月），根据届时有效的相关法律法规，本次收购需要取得除前述发改委、商务厅、外管局以外的其他中国监管部门的审批或备案，但相关审批或备案未被取得或已失效，则长电科技将向目标公司支付 700 万美元的分手费。

上述长电科技分手费安排须经长电科技股东大会审议通过。

2、新潮集团分手费安排

若在截止日期（附生效条件的要约公告后 6 个月），本次交易及相关事项仍未取得长电科技股东大会批准，或本次交易未通过中国商务部对于本次交易涉及的经营者集中事宜的审查，或中国商务部对于本次交易涉及的经营者集中事宜的审查通过已失效，则新潮集团将向目标公司支付 700 万美元的分手费。

上述截止日期可经各方商议并共同确认后相应延期。

3、分手费支付安排

若前述需支付分手费的情况发生，长电科技或新潮集团应在要约人公告因无法获得

前述所需的批准、审批或备案而导致本次交易终止之日起两个工作日内支付分手费。

但前述长电科技分手费安排（A）、长电科技分手费安排（B）及新潮集团分手费安排不会重复支付。

4、分手费契约的终止

分手费契约将在以下情况发生时终止：

（1） 要约人向星科金朋股东派发正式要约的文件；

（2） 上述长电科技分手费安排（A）、长电科技分手费安排（B）及新潮集团分手费安排之一被触发并支付；

（3） 经星科金朋、长电科技、新潮集团三方书面同意终止分手费契约。

第六章 本次交易的合规性分析

一、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

工业和信息化部发布的《集成电路行业“十二五”发展规划》中提出集成电路产业是全球主要国家或地区抢占的战略制高点；将推进资源整合，培育具有国际竞争力大企业作为政策措施，按照战略协调、资源配置有效的原则，规范推进与各类所有制企业的并购重组；鼓励企业扩大国际合作，整合并购国际资源，设立海外研发中心，积极拓展国际市场。本次收购将有利于本公司与目标公司之间的技术、市场、产品优势互补，发挥规模经济优势，进一步提高本公司的综合竞争力，有利于本公司的长远发展。本次收购方案符合本公司发展战略，符合本公司和全体股东的整体利益。同时，本次交易符合国家产业政策，依据中国、新加坡等地的相关法律法规进行，不涉及违反有关中国环境保护、土地管理等法律和行政法规的情况。

根据《反垄断法》、《国务院关于经营者集中申报标准的规定》等相关法律法规的规定，经营者集中达到下列标准之一的，经营者应当事先向国务院商务主管部门申报，未申报的不得实施集中：（一）参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过 100 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 4 亿元人民币；（二）参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过 20 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 4 亿元人民币。本次交易达到了经营者集中的申报标准，按照相关规定，公司将进行经营者集中申报，在获得国务院反垄断执法机构作出的不实施进一步审查的决定或对经营者集中不予禁止的决定后，方可实施本次交易。

综上所述，本次交易符合《重组办法》第十一条第（一）项之规定。

二、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件

本次交易不涉及发行股份，不影响公司的股本总额和股权结构，不会导致公司的股权结构和股权分布不符合股票上市条件。公司在最近三年内无重大违法行为，财务会计

报告无虚假记载。

综上所述，本次交易符合《重组办法》第十一条第（二）项之规定。

三、本次交易所涉及资产定价公允，不存在损害本公司和股东合法权益的情形

本次交易对价的确定因素包括但不限于：（1）目标公司净资产规模，（2）目标公司的品牌和渠道对于本公司的战略价值，（3）收购完成后的协同效应，（4）目标公司市值。本次交易所涉及目标公司的定价方式采用市场化原则，交易价格公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

本次交易依法履行相关程序，公司董事会已聘请具有资质的相关中介机构出具法律意见书和独立财务顾问报告，并将根据法律法规的相关监管要求履行监管报批等相关程序，在交易过程中不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

综上所述，本次交易符合《重组办法》第十一条第（三）项之规定。

四、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，不涉及债权债务转移的情况

本次交易标的为目标公司股权。根据新加坡律师尽职调查情况，目标公司为依据新加坡法律合法设立、有效存续的公司，且目标公司章程中未包含任何可能会阻碍本次交易正常进行的条款。本次交易涉及的资产权属清晰，本次交易将通过要约收购进行，股权过户不存在法律障碍。

考虑到本次交易将导致星科金朋控股股东发生变化，星科金朋将根据其现有银行贷款及发行在外的优先票据的相关条款约定进行债务重组。截至本报告书出具之日，长电科技已经为可能发生的相关票据提前赎回或贷款提前偿还进行了债务重组安排，长电科技已与星展银行就债务重组安排签署了委任函，星展银行将通过向目标公司提供上限为8.9 亿美元的过桥贷款对目标公司进行债务重组，该过桥贷款额度将足够覆盖目标公司

全部的债务重组需求，后续星展银行将通过退出贷款及协助目标公司发行债券的方式进一步对目标公司的债务进行替换，届时目标公司将与星展银行签署相关协议。

综上所述，本次交易符合《重组办法》第十一条第（四）项之规定。

五、本次交易有利于本公司增强持续经营能力，不存在可能导致收购完成后本公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

目标公司主营业务明确，根据 Gartner 公司报告，目标公司 2013 年为全球第四大半导体封装测试公司（以收入排名），与本公司所处行业、主营业务一致，本次交易不会导致本公司主营业务发生变化。

目标公司业务覆盖欧美及亚洲多个地区，本次交易的实现将对本公司境外业务开展带来一定的协同效应，如果收购完成后双方整合顺利，将能够实现全方位的优势互补，拓展现有客户及市场，有利于本公司增强持续经营能力。本次交易不会导致本公司重组后存在主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

综上所述，本次交易符合《重组办法》第十一条第（五）项之规定。

六、本次交易有利于本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

本公司经营管理体系完善、人员机构配置完整，具有独立自主的经营能力。本次交易前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其关联人。本次要约收购不构成关联交易，目标公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与本公司的控股股东、实际控制人及其关联人保持独立。本次交易亦不会导致上市公司的控制权及实际控制人发生变更，上市公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

综上所述，本次交易符合《重组办法》第十一条第（六）项之规定。

七、本次交易有利于本公司继续保持健全有效的法人治理结构

本次交易前，本公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等法律法规的要求，建立了比较规范、稳健的企业法人治理结构，并建立了比较完善的内部控制制度，从制度上保证股东大会、董事会和监事会的规范运作和相应职权的行使。

本次交易完成后，本公司将继续保持健全有效的法人治理结构，并将依据相关法律、法规和《公司章程》等的要求不断进行完善。

综上所述，本次交易符合《重组办法》第十一条第（七）项之规定。

经审慎核查，本次交易的独立财务顾问和境内法律顾问认为，本次交易符合《重组办法》第十一条的相关规定。

第七章 管理层讨论与分析

一、董事会对本次交易的定价依据及公平合理性的分析

（一）本次交易的定价依据

本次交易收购价格是在综合考虑并全面评估目标公司的市值、净资产、品牌、技术和渠道价值等因素的基础上确定的。

（二）交易价格合理性的分析

1、目标公司规模处于世界一流水平，技术全球领先

星科金朋是一家主要从事半导体封装测试的新加坡上市公司。目标公司 2013 年收入在封测行业全球排名第四。目标公司的技术专利数量稳居封测行业前列，并跻身半导体行业前 20 名。目标公司的先进封装业务收入占总收入一半以上，具有显著竞争优势。市场方面，目标公司 69%的收入来自于美国一线客户，具有较强的市场竞争力。目标公司在倒装芯片和嵌入式晶圆级扇出技术领域技术优势明显，领先的技术未来将有助于公司盈利能力的进一步提升。

2、从本次交易定价相对估值分析定价合理性

1）本次交易作价相对估值水平

本次交易中目标公司（剔除台湾子公司）100%股权的交易价格为 7.8 亿美元，约合 48 亿元人民币。目标公司（剔除台湾子公司）2013 年末、2014 年 6 月末净资产分别合人民币 565,503 万元、552,412 万元，因此，目标公司（剔除台湾子公司）100%股权相对估值水平如下：

市净率		
项目	**2013/12/31**	**2014/06/30**
净资产（万元）	565,503	552,412
交易价格（万元）	479,918	479,918
市净率（P/B）	0.85	0.87

注：目标公司管理层未提供 2014 年 9 月 30 日目标公司剔除台湾子公司的净资产情况，故采用 2014 年 6 月 30 数据计算

因公司 2013 年与 2014 年 1-6 月净利润为负，市盈率不具有参考意义。封装测试行

业对机器设备与资本投入依赖程度相对较高，采用市净率估值具有可比性与可参考性。

2）与可比同行业上市公司相对估值情况对比分析

星科金朋主营业务为半导体封装与测试，目前国内与之经营业务较为类似的主要包括晶方科技、华天科技、太极实业、通富微电及本公司，境外与之经营业务较为类似的公司包括日月光、矽品、Amkor 和力成科技。截至 2014 年 12 月 19 日，上述同行业上市公司市净率情况如下：

证券代码	证券简称	市净率(P/B)	
		按 2013/12/31 净资产计算	按 2014/6/30 净资产计算
603005.SH	晶方科技	12.99	6.63
600584.SH	长电科技	4.51	4.44
002185.SZ	华天科技	5.53	4.96
600667.SH	太极实业	4.28	4.27
002156.SZ	通富微电	2.46	2.42
	境内可比公司平均	**5.95**	**4.54**
ASX.US	日月光	2.33	2.34
SPIL.US	矽品	2.23	2.12
AMKR.US	Amkor	1.53	1.47
6239.TT	力成科技	1.36	1.36
	境外可比公司平均	**1.86**	**1.82**
	总体平均	**4.14**	**3.33**

以截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 6 月 30 日星科金朋净资产计算的交易标的定价市净率分别为 0.85 倍、0.87 倍，而按 2013 年 12 月 31 日、2014 年 6 月 30 日净资产计算，境内同行业上市公司市净率均值分别为 5.95 倍、4.54 倍，交易标的定价市净率远远低于国内同行业上市公司平均水平；按 2013 年 12 月 31 日、2014 年 6 月 30 日净资产计算，境外同行业上市公司市净率均值分别为 1.86 倍和 1.82 倍，交易标的的定价市盈率亦低于境外同行业上市公司平均水平。

目标公司估值低于国内同行水平，主要系公司产品、目标市场存在一定的差别，以及不同上市地估值存在一定的差异所致。目标公司低于境外同行水平，主要系目标公司

近期运营情况不佳及盈利能力差异所致。

比较本次交易标的定价与目前国内外同行业上市公司市净率情况，本次交易定价公允、合理。

（三）董事会对交易价格公允性的意见

本次交易价格乃基于公平合理的原则确定，已综合考虑了包括净资产、品牌、技术、渠道价值和市值等影响目标公司股权价值的多种因素。本公司董事会认为交易价格在合理且公允的区间之内，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

（四）独立董事对交易价格公允性的意见

按照国家有关法律、法规及中国证监会的有关规定，公司独立董事认为本次交易价格乃基于公平合理的原则，通过谈判确定，并已综合考虑了多方面的影响因素，交易价格合理公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

二、董事会关于本次交易对本公司影响的讨论与分析

（一）本次交易前本公司财务状况和经营成果的讨论与分析

长电科技近两年及一期的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

资产负债表项目	**2014-09-30**	**2013-12-31**	**2012-12-31**
资产总计	1,001,115.69	758,252.66	701,037.93
负债合计	603,029.84	494,263.02	441,482.10
所有者权益	398,085.85	263,989.64	259,555.82
归属于母公司所有者权益	373,383.31	243,235.16	242,276.73
利润表项目	**2014 年 1-9 月**	**2013 年度**	**2012 年度**
营业收入	470,634.74	510,206.01	443,615.97
营业成本	375,371.21	409,172.42	380,428.74
销售费用	6,171.45	8,277.90	6,702.76
管理费用	53,100.75	67,490.50	53,928.57
财务费用	16,905.73	17,626.14	15,725.51
营业利润	18,186.38	2,680.48	-15,025.63
利润总额	20,608.51	7,850.98	6,061.90

净利润	16,869.84	4,880.64	3,927.04
归属于母公司股东的净利润	12,689.78	1,112.22	1,041.00
现金流量表项目	**2014 年 1-9 月**	**2013 年度**	**2012 年度**
经营活动产生的现金流量净额	59,639.60	81,032.23	50,625.23
投资活动产生的现金流量净额	-59,810.38	-114,452.63	-101,952.45
筹资活动产生的现金流量净额	177,957.81	39,666.07	54,800.35
每股指标	**2014 年 1-9 月 /2014-06-30**	**2013 年度 /2013-12-31**	**2012 年度 /2012-12-31**
基本每股收益（元）	0.15	0.01	0.01
归属于母公司股东的每股净资产（元）	3.79	2.85	2.84

资料来源：公司定期报告
注：以上数据为合并报表数据，以下分析如无特殊说明，均以合并财务报表数据为基础进行分析

1、本次交易前本公司的财务状况

1) 资产构成分析

截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日，公司合并资产负债表的主要资产构成如下表所示：

单位：万元

项目	2014-09-30		2013-12-31		2012-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：						
货币资金	264,679.25	26.44%	86,925.11	11.46%	69,529.97	9.92%
应收票据	34,491.35	3.45%	35,168.28	4.64%	38,068.62	5.43%
应收账款	67,056.04	6.70%	57,088.98	7.53%	49,318.12	7.04%
预付款项	7,154.53	0.71%	4,665.72	0.62%	4,462.91	0.64%
其他应收款	1,950.14	0.19%	946.36	0.12%	212.22	0.03%
存货	77,137.65	7.71%	62,837.54	8.29%	59,088.93	8.43%
其他流动资产	28,717.20	2.87%	-	-	-	-
流动资产合计	**481,186.16**	**48.06%**	**247,631.99**	**32.66%**	**220,680.78**	**31.48%**
非流动资产：						
可供出售金融资产	926.71	0.09%	-	-	-	-
长期股权投资	5,314.73	0.53%	6,051.82	0.80%	6,227.45	0.89%

项目	2014-09-30		2013-12-31		2012-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
固定资产	383,516.44	38.31%	405,881.58	53.53%	389,144.26	55.51%
在建工程	85,798.67	8.57%	54,129.26	7.14%	38,410.42	5.48%
无形资产	21,650.04	2.16%	22,186.92	2.93%	22,970.42	3.28%
长期待摊费用	20,709.73	2.07%	20,465.87	2.70%	21,684.41	3.09%
递延所得税产	2,013.21	0.20%	1,905.23	0.25%	1,920.19	0.27%
非流动资产合计	**519,929.53**	**51.94%**	**510,620.68**	**67.34%**	**480,357.15**	**68.52%**
资产总计	**1,001,115.69**	**100.00%**	**758,252.66**	**100.00%**	**701,037.93**	**100.00%**

资料来源：公司定期报告

如上表所示，报告期各期末，本公司资产总额稳步上升，整体资产结构较为稳定。固定资产是公司资产的主要组成部分，截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日，本公司非流动资产占资产总额的比例分别为 68.52%、67.34%和 51.94%。

①流动资产构成分析

本公司的流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款和存货构成。

本公司应收票据占资产总额比例持续下降，截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日，分别为 5.43%、4.64%和 3.45%，2014 年 9 月末应收票据金额与上年末持平。本公司应收账款占资产总额比例保持稳定，截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日，分别为 7.04%、7.53%和 6.70%。本公司的存货规模保持稳定增长，但占资产总额比例略有下降，截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 6 月 30 日，存货占资产总额比例分别为 8.43%、8.29%和 7.71%。

本公司的货币资金占资产总额的比例前两年保持平稳，2014 年有较大幅度的上升，截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日，分别为 9.92%、11.46%和 26.44%，主要系本公司非公开发行 A 股股票的募集资金及非公开定向债务融资工具资金到账所致。货币资金大幅增加也导致其他相对稳定的科目占总资产的比例有所下降。

②非流动资产构成分析

公司的非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产和长期待摊费用构成。

公司固定资产占资产总额比例有所下降，截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日，分别为 55.51%、53.53%和 38.31%，主要原因系公司对部分技术陈旧设备进行处置及货币资金大幅增加所致。

公司在建工程占资产总额比例有所上升，截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日，分别为 5.78%、7.14%和 8.57%。公司在建工程主要为厂房和设备，期末金额有所增加主要系新增项目及新厂房基建所致。

公司无形资产占资产总额比例略有下降，截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日，分别为 3.28%、2.93%及 2.16%，主要原因系土地使用权、技术使用费及软件摊销、账面净值下降所致。

公司长期待摊费用占资产总额比例持续下降，截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日，分别为 3.09%、2.70%及 2.07%，主要原因系费用持续摊销所致。

2) 负债构成分析

截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日，公司合并资产负债表的负债构成如下表所示：

单位：万元

项目	2014-09-30		2013-12-31		2012-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：						
短期借款	209,139.01	34.68%	202,425.10	40.95%	179,965.70	40.76%
交易性金融资产	-	-	-	-	53.12	0.01%
应付票据	29,401.00	4.88%	44,509.00	9.01%	30,749.50	6.97%
应付账款	85,196.45	14.13%	72,536.38	14.68%	89,140.40	20.19%
预收款项	3,576.07	0.59%	6,011.95	1.22%	4,938.46	1.12%
应付职工薪酬	7,844.89	1.30%	8,087.73	1.64%	6,314.04	1.43%
应交税费	2,858.32	0.47%	-24,512.66	-4.96%	-24,202.79	-5.48%

项目	2014-09-30		2013-12-31		2012-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付利息	3,905.53	0.65%	2,854.27	0.58%	2,485.66	0.56%
其他应付款	3,126.53	0.52%	2,638.66	0.53%	2,203.76	0.50%
一年内到期的非流动负债	51,611.13	8.56%	19,219.82	3.89%	52,487.70	11.89%
其他流动负债	100,000.00	16.58%	60,000.00	12.14%	40,000.00	9.06%
流动负债合计	**496,658.93**	**82.36%**	**393,770.25**	**79.67%**	**384,135.56**	**87.01%**
非流动负债：						
长期借款	76,069.26	12.61%	74,643.64	15.10%	37,512.30	8.50%
长期应付款	3,253.64	0.54%	2,275.43	0.46%	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	77.33	0.02%
其他非流动负债	27,048.00	4.49%	23,573.69	4.77%	19,756.91	4.48%
非流动负债合计	106,370.91	**17.64%**	**100,492.77**	**20.33%**	**57,346.54**	**12.99%**
负债合计	**603,029.84**	**100.00%**	**494,263.02**	**100.00%**	**441,482.10**	**100.00%**

资料来源：公司定期报告

如上表所示，流动负债是公司负债的主要组成部分，截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日，占总负债比例分别为 87.01%、79.67%和 82.36%，流动负债占比呈一定幅度的波动。

①流动负债构成分析

短期借款、应付账款、一年内到期的流动负债和其他流动负债是公司流动负债的主要构成部分。截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日，四者合计占总负债比分别为 81.90%、71.66%和 73.95%。

2013 年公司短期借款期末余额为 202,425.10 万元，较 2012 年末上升 12.48%。2014 年 9 月末公司短期借款余额为 209,139.01 万元，较上年末上升 3.32%，新增短期借款主要用于补充流动资金及信用证到期支付。

2013 年公司应付账款期末余额为 72,536.38 万元，较 2012 年末下降 18.63%。 2014 年 9 月末公司应付账款余额为 85,196.45 万元，较上年末增加 12,660.07 万元，略低于 2012 年末水平。

2013 年公司一年内到期的非流动负债期末余额为 19,219.82 万元，较上年降低 63.38%，主要系抵押借款与保证借款归还所致。2014 年 9 月末，一年内到期的非流动负债相比上年末增加 32,391.31 万元，主要原因系长期借款一年内到期所致。

2013 年公司其他流动负债期末余额为 60,000 万元，较上年增加 50.00% ，主要系非公开定向债务融资增加。2014 年 9 月末公司其他流动负债较上年末增加 40,000 万元，系发行非公开定向债务融资工具所致。

②非流动负债构成分析

非流动负债的主要构成部分为长期借款，2013 年公司长期借款期末余额为 74,643.64 万元，较 2012 年年末上升 98.98%，主要系长期流动资金借款及项目贷款增加所致。2014 年 9 月末，长期借款余额与上年末基本持平。

3) 偿债能力分析

截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日，公司合并报表口径的偿债能力相关分析指标如下表：

项目	2014-09-30	2013-12-31	2012-12-31
资产负债率	60.24%	65.18%	62.98%
流动比率	0.97	0.63	0.57
速动比率	0.81	0.47	0.42

注：上述财务指标的计算公式为：

（1）资产负债率＝总负债/资产总额；

（2）流动比率＝流动资产/流动负债；

（3）速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债。

由上表可知，公司的资产负债率呈先升后降趋势，截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日，分别为 62.98%、65.18%和 60.24%，公司的长期偿债能力相对稳定。报告期各期末，公司的流动比率、速动比率仍不断上升，公司的短期偿债能力持续增强。

2、本次交易前本公司的经营成果

1) 盈利能力分析

2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-9 月，本公司盈利能力如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	470,634.74	100.00%	510,206.01	100.00%	443,615.97	100.00%
营业成本	375,371.21	79.76%	409,172.42	80.20%	380,428.74	85.76%
销售费用	6,171.45	1.31%	8,277.90	1.62%	6,702.76	1.51%
管理费用	53,100.75	11.28%	67,490.50	13.23%	53,928.57	12.16%
财务费用	16,905.73	3.59%	17,626.14	3.45%	15,725.51	3.54%
营业利润	18,186.38	3.86%	2,680.48	0.53%	-15,025.63	-3.39%
利润总额	20,608.51	4.38%	7,850.98	1.54%	6,061.90	1.37%
净利润	16,869.84	3.58%	4,880.64	0.96%	3,927.04	0.89%
归属于母公司所有者的净利润	12,689.78	2.70%	1,112.22	0.22%	1,041.00	0.23%

资料来源：公司定期报告

2) 营业收入构成情况分析

2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-9 月，本公司主营业务收入按产品类型及地区划分如下：

（1）按产品类型划分

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
芯片封测	449,393.09	95.79%	480,456.13	94.56%	414,840.20	93.84%
芯片销售	19,766.51	4.21%	27,620.04	5.44%	27,213.15	6.16%
合计	**469,159.60**	**100.00%**	**508,076.17**	**100.00%**	**442,053.35**	**100.00%**

资料来源：公司定期报告

（2）按地区划分（国内、国外）

区域	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
国外	294,418.79	62.75%	293,889.42	57.84%	270,894.93	61.28%
国内	174,740.81	37.25%	214,186.75	42.16%	171,158.42	38.72%
合计	**469,159.60**	**100.00%**	**508,076.17**	**100.00%**	**442,053.35**	**100.00%**

资料来源：公司定期报告

由上表可知，公司营业收入主要来源于芯片封测，2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-9 月其收入占比分别为 93.84%、94.56%和 95.79%。2013 年，公司产品结构调整逐步到位，高端封装业务快速增长，销售收入较 2012 年上升了 15.01%。2014 年 1-9 月，公司销售收入较上年同期上升了 22.98%，主要系高端封装产品持续增长、低成本生产基地初步见效所致。

3) 毛利率分析

2012 年度和 2013 年度，本公司按产品类型划分的毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月			2013 年度			2012 年度		
	收入	毛利	毛利率	收入	毛利	毛利率	收入	毛利	毛利率
芯片封测	449,393.09	88,435.19	19.68%	480,456.13	92,008.61	19.15%	414,840.20	55,280.71	13.33%
芯片销售	19,766.51	5,701.22	28.84%	27,620.04	8,353.24	30.24%	27,213.15	7120.15	26.16%
合计	**469,159.60**	**94,136.41**	**20.24%**	**508,076.17**	**100,361.85**	**19.75%**	**442,053.35**	**62,400.86**	**14.12%**

资料来源：公司定期报告

报告期内本公司芯片封测毛利率呈逐年上升的趋势，主要原因系公司高端封测毛利率较高，高端封测销售比重逐年增大所致。

4) 期间费用分析

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比
销售费用	6,171.45	1.31%	8,277.90	1.62%	6,702.76	1.51%
管理费用	53,100.75	11.28%	67,490.50	13.23%	53,928.57	12.16%
财务费用	16,905.73	3.59%	17,626.14	3.45%	15,725.51	3.54%

项目	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比
合计	**76,177.93**	**16.19%**	**93,394.54**	**18.30%**	**76,356.84**	**17.21%**

资料来源：公司定期报告

2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-9 月，本公司的期间费用分别相当于同期营业收入的 17.21%、18.30%和 16.19%。

2013 年度本公司销售费用较 2012 年增加 1,575.14 万元，增幅为 23.50%。2014 年 1-9 月，公司销售费用占营业收入比例为 1.31%，较前两年有所下降，与上年同期持平，总体保持稳定，小幅波动主要由运输费、广告费所致。

2013 年度本公司管理费用较 2012 年增加 13,561.93 万元，占营业收入比例上升 1.07%。2014 年 1-9 月，本公司销售费用占营业收入比例为 11.28%，较上年有所下降，近两年及一期管理费用总体与营业收入匹配，受职工薪酬和研发费用影响略有波动。

2013 年度本公司财务费用较 2012 年增加 1,900.63 万元，2014 年 1-9 月财务费用占营业收入的比例上升 0.14%。本公司财务费用持续增长，其原因系公司贷款规模增加所致。

5) 盈利指标分析

2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-9 月，本公司合并报表口径的主要盈利指标如下：

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
毛利率	20.24%	19.80%	14.24%
净利润率	3.58%	0.96%	0.89%
加权平均净资产收益率	5.10%	0.46%	0.43%

资料来源：公司定期报告

最近两年及一期，本公司毛利率呈逐年增长趋势，体现了公司产品市场竞争力不断增强。近两年及一期，本公司净利润率呈上升趋势，主要原因系公司产品结构更加丰富、高端封测产品占比上升以及成本控制能力进一步增强所致。

本公司的资产负债结构和总资产周转率基本维持稳定，净资产收益率的变动主要系

本公司净利润率变动所致。

（二）对目标公司行业特点和经营情况的讨论与分析

1、行业特点分析

从全球角度来看，2012 年除中国外的全球封测产能都在收缩，全球半导体封测市场需求低迷，到 2013 年有所回升。根据 Gartner 的报告，2013 年全球半导体封测市场总收入 251 亿美元，较 2012 年增长 2.3%。2009 年到 2010 年大幅上升后，2010 年到 2012 年 3 年复合增长率仅为 1.5%。

目前，在半导体封装测试行业，高端技术和高端产品的市场份额仍然由国际巨头占据，如台湾日月光、美国安科、台湾矽品、星科金朋等世界大封装企业。在全球范围内，半导体封装测试行业集中度较高，前五大厂商市场份额占比过半，达 51%。这些厂商的销售收入增长得益于其在先进封装技术上的投入，平均售价的增长带来销售额的不断提升，来自先进封装产品的收入已经超过其总收入的一半。

先进封装将是未来的行业趋势。未来先进封装的增长的主要驱动因素是智能终端需求的增长。由于功耗增加，体积减少，智能终端中对于先进封装的需求越来越高。想要延续半导体向轻薄短小的趋势发展，仅靠半导体制程工艺的提升已经无法达到，以 3D 封装为代表的先进封装则成为延续摩尔定律和拓展半导体范围的技术方向。按照未来半导体发展的趋势和多样性，3D 封装必然成为主流趋势。

此外，半导体封装测试行业趋势还包括：由劳动力密集型向技术密集型转移升级、多系统集成封装需求增加、向芯片制造/中段/倒装全流程一站式服务方向发展等。

基于上述行业趋势与特点，未来世界一流的封测企业，需要在先进封装领域拥有充分的技术积累，并且能够提供一站式服务。

2、目标公司的核心竞争力及行业地位

1) 目标公司的核心竞争力

目标公司公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

①在移动芯片市场中占据主导地位。目标公司拥有庞大的客户群，与领先的大型

移动设备厂商均有密切的合作关系，未来移动设备快速增长将相应带动公司产品销量增长。

②先进封装技术优势明显。目标公司拥有强大的研发能力，在倒装芯片和嵌入式晶圆级扇出技术领域处于行业领先地位。

③坚实的客户基础。目标公司的客户集中于行业中领先的半导体厂商，包括博通、高通、展讯、SanDisk、Marvell 等。客户关系稳定且良好，对目标公司收入持续增长提供了有力的支持。

④拥有强大的知识产权组合。目标公司拥有专利数量业内领先，先进封装技术方面的专利处于世界领先水平。目标公司共计申请专利 2,594 项，分布于美国、新加坡、韩国、中国、台湾，其中 76%的专利在集中于美国，与其销售市场以美国为重点相匹配；目标公司关键核心专利在 300 件左右，主要是 Fan-Out 与芯片凸点倒装方面的专利。

⑤制造业务网络位于韩国、中国上海及台湾、新加坡，与客户及晶圆制造大厂临近。良好的生产布局，有利于目标公司更好地服务客户，提升供货速度，保证供货稳定。

⑥有能力提供整体测试解决方案，高端混合信号测试水平在业内领先。

2) 目标公司的行业地位

星科金朋是世界排名前列的半导体封装测试公司，提供涵盖封装设计、晶圆植球、针探、芯片封装、测试、配送等一整套半导体解决方案。按 2013 年销售额计算，是全球半导体封装测试行业中第四大经营者，占有全球 6%以上的市场份额。

3、目标公司的财务状况

1) 资产构成分析

截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日，目标公司合并资产负债表的主要资产构成如下表所示：

单位：美元千元

项目	2014-09-30		2013-12-31		2012-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：						
货币资金	115,609	4.39%	129,136	5.43%	170,558	7.52%
短期定期存款	61,987	2.36%	42,042	1.77%	39,601	1.75%
应收账款	229,728	8.73%	238,441	10.03%	258,043	11.38%
其他应收款	33,785	1.28%	15,239	0.64%	20,726	0.91%
存货	77,888	2.96%	71,055	2.99%	90,203	3.98%
预付费用以及其他流动资产	24,189	0.92%	18,970	0.80%	24,559	1.08%
流动资产合计	**543,186**	**20.64%**	**514,883**	**21.65%**	**603,690**	**26.61%**
非流动资产：						
长期定期存款	425	0.02%	11,604	0.49%	489	0.02%
固定资产净值	1,668,817	63.40%	1,431,247	60.20%	1,242,950	54.80%
无形资产	34,599	1.31%	35,117	1.48%	36,361	1.60%
商誉	381,487	14.49%	381,487	16.04%	381,487	16.82%
递延所得税资产	185	0.01%	186	0.01%	-	
预付费用以及其他非流动资产	3,405	0.13%	3,146	0.13%	3,299	0.15%
非流动资产合计	**2,088,918**	**79.36%**	**1,862,787**	**78.35%**	**1,664,586**	**73.39%**
资产总计	**2,632,104**	**100.00%**	**2,377,670**	**100.00%**	**2,268,276**	**100.00%**

资料来源：目标公司定期报告

如上表所示，报告期各期末，目标公司资产总额稳步上升，非流动资产比例逐年增加，其中，固定资产是公司资产最主要的组成部分。截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日，本公司非流动资产占资产总额的比例分别为 73.39%、78.35%和 79.36%。

①流动资产构成分析

本公司的流动资产主要由货币资金、短期定期存款、应收账款和存货构成。

目标公司的货币资金占资产总额的比例有所下降，截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日，分别为 7.52%、5.43%和 4.39% ，主要系目标公司

赎回债务融资工具支付资金以及资本支出所致。目标公司存货占资产总额的比例略有下降，截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日，分别为 3.98%、2.99%和 2.96%，2013 年较 2012 年存货水平下降主要由于降低原材料的预付采购而导致。

②非流动资产构成分析

目标公司的非流动资产主要由固定资产、无形资产和商誉构成。

目标公司非流动资产占资产总额比例逐年上升，截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日，分别为 73.39%、78.35%和 79.36%，主要原因系资本支出增加导致固定资产增加。目标公司固定资产占资产总额比例亦是逐年上升，截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日，分别为 54.80%、60.20%和 63.40%，2013 年底较 2012 年底固定资产水平增加的主要原因为目标公司当年资本支出约 5.08 亿美元，超过约 2.96 亿美元的折旧以及马来西亚工厂关闭导致的 0.18 亿美元的固定资产减值损失。

2) 负债构成分析

截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日，公司合并资产负债表的负债构成如下表所示：

单位：美元千元

项目	2014-09-30		2013-12-31		2012-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：						
应付账款及其他应付款	185,181	10.97%	138,004	9.81%	164,301	13.19%
应付固定资产相关款项	183,681	10.88%	141,998	10.09%	42,746	3.43%
预提费用	105,189	6.23%	124,640	8.86%	113,476	9.11%
应交所得税	14,518	0.86%	18,207	1.29%	13,155	1.06%
短期借款	73,000	4.32%	37,947	2.70%	50,690	4.07%
应付关联方款项	29	0.00%	100	0.01%	28	0.00%
流动负债合计	**561,598**	**33.27%**	**460,896**	**32.76%**	**384,396**	**30.86%**
非流动负债：						

项目	2014-09-30		2013-12-31		2012-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	1,064,314	63.05%	874,281	62.14%	792,609	63.63%
递延所得税负债	46,559	2.76%	47,476	3.37%	47,141	3.78%
其他非流动负债	15,663	0.93%	24,228	1.72%	21,532	1.73%
非流动负债合计	**1,126,536**	**66.73%**	**945,985**	**67.24%**	**861,282**	**69.14%**
负债合计	**1,688,134**	**100.00%**	**1,406,881**	**100.00%**	**1,245,678**	**100.00%**

资料来源：目标公司定期报告

如上表所示，目标公司负债总额逐年上升，主要系资本支出较大所致。其中，非流动负债是公司负债的主要组成部分，截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日，占总负债比例分别为 69.14%、67.24%和 66.73%。

①流动负债构成分析

应付账款及其他应付款、应付固定资产相关款项、预提费用和短期借款是目标公司的流动负债的主要构成部分。2013 年目标公司应付账款及其他应付款余额为 13,800.4 万元，较 2012 年末下降 2,630 万美元。2013 年末目标公司应付固定资产相关款项较 2012 年末上升 9,925 万美元，2014 年前三季度末目标公司应付固定资产相关款项较 2013 年末上升 4,168 万美元，主要由于资本支出的增加而导致。

②非流动负债构成分析

非流动负债的主要构成部分为长期借款，2013 年目标公司长期借款期末余额为 87,428.1 万元，较 2012 年年末上升 8,167 万美元，主要系运营资本及资本支出资金需求增加所致。

3) 偿债能力分析

截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日，目标公司合并报表口径的偿债能力相关分析指标如下表：

项目	2014-09-30	2013-12-31	2012-12-31
资产负债率	64.14%	59.17%	54.92%

项目	2014-09-30	2013-12-31	2012-12-31
流动比率	0.97	1.12	1.57
速动比率	0.83	0.96	1.34

注：上述财务指标的计算公式为：

（1）资产负债率＝总负债/资产总额；

（2）流动比率＝流动资产/流动负债；

（3）速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债。

由上表可知，目标公司的资产负债率呈逐渐上升趋势，截至 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日，分别为 54.92%、59.17%和 64.14%。报告期各期末，目标公司的流动比率、速动比率持续下降，显示公司债务负担较重，短期偿债能力减弱。

2、本次交易目标公司的经营成果

1) 盈利能力分析

2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-9 月，目标公司盈利能力如下：

单位：美元千元

项目	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	1,179,160	100.00%	1,598,522	100.00%	1,701,549	100.00%
营业成本	-1,044,751	-88.60%	-1,380,941	-86.39%	-1,414,045	-83.10%
毛利	134,409	11.40%	217,581	13.61%	287,504	16.90%
运营费用						
销售管理费用	72,804	6.17%	96,140	6.01%	122,958	7.23%
研发费用	30,273	2.57%	46,432	2.90%	51,722	3.04%
重组支出	-		1,886	0.12%	5,715	0.34%
交换要约及赎回费用	-		15,701	0.98%	-	
债券发行注销费用	-		2,392	0.15%	-	
商誉减值损失	-		-		24,100	1.42%
设备减值损失	3,713	0.31%	-		3,819	0.22%

项目	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
运营费用合计	106,790	9.06%	162,551	10.17%	208,314	12.24%
不含经常项目前的营业利润	27,619	2.34%	55,030	3.44%	79,190	4.65%
工厂关闭成本	-		-36,909	-2.31%	-	
洪水相关保险赔偿	-		19,582	1.23%	26,741	1.57%
洪水相关计划费用	-		-3,000	-0.19%	-10,061	-0.59%
扣除非经常项目的营业利润	27,619	2.34%	34,703	2.17%	95,870	5.63%
其它费用合计，净值	-36,859	-3.13%	-51,453	-3.22%	-57,990	-3.41%
税前利润/(损失）	-9,240	-0.78%	-16,750	-1.05%	37,880	2.23%
所得税费用	-9,934	-0.84%	-22,329	-1.40%	-14,023	-0.82%
净利润/(损失）	-19,174	-1.63%	-39,079	-2.44%	23,857	1.40%
减:归属于少数股权的净利润		0.00%	-8,414	-0.53%	-7,294	-0.43%
归属于少数股东的净利润/(损失）	-25,280	-2.14%	-47,493	-2.97%	16,563	0.97%

资料来源：目标公司定期报告

2) 营业收入构成情况分析

目标公司营业收入主要来源于先进封装、焊线接合封装和测试服务供应，2013 年度较 2012 年度其收入下降 6.1%。2013 年，先进封装收入同比下降 1.5%，主要由于无线通信市场对晶元级封装（wafer level packaging）和先进封装的需求的减少。2013 年，焊线接合封装收入同比减少 17.7%，主要由于个人电脑、消费、多应用和其他市场需求减弱以及焊线接合封装向先进封装技术逐步转型。2013 年测试服务收入同比增长 4.2%。2013 年，目标公司焊线接合封装业务中铜线业务占比约达 33.9%，同比增长 17.8%

3) 毛利率分析

2013 年目标公司毛利率约 13.6%，较 2012 年的 16.9%有所下降。2013 年，目标公司毛利约 2.176 亿美元，较 2012 年的 2.875 亿美元下降 24.3%，主要原因系目标公司营业收入的减少，而收入下降的原因主要是产能利用率显著下降，2013 年总体设备使用率为 66%，而 2012 年为 75%。目标公司的营业成本主要为如折旧、租赁等固定成本及

如人力、材料、间接费用等可变成本。

4) 期间费用分析

单位：万元

项目	2014 年 1-9 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比
销售管理费用	72,804	6.17%	96,140	6.01%	122,958	7.23%
研发费用	30,273	2.57%	46,432	2.90%	51,722	3.04%
其他费用	3,713	0.32%	19,979	1.26%	33,634	1.97%
合计	**106,790**	**9.06%**	**162,551**	**10.17%**	**208,314**	**12.24%**

资料来源：公司定期报告

2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-9 月，目标公司的期间费用分别相当于同期营业收入的 12.24%、10.17%和 9.06%。

销售管理费用主要包含管理团队的薪资，外部咨询、法律和监管费用等以及与销售管理活动相关的设备折旧。2013 年度目标公司销售管理费用较 2012 年同比减少 21.8%。主要由于 2012 年发生了诉讼费用及 2013 年员工薪酬支出减少所致。

研发费用主要包含与研发活动相关的员工薪酬、外部咨询和法律费用以及相关设备折旧和支出。2013 年，目标公司研发费用较 2012 年同比下降 10.2%，其原因系目标公司部分封装技术自主研发的完成致使相关研发人员薪酬的支出下降。

5) 盈利指标分析

2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-9 月，目标公司合并报表口径的主要盈利指标如下：

项目	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度
毛利率	11.40%	13.61%	16.90%
不含非经常项目的营业利润	2.34%	3.44%	4.65%
净利润率	-1.63%	-2.44%	1.40%

资料来源：目标公司定期报告

报告期，目标公司毛利率及净利率呈逐年下滑趋势，一方面受到马来西亚工厂关闭等因素的影响，另一方面目标公司业务主要集中于移动通信市场，该部分业务近年来有所减少。目标公司过去曾在高端智能手机市场获得较大业务份额，在低端智能手机市场

覆盖较少，但近年来，高端智能手机市场业务需求有所降低。此外，个人电脑及客户需求的减弱也对目标公司的业绩造成影响。

（三）交易完成后本公司的主营业务、竞争优势及未来趋势分析

1、交易完成后本公司的主营业务、发展战略及竞争优劣势分析

本次收购的战略意义：通过收购获得欧美一流客户，大幅度提升欧美市场份额。在中国市场，虽然长电科技在自身先进封装技术优势的基础上，通过与中芯国际的合资在高端封装市场占据一定的优势地位，但是仅凭借内生式增长，很难在短时间内在技术和管理方面跻身世界一流封装企业。通过本次收购，导入星科金朋在技术、国际化和系统化管理方面的优势和经验，整合双方的优势资源，发挥协同效应，打造并提升中国封装行业龙头企业的国际竞争力，实现跨越式发展，跻身全球一流封装企业，将获得更广阔的发展空间。

1) 主营业务和发展战略

本次交易完成后，本公司主营业务未发生变化。本公司主营业务为半导体封装测试。本次交易完成后，公司将成为全球半导体封装测试领域的领先企业，进一步巩固了公司的竞争地位。

本次收购完成后，长电科技的业务地域范围将覆盖亚洲、北美、欧洲等地区。长电科技将以此为基础，继续贯彻内外结合的发展战略，将产业链延伸至海外，更多参与国际竞争，在全球配置资源，将长电科技打造成为真正拥有全球一体化的生产体系和完整的全球业务布局的跨国公司。

为此，长电科技将在生产布局上进行调整，将目标公司先进技术与国内生产的成本优势整合，形成韩国、新加坡、上海、江阴、滁州、宿迁等地的国内外综合布局，发挥目标公司在韩国的技术优势与在全球市场的网络优势，实现公司资源的最大化利用。

在销售渠道方面，长电科技收购目标公司后，将在巩固目标公司现有的销售区域、市场份额的基础上，维护好现有高端客户，同时帮助目标公司开拓中国市场，力求在较短时间内实现扭亏为盈。未来，目标公司将在成本可控的前提下进行稳健扩张。

2) 竞争优势

本次收购完成后，本公司将在竞争日益激烈的半导体封装测试行业中进一步拓展竞争优势，主要表现在：

①渠道与优质客户优势

本公司主要服务于传统封装市场，并积极拓展先进封装业务，以中国为基地，面向全球客户。通过建立子公司江阴长电先进封装有限公司，本公司的先进封装技术实力与客户资源进一步增强，覆盖了从传统到先进多种类封装测试的需求。

目标公司在北美、欧洲等地拥有良好的客户资源。这样的客户资源能够与公司现有的生产能力和业务覆盖形成互补，能够更大程度地提升公司未来的海外销售规模。

②技术增强

目标公司在封装测试领域拥有深厚的技术积累，在晶圆级封装方面，目标公司拥有 eWLB、WLCSP、IPD 和 TSV 等世界一流的先进技术；在倒装类封装方面，目标公司拥有 fcBGA、fcFBGA、fcLGA 等多种技术。

目前长电科技正在积极拓展先进封装市场，并有了相当的技术基础。通过本次收购，本公司能够获得多项先进技术，极大地丰富了本公司先进封装的技术水平与服务能力，使得长电科技先进封装技术一跃达到世界领先水平，公司所能提供服务的范围得到了较大拓展。

③品牌优势

目标公司星科金朋已在全球市场获得相当的市场认知和市场地位，得到客户认可，积累了显著的品牌优势。通过整合，本公司产品及服务可以较快渗透国外市场及高端客户，加快了长电科技境外市场，特别是美国与欧洲市场的开发。

3) 竞争劣势

目标公司为一家境外公司，其主要资产和业务主要分布在新加坡、韩国等地，与本公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、公司管理制度、企业文化等经营管理环境方面存在差异。为充分发挥并购的协同效应，本公司将在收购完成后的一段时期内与目

标公司的业务进行整合，由于整合涉及的范围较广，同时目标公司资产负债率较高，财务压力较大，预计上述整合完全到位需要一定时间，在过渡期内可能存在相关运营、管理、人事等环节未能完全整合的情形，存在目标公司盈利能力短期内无法显著提升的风险，从而给本公司的业务及盈利能力带来一定影响。

2、交易完成后产生的协同效应

本次交易完成后，本公司将受益于以下几个方面，能够与目标公司产生良好的协同效应和规模效应，提升未来的盈利能力：

1) 提升营业收入

目前目标公司主要销售市场为美国，而长电科技在美国市场覆盖率较低，因而，本次收购后，可以利用目标公司的现有销售渠道和优质客户，进一步开拓海外市场；同时，目前目标公司的产品基本没有进入中国市场，而长电科技在中国市场具有成熟的销售网络和多年的运营经验，因此，本次收购后，可以帮助目标公司的先进封装业务进入中国市场，从而实现营业收入的提升。

2) 降低运营成本及费用

目标公司的部分生产线存在产能利用不足的情况，导致目标公司毛利率较低。本次交易完成后，长电科技将灵活调配、充分利用两家公司的现有产能，从根本上提升目标公司的盈利能力。长电科技在传统封装业务方面拥有多年的运营经验，特别是成本控制方面，针对目标公司运营成本较高的问题，长电科技将进行适当调整，降低目标公司的运营成本及费用。

3、本次交易完成后上市公司对目标公司的整合

星科金朋在技术、管理、系统、客户等方面有较好的基础，但其经营绩效不佳，主要存在以下问题：

（1）经营机制为总部集中控制，主要子公司都具有一定规模，但仅是生产制造中心，缺乏自主经营权，机制相对僵化，不能充分激发各个子公司经营团队的潜能、积极性和实现利润最大化的内生性动力；

（2）由于集中控制，新加坡总部的非生产性管理人员相对较多，总部费用较高；

（3）目标公司目前债务负担较重，财务费用高，影响盈利；

（4）目标公司尚未利用自身的技术优势有效地、全方位地拓展中国先进封装市场。

因此，本次交易完成后，长电科技主要将针对上述四大问题，从以下几个方面着手进行整合：

1) 改变经营管理机制，将子公司转变为利润中心，激发其管理层经营潜能

改变星科金朋目前集中管理的模式，星科金朋现有各子公司由制造中心转变为利润中心；对各子公司制定业绩激励指标，由子公司经营团队对企业经营业绩承担责任，并建立责权利统一的激励机制，全力以赴提高产能利用率，降低采购成本和制造成本。

2) 降低目标公司财务成本

把握国家支持集成电路产业发展的契机，争取相关的优惠政策，降低目标公司的财务费用。

3) 提升管理效率，降低管理费用

实行扁平化管理，缩短管理流程，提高决策效率，降低管理费用。

4) 整合资源，开发中国市场

星科金朋在 eWLB 和 PoP 等先进封装技术方面处于全球领先地位，在中国具有较大的发展空间，本次收购后，利用长电科技在中国市场的优势和影响力，争取更多的中国先进封装的市场份额。

5) 优化产能分配，减少设备重复投资

本次收购后，长电科技将对星科金朋、长电科技本部、长电先进三大利润中心的产能进行优化分配，降低设备的重复投资，降低整体资本开支及运营成本。

6）稳定核心管理层和技术团队，稳定客户

本次收购后，本公司将立即采取各种措施稳定目标公司核心管理层和技术团队，并尽快与核心客户进行沟通，确保客户的稳定。

通过上述措施，逐步改善目标公司经营业绩，使其步入良性经营的轨道。

4、本次交易对上市公司财务指标的影响分析

目标公司 2013 年及 2014 年前三季度出现亏损，主要原因是产能利用率不足及经营成本较高、同时搬厂等事件进一步影响了公司的盈利能力。目前目标公司处于亏损状态，本次交易完成后，整合到位需要一定的时间，标的公司可能持续亏损，并可能导致上市公司合并口径净利润下降、摊薄长电科技的每股收益。

本公司目前尚未完成对目标公司的收购，难以获得目标公司按照中国企业会计准则编制的详细财务资料进行审计，亦无法编制备考合并财务报告，考虑到目标公司 2013 年度和 2014 年前三季度亏损额分别为 4,749 万美元和 2,528 万美元，初步预计若编制最近一年一期的备考合并报表，长电科技合并口径净利润将出现亏损。

本次收购后，长电科技将尽快对目标公司进行整合，发挥协同效应，通过提升收入、降低费用等方式尽快提升目标公司的盈利能力，填补对于每股收益的摊薄。

预计本次交易对长电科技未来资本性支出的影响相对较小，目标公司未来的资本性支出将主要来源于其自身的运营现金流及债务融资渠道。

第八章 本次交易的其他重要信息

一、同业竞争及关联交易

在本次交易前，本公司主要从事半导体封装测试业务，而控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事同类业务，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

本次交易为本公司收购在新加坡证券交易所上市的目标公司最多 100%股权，将有助于公司扩大客户资源，增加销售渠道，提升产品技术。

本次交易各方均为独立法人实体，其中本公司为中国独立法人实体，目标公司为新加坡独立法人实体，本公司及控股股东与目标公司及其控股股东均不存在关联关系，因此本次要约收购不构成关联交易。本次交易完成后，本公司与控股股东、实际控制人之间的控股权及实际控制关系没有发生变更，也未因本次交易产生新的关联交易。公司将继续严格依照相关法律、法规、上海证券交易所上市规则的要求，遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》等公司关于关联交易的规定，履行必要的法律程序，依照合法有效的协议进行关联交易，并在实际工作中充分发挥独立董事的作用，遵循公平、公正、公开的原则，履行信息披露义务，从而保护中小股东利益。

二、资金、资产占用及关联担保情况

截至本报告书签署日，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用（包括但不限于非经营性占用）本公司资金、资产的情况；本次交易也不会导致公司资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形。

截至本报告书签署日，公司不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

三、本次交易对公司负债结构的影响

本次收购的资金将来自于本公司自有资金及前次非公开发行的募集资金，前次非公开发行新增股份于 2014 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理

完毕登记托管手续，募集资金净额 1,186,332,625.62 元。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，本次变更募集资金用途尚需本公司股东大会审议通过。

此外，本公司和联合投资者为本次交易之目的共同设立的要约收购主体将通过银行贷款取得部分收购资金，对于本公司的负债水平有一定的影响。考虑到截至 2014 年 9 月底，本公司资产负债率为 60.24%，且本次银行贷款规模不会超过 1.2 亿美元，长电新朋层面股东贷款为 1.4 亿美元，预计交易完成后公司的负债水平虽然有所上升，将仍然保持在较为合理的范围内。

此外，本公司当前的经营情况良好，且具有较好的增长前景及较强的盈利能力和偿债能力，因此预计债务的适当增加将不会对本公司的财务状况和偿债能力造成较大影响。

四、最近十二个月内发生的资产交易情况

本公司最近十二个月内未进行与本次收购的资产构成同一或相关资产的交易。

五、本次交易对公司治理机制的影响

本公司已按照《公司法》、《证券法》和证监会有关文件的要求，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《独立董事工作制度》等管理制度，建立了完善的法人治理结构。

目标公司是一家在新加坡证券交易市场上市的公司，具有良好的公司治理结构和完善的信息披露制度。公司在收购、经营目标公司的过程中，了解、熟悉新加坡的法律法规和上市规则，有利于公司在遵守自身上市地相关监管规则的前提下，借鉴目标公司等新加坡公司先进的管理和公司治理经验，进一步完善本公司的法人治理机制。

本次交易完成后，公司仍将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程的要求规范运作，不断完善公司法人治理结构：

（一）股东与股东大会

本次交易完成后，本公司将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定履行股东大会职能，确保所有股东，尤其是中小股东享有法律、行政法规和《公司章程》规定的平等权利。在合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例，保证股东大会时间、地点的选择有利于让尽可能多的股东参加会议，切实保障股东的知情权和参与权。

（二）控股股东与上市公司

本次交易完成后，本公司将继续积极督促控股股东严格依法行使出资人的权利，切实履行对本公司及其他股东的诚信义务，不直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动，不利用其控股地位谋取额外的利益，以维护广大中小股东的合法权益。

（三）董事与董事会

董事会对全体股东负责，严格按照法律和公司章程的规定履行职责，把好决策关，加强对公司经理层的激励、监督和约束。在上市公司控股股东及其关联方已经做出明确的承诺情况下，采取切实可行的措施，监督并避免其与上市公司可能发生的同业竞争，并根据《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等规章制度，坚决执行关联交易的相关董事、股东的回避程序，保证公司关联交易的“公平、公正、公开”原则。 为进一步完善公司治理结构，公司将继续充分发挥独立董事在规范公司运作、维护中小股东的合法权益、提高公司决策的科学性等方面的积极作用。同时，独立董事的选聘、独立董事工作制度的建立和执行将严格遵守国家有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

（四）监事与监事会

本次交易完成后，本公司将继续严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，为监事正常履行职责提供必要的协助，保障监事会对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督的权利，维护公司及股东的合法权益。

（五）关联交易管理

公司在《关联交易决策制度》中规定了关联交易应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，制定了相应的制度和执行程序，并在实际工作中充分发挥独立董事的作用，以

确保关联交易价格的公开、公允、合理，从而保护股东利益。本次交易后，本公司将避免同业竞争，减少并规范关联交易。同时，本公司也将继续采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司资金、资产及其他资源和防止关联方干预公司的经营，损害公司利益。

六、本次交易对公司独立性的影响

本次交易前，本公司已经按照有关法律法规的规定建立了规范的法人治理结构和独立运营的公司管理体制，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

目标公司是一家在新加坡交易所上市的公司，具有良好的法人治理结构和独立性，在本次收购完成后，本公司依然具备完善的法人治理结构和独立经营能力。

（一）资产完整

本公司拥有独立的产、供、销系统，资产产权明晰，具备独立完整的资产结构，拥有生产经营活动所必须的生产设备、房屋所有权、专利技术、非专利技术、商标及土地所有权等，具有独立完整的业务及面向市场自主经营能力。本次交易完成后，公司继续拥有与主营业务经营相关的资产，资产独立完整。

（二）人员独立

本公司的董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的任职，系根据《公司法》及其它法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定的程序进行推选与任免。本公司拥有独立于股东单位或其他关联方的员工，并在有关社会保障、工薪报酬等方面独立管理。本公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。本次交易完成后，公司将继续保持在人员方面的独立性。

（三）财务独立

本公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，能够根据有关会计制度的要求，独立进行财务决策。本公司拥有独立的银行帐户，不与股东单位或其他任何单位或人士共用银行帐户，财务人员未在关联企业任职。本公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。本次交易完成后，公司依然保持财务独立。

（四）机构独立

本公司按照《公司法》要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织机构体系。本公司的生产经营和办公机构与第一大股东完全分开，不存在混合经营情形。第一大股东及其他任何单位或个人未干预本公司的机构设置。本次交易完成后，公司机构独立状况不变。

（五）业务独立

本公司主要生产集成电路和分立器件等产品，本公司主要股东及其子公司不生产与本公司相同或类似的产品，本公司的其他股东也不生产与本公司相同或相似的产品。公司拥有独立的产、供、销系统，设有供销部门，有专门的供销人员，原材料的采购和产品的销售不依赖于股东单位及其他关联企业。所涉及的关联交易均按照公平、公开、公正的市场化原则进行，不影响公司独立开展业务，公司具有独立完整的业务以及面向市场的自主经营能力。本次交易完成后，公司继续依法从事经营范围内的业务，业务独立状况不变。

七、保护投资者利益的相关安排

本次交易中，上市公司将采取如下措施，保护投资者合法权益：

1、在本次交易过程中，上市公司将严格按照《重组办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于加强与上市公司重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等相关法律、法规的要求，及时、完整地披露相关信息，切实履行法定的信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件以及本次交易的进展情况。

2、根据《重组办法》，本公司已聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易进行核查，并且已聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所出具鉴证报告。本公司聘请的独立财务顾问和法律顾问将根据相关法律法规要求对本次交易出具独立财务顾问报告和法律意见书。

3、本次交易相关事项在提交本公司董事会讨论时，本公司已获得独立董事对本次交易的事先认可，本公司的独立董事均已就本次交易相关事项发表了独立意见。

4、在审议本次交易的股东大会上，公司将通过交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东通过交易系统参加网络投票，以切实保护流通股股东的合法权益。

八、不存在泄露本次交易内幕信息及利用本次交易信息进行内幕交易的情况

长电科技及其董事、监事和高级管理人员、长电科技子公司的主要管理人员、相关中介机构及其项目经办人员，以及上述相关人员的直系亲属就本公司股票停牌前 6 个月（即自 2014 年 5 月 3 日至 2014 年 11 月 3 日期间）是否存在买卖本公司股票行为进行了自查。

根据自查结果，长电科技董事、监事和高级管理人员、长电科技控股股东的董事、监事和高级管理人员及停牌前知悉本次交易信息的相关知情人员未在自查期间买卖、持有本公司股票，亦未泄漏内幕信息、建议他人买卖长电科技股票、从事市场操纵等行为。

根据自查结果，中金公司自营部门、资产管理部门在此期间总计买入 2,678,015 股长电科技的股份，总计卖出 2,599,444 股长电科技的股份。中金公司相关知情人员以及上述人员的直系亲属无买卖长电科技股票、泄漏有关信息、建议他人买卖长电科技股票、从事市场操纵等行为。

中金公司已就股票买卖行为出具说明：“中金公司作为本次交易的独立财务顾问，严格遵守监管机构的各项规章制度，切实执行内部信息隔离制度，充分保障独立财务顾问的职业操守和独立性。中金公司建立了严格的信息隔离墙机制，包括各业务之间在机

构设置、人员、信息系统、资金账户、业务运作、经营管理等方面的独立隔离机制及保密信息的管理和控制机制等，以防范内幕交易及避免因利益冲突产生的违法违规行为。

综上，中金公司自营部门、资产管理部门持有和买卖长电科技股份均依据其自身独立投资研究决策，属于中金公司相关业务部门和机构的日常市场化行为，与本次项目无任何关联。”

综上，本次交易的各方不存在泄露本次交易内幕信息及利用本次交易信息进行内幕交易的情况。

九、上市公司利润分配政策的相关说明

（一）上市公司利润分配政策

在本次收购前，长电科技董事会已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，制定了《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》，对原《公司章程》中关于利润分配政策的条款进行修订，上述修正案已经长电科技第五届第十一次临时董事会及 2013 年第三次临时股东大会审议通过。

修订后的利润分配政策如下：

“第一百五十七条 公司利润分配政策为： （一）公司利润分配政策的基本原则：公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（二）公司利润分配的形式及优先顺序： 1、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式； 2、公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配， 3、经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。（三）公司现金分红的具体条件： 1、公司未分配利润为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展需求； 2、公司不存在本条（五）所列的可以不实施现金分红之情形；3、如公司年度实现盈利并达到现金分配条件，公司董事会未提出现金利润分配方案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见。 （四）现金分红的期间间隔和最低比例： 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现

的年均可分配利润的百分之三十。 （五）公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红： 1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利； 2、合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数； 3、合并报表或母公司报表期末资产负债率超过 70%； 4、合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数； 5、公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见； 6、公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要，且公司已在公开披露文件中对相关计划进行说明。 （六）公司发放股票股利的具体条件 1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正； 2、董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。 （七）公司存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。 （八）公司利润分配政策的制定和修改程序

公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在利润分配政策论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策。 若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续发展时，公司董事会可以提出修改利润分配政策；公司董事会提出修改利润分配政策时应以股东利益为出发点，充分考虑中小股东的意见，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因。 公司董事会制定与修订利润分配政策，应当通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 公司董事会制订和修改的利润分配政策，需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。 公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 （九）公司利润分配具体方案决策程序与机制： 公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策，独立董事应当发表明确意见。 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过。

公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；上市公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。股东大会对利润分配方案进行审议前，应当主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。”

（二）长电科技 2013 年~2015 年股东回报规划

在本次收购前，为了进一步明确长电科技未来三年的股东回报规划，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对上市公司经营和利润分配进行监督，长电科技董事会已制订了《江苏长电科技股份有限公司未来三年（2013 年-2015 年）股东分红回报规划》（以下简称“规划”），并已经公司第五届第十一次临时董事会及 2013 年第三次临时股东大会审议通过。

规划具体内容如下：

“1、公司制定规划考虑的因素

公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

2、规划的制订原则

规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投资者的回报；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

3、公司未来三年（2013 年-2015 年）的具体股东分红回报规划

1）公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在满足《公司章程》规定条件的情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配，经公司股东大会审议决定，公司可以进行中期利润分配。 2、在满足《公司章程》规定的现金分红条件的情况下，公司未来三年(即 2013 年-2015 年)以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。同时，公司可根据需要采取股票股利的方式进行利润分配。

2）为了抓住半导体行业发展契机，满足市场需求，提高自身竞争力，减小与国外半导体封装测试行业的差距，进一步扩大市场份额，公司将进一步对产品结构进行调整，由于公司生产设备规模较大、固定资产占比较高，产品结构调整周期较长，因此需要持续投入资金进行产品的改造升级。鉴于国内半导体封装测试行业尚处于成长及转型期，公司未来有较大的资金支出需求，为了确保公司能够长期健康、稳定的发展，从而更好地为股东提供长期回报，同时为了充分保护公司全体股东的现金分红权益，公司计划未来三年各期如进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于 20%。

3）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

4、分红回报规划制定周期及相关决策机制

1）公司股东回报规划预案由董事会根据公司战略发展目标、盈利能力以及资金需求状况并结合股东(特别是中小股东)、独立董事的意见拟定，在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

2）公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司股东回报规划的调整应在公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。

3）规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。

第九章 目标公司财务会计信息

一、目标公司所采纳的会计政策和中国企业会计准则之间的主要差异的说明及国内审计机构出具的鉴证报告

本公司管理层根据目标公司对外公开的年度报告和期间报表，确认目标公司的 2012 财年、2013 财年、2014 财年前 9 个月是根据新加坡财务报告准则编制。PricewaterhouseCoopers LLP(普华古柏会计师事务所有限合伙)按照新加坡审计准则对目标公司 2012 财年及 2013 财年财务报告进行审计，并出具了无保留审计意见的审计报告。 由于本次收购的目标公司在新加坡注册，系国外独立法人实体且在新加坡交易所上市，与本公司无股权关系，同时本公司目前尚未完成对目标公司的协议收购，因此无法提供按本公司的会计制度和会计政策编制的目标公司的财务报告和审计报告。本公司将在目标公司股权正式交割后三个月内按相关监管部门要求完成并向投资者披露按照中国企业会计准则和本公司会计政策编制的目标公司的财务报告和审计报告。 本公司管理层分析并评估了上述财务报表中披露的 STATS ChipPAC Ltd.主要会计政策及相应中国企业会计准则(包括财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定)的要求，并在此基础上准备了 STATS ChipPAC Ltd.在编制上述财务报表时采用的主要会计政策与中国企业会计准则相关规定之间的差异情况比较表，并聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对该差异情况表进行了鉴证并出具了《鉴证报告》（普华永道中天特审字(2014)第 1602 号），报告内容如下：

“我们接受委托，对后附 STATS ChipPAC Ltd.(以下简称“STATS ChipPAC”)截至 2012 年 12 月 30 日止财务年度、截至 2013 年 12 月 29 日止财务年度和截至 2014 年 9 月 28 日止 9 个月期间根据新加坡财务报告准则编制的财务报表中披露的主要会计政策与中国企业会计准则(包括财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定)相关规定之间的差异情况说明(以下简称“差异情况说明”)执行了有限保证的鉴证业务。

一、江苏长电科技股份有限公司管理层对差异情况说明的责任

根据中国证券监督管理委员会关于信息披露的相关要求，按照差异情况说明中提及的编制基础编制差异情况说明是江苏长电科技股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：获取对 STATS ChipPAC 截至 2012 年 12 月 30 日止财务年度、截至 2013 年 12 月 29 日止财务年度和截至 2014 年 9 月 28 日止 9 个月期间根据新加坡财务报告准则编制的财务报表中披露的主要会计政策的理解；将这些主要会计政策与中国企业会计准则的相关规定进行比较和差异分析；以及对如果按照中国企业会计准则编制 STATS ChipPAC 截至 2012 年 12 月 30 日止财务年度、截至 2013 年 12 月 29 日止财务年度和截至 2014 年 9 月 28 日止 9 个月期间的财务报表，中国企业会计准则在这些主要会计政策方面的规定对财务信息的影响作出定性的评估。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对差异情况说明发表结论，并按照双方同意的业务约定条款，仅对贵方报告我们的结论，除此之外并无其他目的。我们不会就本报告的内容向任何其他方承担责任或义务。在我们的鉴证业务范围内，我们没有按照中国注册会计师审计准则或中国注册会计师审阅准则执行审计或审阅业务，因而不对 STATS ChipPAC 截至 2012 年 12 月 30 日止财务年度、截至 2013 年 12 月 29 日止财务年度和截至 2014 年 9 月 28 日止 9 个月期间的财务报表发表审计意见或审阅结论。

我们根据中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号“历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务”的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以就我们是否注意到任何事项使我们相信差异情况说明未能在所有重大方面反映 STATS ChipPAC 截至 2012 年 12 月 30 日止财务年度、截至 2013 年 12 月 29 日止财务年度和截至 2014 年 9 月 28 日止 9 个月期间根据新加坡财务报告准则编制的财务报表中披露的主要会计政策和中国企业会计准则相关规定的差异获取有限保证。

相比合理保证鉴证业务，有限保证鉴证业务的收集证据程序更为有限，因而获得的保证程度要低于合理保证的鉴证业务。选择的鉴证程序取决于注册会计师的判断，包括对差异情况说明是否存在重大错报风险的评估。我们实施的程序主要限于查阅 STATS ChipPAC 截至 2012 年 12 月 30 日止财务年度、截至 2013 年 12 月 29 日止财务年度和截至 2014 年 9 月 28 日止 9 个月期间财务报表中披露的主要会计政策、询问公司管理层对 STATS ChipPAC 主要会计政策的了解、复核差异情况说明的编制基础，以及我们认为

必要的其他程序。

三、结论

基于我们执行的有限保证鉴证工作，我们没有注意到任何事项使我们相信差异情况说明未能在所有重大方面反映 STATS ChipPAC 截至 2012 年 12 月 30 日止财务年度、截至 2013 年 12 月 29 日止财务年度和截至 2014 年 9 月 28 日止 9 个月期间根据新加坡财务报告准则编制的财务报表中披露的主要会计政策和中国企业会计准则相关规定的差异。

四、使用和分发限制

本报告仅供江苏长电科技股份有限公司在实施对 STATS ChipPAC 的收购计划时参考之用，不适用于任何其他目的。我们特此声明不对任何其他方承担责任。未经我们事先书面同意，本报告及其任何部分或任何内容均不应向任何其他方披露。”

二、目标公司主要会计政策与中国企业会计准则相关规定的差异情况比较表

	目标公司的主要会计政策	相应的中国企业会计准则摘要	差异分析及对目标公司按中国企业会计准则编制财务报表时的影响
1	编制基础 除在如下的会计政策中另有披露外，本财务报表按照历史成本法编制。如下的重要会计政策在本财务报表涵盖的各历史期间内均保持一致。	《企业会计准则－基本准则》： 企业在对会计要素进行计量时，一般应当采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。	目标公司针对编制基础的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。
2	列报货币 本财务报表以美元列报，除另有描述外，所有金额均四舍五入至千美元。	《企业会计准则第19号-外币折算》： 企业通常应选择人民币作为记账本位币。业务收支以人民币以外的货币为主的企业，可以按照本准则第五条规定选定其中一种货币作为记账本位币，但是，编报的财务报表应当折算为人民币。	在收购完成后，长电科技将根据《企业会计准则第19号-外币折算》中关于企业对境外经营的财务报表进行折算的规定，将目标公司的财务报表进行折算，以将其财务信息合并在长电科技以人民币列报的合并财务报表中。
3	会计年度 目标公司的52—53周的会计年度在接近且早于12月31日前的日期结束。目标公司的会计季度在周日结束，一般有13周长。2013年度的会计年度为52周，结束于2013年12月29日，2012年度的会计年度为53周，于2013年12月30日结束。除非有其他描述，所有年份的数据都是指目标公司的会计年度。	根据《中华人民共和国会计法》的规定，会计年度自公历1月1日起至12月31日止。	收购完成后，目标公司的财务信息将按照长电科技的会计政策调整，以包含在长电科技按照中国企业会计准则编制的合并财务报告中。
4	合并和子公司 合并财务报表包括目标公司和其拥有多数权益的子公司，即被其控制的公司的合并财务报表。这个控制通常被指当本集团能够决定一个公司的财务和经营政策，从而从它的活动受益，或本集团直接或间接地拥有一个公司的多数投	《企业会计准则第33号-合并财务报表》： 合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。	目标公司针对合并和子公司的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。

	目标公司的主要会计政策	相应的中国企业会计准则摘要	差异分析及对目标公司按中国企业会计准则编制财务报表时的影响
	票股权，或通过合同协议控制，除非在特殊情况下，有证据表明所有权不构成控制。 子公司从其被收购日期开始合并，即本集团取得控制的日期，并一直合并直至该控制权终止之日。合并财务报表里的母公司及子公司的会计年度相同，且对子公司可能采用的与本集团会计政策的不同进行调整。本集团内所有的公司间往来、交易，包括由于集团内公司间交易产生的未实现利润，都予以全部抵消。未实现亏损也予以抵消，除非相应的成本无法回收。 少数股东损益和权益代表非由本集团持有的子公司的综合收益和净资产。	控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权力。 母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，应当将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。 母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足以下条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，应当将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外： (一)通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权； (二)根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策； (三)有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员； (四)在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。 母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。 母公司应当统一子公司所采用的会计政策，使子公司采用的会计政策与母公司保持一致。 子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，应当按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表。 母公司应当统一子公司的会计期间，使子公司的会计期间与母公司保持一致。	

	目标公司的主要会计政策	相应的中国企业会计准则摘要	差异分析及对目标公司按中国企业会计准则编制财务报表时的影响
		子公司的会计期间与母公司不一致的，应当按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整；或者要求子公司按照母公司的会计期间另行编报财务报表。 合并资产负债表应当以母公司和子公司的资产负债表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由母公司合并编制。 子公司所有者权益中不属于母公司的份额，应当作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。 合并利润表应当以母公司和子公司的利润表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响后，由母公司合并编制。 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，应当在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。	
5	企业合并 企业合并采用购买法。合并中获取的可辨认资产、负债和或有负债在合并日以公允价值计量。合并成本包括支付的现金对价、给付的其他资产、发行的权益工具及承担的债务的公允价值计量。合并相关的交易费用在成本发生及服务提供的期间内计入当期损益。合并成本大于合并中过得的可辨认资产、负债和或有负债的公允价值的部分确认为商誉。	《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则解释第4号》： 购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照本准则第十四条的规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负	目标公司在报告期内未发生同一控制下的企业合并。 对于非同一控制下的企业合并， 目标公司的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。

	目标公司的主要会计政策	相应的中国企业会计准则摘要	差异分析及对目标公司按中国企业会计准则编制财务报表时的影响
		债及或有负债。 （一） 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉的减值应当按照《企业会计准则第8 号——资产减值》处理。 （二） 购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当按照下列规定处理： 1．对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核； 2．经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。	
6	子公司发行股份 由于子公司向第三方增发股份，导致本集团享有的子公司净资产的份额发生变化的，相关影响调整本集团权益。	于2014年6月30日前生效的企业会计准则中没有对子公司向第三方增发股份，导致本集团享有子公司净资产份额发生变化的财务处理的明确规定。但可参考《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》(财会便[2009]14号)：母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额应当计入所有者权益。	该项下目标公司的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。

	目标公司的主要会计政策	相应的中国企业会计准则摘要	差异分析及对目标公司按中国企业会计准则编制财务报表时的影响
7	外币交易 本公司主要以美元作为功能性货币，这反映了本集团日常经济活动所处的主要环境。以外币计价的资产和负债采用资产负债表日的即期汇率折算为功能性货币。以外币计价的收入和费用项目按照会计期间的平均汇率折算。外汇交易的收益或损失计入损益。 STATS ChipPAC Taiwan Semiconductor Corporation 以新台币作为其功能性货币。当子公司采用的功能性货币不同于本集团的列报货币美元时，子公司财务报表中的资产和负债采用资产负债表日的即期汇率、损益采用报告期内的平均汇率折算。由于折算产生的差额计入其他综合收益，作为单独的项目列示在权益里。˜	企业对境外经营的财务报表进行折算时，应当遵循下列规定： （一）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。 （二）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；也可以采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。 按照上述（一）、（二）折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。	该项下目标公司的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。
8	现金及现金等价物 现金及现金等价物包括具有高度流动性、易于转换为已知金额现金，且原到期日不超过三个月的投资。现金及现金等价物包括现金、银行存款及货币市场基金。 证券投资、受除国家外汇控制外的限制的投资或银行账户不属于现金及现金等价物，而属于受限制的货币资金。受限制的货币资金包括根据外国监管要求持有的或为了获取银行借款抵押的定期存款和政府债券。	《企业会计准则第31号－现金流量表》： 现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。 现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。	该项下目标公司的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。

	目标公司的主要会计政策	相应的中国企业会计准则摘要	差异分析及对目标公司按中国企业会计准则编制财务报表时的影响
9	衍生工具和套期保值 为了应对承诺的或预期的未来现金流波动带来的风险敞口，本集团建立了风险管控体制。这些措施可以降低但并非总能够完全消除外汇、利率及商品价格的变动所带来的影响。本集团通过使用衍生工具，例如远期外汇合同和利率互换合同，以对本集团在一些国家经营而受外汇汇率变动影响的风险及利率变动的风险进行套期。 本集团将衍生工具在合并资产负债表内确认为资产或者负债，并按公允价值计量。根据这些工具的使用情况及其是否符合套期会计的条件，公允价值的变动在损益表内或者其他综合收益项下反映。衍生工具公允价值变动带来的收益或损失及其对财务报表的影响取决于对衍生工具的指定，以及是否能够高度有效地抵销被套期资产或负债的现金流量。若套期项目不符合有效性评价标准，或被套期交易终结，则其他综合收益项下的对应金额应重分类至损益表内。 一些为了对某些承诺的风险敞口进行套期的远期外汇合同并未指定为套期工具。因此这些远期外汇合同的公允价值变动记录在损益表内。 当套期工具到期、出售、终止、已行使、或不再符合套期会计的条件时，套期会计终止。套期工具累计已确认的收益或损失应保留在权益中，直至预期的交易发生。当被套期的交易预期不会发生或不能弥补，在权益中确认的累计收益或损失应记录在损益表内。	《企业会计准则第24号-套期保值》 现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理： （一）套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，应当直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定： 1．套期工具自套期开始的累计利得或损失； 2．被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。 （二）套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。 （三）在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。 被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，应当在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。 被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或一项非金融负债的，企业可以选择下列方法处理：	该项下目标公司的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。

	目标公司的主要会计政策	相应的中国企业会计准则摘要	差异分析及对目标公司按中国企业会计准则编制财务报表时的影响
		（一） 原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失，应当在该非金融资产或非金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，企业预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时，应当将不能弥补的部分转出，计入当期损益。 （二） 将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。 非金融资产或非金融负债的预期交易形成了一项确定承诺时，该确定承诺满足运用本准则规定的套期会计方法条件的，也应当选择上述两种方法之一处理。	
10	金融资产 本集团将金融资产在初始确认时分为三种类别：交易性、可供出售或持有至到期。交易性金融资产的获取及持有的主要目的是在短期内出售。持有至到期投资是本集团有能力且有明确意图持有至到期的证券。所有不属于交易性金融资产或持有至到期投资的证券都归类于可供出售金融资产。 交易性和可供出售金融资产以公允价值计量。持有至到期投资按照摊余成本计量，并根据溢价或折价计算的摊销金额予以调整。持有交易性金融资产的未实现收益或损失确认为损益。可供出售金融资产持有期间的收益或损失，扣除相应的所得税影响后，在其他综合收益中的单独项目中确认，直至最终实现。出售可供出售金融资产而实现的收益或损失应根据单项个别认定。 单项可供出售金融资产或持有至到期投资出现导致市场	《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》： 金融资产应当在初始确认时划分为下列四类： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （二）持有至到期投资； （三）贷款和应收款项； （四）可供出售金融资产。 金融资产或金融负债满足下列条件之一的，应当划分为交易性金融资产或金融负债： （一）取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购。 （二）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管	该项下目标公司的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。

	目标公司的主要会计政策	相应的中国企业会计准则摘要	差异分析及对目标公司按中国企业会计准则编制财务报表时的影响
	价值低于成本的非暂时性的下跌时，账面价值应减记为公允价值，信用风险相关的减值损失计入损益，其他因素相关的金额计入其他综合收益。持有至到期投资的溢价或折价在该投资的期间内摊销，以实现实际利率。红利或利息于应得时确认。在处置或发生减值时，累计于其他综合收益内确认的收益或损失从权益重分类至损益。	理。 （三）属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除下列各类资产以外的金融资产： （一）贷款和应收款项。 （二）持有至到期投资。 （三）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 企业初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。 企业应当按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外： （一）持有至到期投资以及贷款和应收款项应当采用实际利率法，按摊余成本计量。 （二）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，应当按照成本计量。 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，应当将该金融资产的	

	目标公司的主要会计政策	相应的中国企业会计准则摘要	差异分析及对目标公司按中国企业会计准则编制财务报表时的影响
		账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。 可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，应当按照下列规定处理： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，应当计入当期损益。 （二）可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，应当直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。	
11	应收账款及其他应收款 应收账款及其他应收款按照名义金额减除预计无法收回的坏账准备计量。坏账准备在对单项应收款项的可回收性存在疑虑时确认。应收账款和其他应收款的公允价值与其账面价值不存在重大差异。可回收性根据账龄、客户的历史付款记录、其目前的信用情况及经济总体变动趋势进行评估。	《《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》应用指南》： 一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。 对于单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 对于单项金额非重大的应收款项可以单独进行减值测试，确定	该项下目标公司的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。

	目标公司的主要会计政策	相应的中国企业会计准则摘要	差异分析及对目标公司按中国企业会计准则编制财务报表时的影响
		减值损失，计提坏账准备；也可以与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据应收款项组合余额的一定比例计算确定的坏账准备，应当反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。 企业应当根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。	
12	存货 存货按照接近加权平均法下实际成本的标准成本和可变现净值孰低计量。成本以根据正常的产能利用下的标准成本计算，由于实际产能利用低于正常情况而发生的不可弥补的成本计入损益。可变现净值根据预计售价减去至完工时将要发生的成本及费用。对于持有过多以及陈旧的存货，根据预计可销售的情况和预计未来需求计算跌价准备。本集团通常不享有客户提供半导体产品的所有权，因此并未将这些产品记录为本集团的存货。	《企业会计准则第01号-存货》： 资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。 存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。 可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。	该项下目标公司的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。
13	商誉 商誉是本集团在企业合并时付出的合并对价超过本集团享有的的可辨认净资产公允价值的部分。每年及当存在迹象表明商誉的账面价值可能发生减值时，对商誉根据其相关的现金产生单元进行减值评估。减值损失确认在损益中，并在以后期间不得转回。	《企业会计准则第08号-资产减值》： 企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉难以独立于其他资产为企业单独产生现金流量，应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。	该项下目标公司的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。

	目标公司的主要会计政策	相应的中国企业会计准则摘要	差异分析及对目标公司按中国企业会计准则编制财务报表时的影响
		可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。	
14	无形资产 本集团将专利及技术使用权在外购或开发时发生的直接费用资本化。这些成本在使用期及授权期孰短的期间内摊销。此外，在企业合并中获取的无形资产按照购买法在合并日以公允价值于本集团的合并资产负债表内确认。本集团在估计公允价值时考虑一系列因素，包括评估、现金流折现分析、估计授权费率、以及合适的市场参照。 获取的无形资产按照成本减去累计摊销计量。摊销在如下期间内按照直线法计算： 商标 7年 技术及知识产权 10年 客户关系 2年 专利18-19年 软件及授权 3-5年	《企业会计准则第06号-无形资产》： 无形资产应当按照成本进行初始计量。 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，应当分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《企业会计准则第20号——企业合并》确定。 使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额应当在使用寿命内系统合理摊销。 企业摊销无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止。 企业选择的无形资产摊销方法，应当反映企业预期消耗该项无形资产所产生的未来经济利益的方式。无法可靠确定消耗方式的，应当采用直线法摊销。	该项下目标公司的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。

	目标公司的主要会计政策	相应的中国企业会计准则摘要	差异分析及对目标公司按中国企业会计准则编制财务报表时的影响
		无形资产的摊销金额一般应当计入当期损益，其他会计准则另有规定的除外。	
15	物业厂房及设备 固定资产按照成本减除累计折旧和减值损失计量。折旧在如下期间按照直线法计算： 租赁土地及土地使用权 50-99年 房屋、机械及电子装置 3-25年 设备 2-8年 处于装配及建设阶段的固定资产以及永久土地不计提折旧。常规的维修及更换在发生时计入费用。而可以延长固定资产使用寿命的维修及更换予以资本化。通过融资租赁获取的固定资产按照最低租赁付款额现值计量，并在预计寿命期内按照直线法计提折旧。	《企业会计准则第04号-固定资产》： 固定资产应当按照成本进行初始计量。 企业应当根据与固定资产有关的经济利益的预期实现方式，合理选择固定资产折旧方法。可选用的折旧方法包括年限平均法、工作量法、双倍余额递减法和年数总和法等。固定资产的折旧方法一经确定，不得随意变更。但是，符合本准则第十九条规定的除外。 《企业会计准则讲解第07章-无形资产》： 无形资产通常包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。 《企业会计准则第21号-租赁》： 第三章 融资租赁中承租人的会计处理 在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。 承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资	目标公司对土地使用权的列示方式与中国企业会计准则要求存在列报方式的差异。根据目标公司的会计政策，土地使用权列示为物业厂房及设备；中国企业会计准则下，土地使用权列示为无形资产。该差异对净利润及净资产无重大影响。 除上述项目外，该项下目标公司的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。

	目标公司的主要会计政策	相应的中国企业会计准则摘要	差异分析及对目标公司按中国企业会计准则编制财务报表时的影响
		产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。	
16	资产减值 本集团于资产负债表日，及当需要每年对资产减值进行评估时，评估是否有迹象某项资产发生了减值。如果存在减值迹象，本集团估计该项资产的可回收金额，从而判断减值损失的金额（如需要）。如果该项资产并不独立于其他资产产生现金流，本集团根据该资产所属的现金流产生单元估计可回收金额。 商誉被分配至那些预计将由于相关的企业合并而发生协同效应的现金流产生单元，并代表了本集团管理商誉的最低层级。 当资产或现金流产生单元的账面价值超过其可回收金额时，确认减值损失。可回收金额按照公允价值减去处置费用后的净额与使用价值孰高确认。在估计公允价值时，本集团考虑出售者的预计市场价格、相似产品的售价、以及可比的市场分析。使用价值是在资产持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量的现值，预计未来现金流量折现时使用的折现率应当是一个反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的利率。公允价值的估计包括多种方式，其主要方式为现金流折现分析。现金流折现分析需要本集团做出各种假设，包括未来现金流、增长率、折现率等。这些假设是根据本集团的预算及长期发展计划做出的。	《企业会计准则第08号-资产减值》： 企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。 企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉难以独立于其他资产为企业单独产生现金流量，应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。相关的资产组或者资产组组合应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，不应当大于按照《企业会计准则第35号——分部报告》所确定的报告分部。 资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税金、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。 资产的公允价值减去处置费用后的净额，应当根据公平交易中销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定。不存在销售协议但存在资产活跃市场的，应当按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定。资产的市场价格通常应当根据资产的买方出价确定。在不存在销售协议和资产活跃市场的	根据目标公司的会计政策，如果无形资产和物业厂房及设备在计提了减值准备以后的期间内可回收金额超过了账面价值，减值损失可以在一定程度内转回。中国企业会计准则下，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。目标公司在报告期内未发生资产减值在计提的以后期间被转回的情形，因此上述差异对财务报表无重大影响。 除上述项目外，该项下目标公司的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。

	目标公司的主要会计政策	相应的中国企业会计准则摘要	差异分析及对目标公司按中国企业会计准则编制财务报表时的影响
	如果在以后期间可回收金额超过了账面价值，无形资产和物业厂房及设备的减值损失可以在以后的期间内在不超过原减值准备的限额内予以转回（商誉的减值损失除外）。	情况下，应当以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。企业按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，应当以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。 资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。 折现率应当是一个反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。它是企业在购置或者投资资产时所要求的必要报酬率。 可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。	
17	应付账款及其他应付款 应付账款及其他应付款按照名义金额计量。应付账款及其他应付款的公允价值与其账面金额不存在重大差异。	《企业会计准则第22号应用指南-金融工具确认和计量》： 根据本准则第八条规定，其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通	该项下目标公司的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。

	目标公司的主要会计政策	相应的中国企业会计准则摘要	差异分析及对目标公司按中国企业会计准则编制财务报表时的影响
		常采用摊余成本进行后续计量。	
18	计息的银行借款及其他借款 计息的银行借款及其他借款以公允价值减去相关交易费用初始计量。在初始计量后，计息的银行借款按照摊余成本计量，即成本和到期付款金额之间的差额按照实际利率法计入损益。融资成本，包括到期应付溢价及直接发行费用，按照实际利率法计算计入损益。 借款费用，在与需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态条件的资产的购置、生产、建造过程直接相关的限额内予以资本化，直至资产基本达到其预定可使用或可销售状态为止。	《企业会计准则讲解第23章-金融工具确认和计量》： 企业初始确认金融资产或金融负债时，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额，构成实际利息的组成部分。 企业应当按照以下原则对金融负债后续计量： 1．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。 2．不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量： （1）按照《企业会计准则第13 号——或有事项》确定的金额。 （2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。 3．上述金融负债以外的金融负债，应当按摊余成本后续计量。 《企业会计准则第17号-借款费用》： 企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期	该项下STATS ChipPAC的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。

	目标公司的主要会计政策	相应的中国企业会计准则摘要	差异分析及对目标公司按中国企业会计准则编制财务报表时的影响
		损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。	
19	权益工具 本公司发行的权益工具按照收到的对价减去相关发行成本的净额确认。	《企业会计准则第37号-金融工具列报》 企业发行权益工具收到的对价扣除交易费用（不涉及企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用）后，应当增加所有者权益；回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益。企业在发行、回购、出售或注销自身权益工具时，不应当确认利得或损失。	该项下目标公司的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。
20	收入确认 收入主要来自晶圆测试、晶圆凸块以及半导体集成电路的封装测试。收入净额按照销售的产品或提供的服务的发票金额减去预计退货及折让并减去产品及服务税的金额列示。 当产品或服务相关的所有主要风险及报酬转移给客户时，本集团确认收入。通常，当客户确认收到产品并没有争议时，本集团认为产品或服务相关的主要风险及报酬已转移。	《企业会计准则第14号-收入》及《企业会计准则讲解第15章-收入》： 销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认： (一)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； (二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； (三)收入的金额能够可靠计量； (四)相关经济利益很可能流入企业； (五)相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量。	目标公司对销售税金的列示方式与中国企业会计准则要求存在列报差异。根据目标公司的会计政策，销售税金直接抵减收入；中国企业会计准则下，销售税金不从营业收入中减除，而是作为主营税金及附加科目单独列示。该差异对净利润及净资产无重大影响。 目标公司对现金折扣的列示方式与

	目标公司的主要会计政策	相应的中国企业会计准则摘要	差异分析及对目标公司按中国企业会计准则编制财务报表时的影响
	本集团通常不获取客户提供半导体产品的所有权，因为这些材料只是委托给本集团的。因此客户提供材料的价值没有包含在营业收入或营业成本内。 本集团根据历史经验、对客户最终销售数量和客户付款时点的估计对预计销售退回及销售数量折让和现金折让计提准备，并作为营业收入的抵减项。个别的退回或折让在已知及金额可以估计时确认。	企业应当按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定商品销售收入金额，已收或应收的合同或协议价款显失公允的除外。应收的合同或协议价款与其公允价值相差较大的，应按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额，应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，应当在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。 销售商品涉及现金折扣的，应当按照扣除现金折扣前的金额来确认销售商品收入金额。现金折扣在实际发生时计入当期损益。现金折扣，是指债权人为鼓励债务人在规定的期限内付款而向债务人提供的债务扣除。 企业销售商品涉及现金折扣的，应当按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。现金折扣在实际发生时计入财务费用。 销售商品涉及商业折扣的，应当按照扣除商业折扣后的金额来确认销售商品收入金额。商业折扣是指企业为促进商品销售而在商品标价上给予的价格扣除。 企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，应当在发生时，冲减当期的销售商品收入。	中国企业会计准则要求存在列报方式的差异。根据目标公司的会计政策，现金折扣直接抵减收入；中国企业会计准则下，现金折扣计入财务费用。该差异对净利润及净资产无重大影响。 除上述项目外，目标公司的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。
21	补助 与用于研发的物业厂房及设备相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产的寿命期内按照直线法确认为收益。其他和培训、研究与开发相关的补助在相关的费用已经发生且将符合补助条件时确认为收益，这通常与费用发生的期间一致。	《企业会计准则第16号-政府补助》： 政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认： （一）企业能够满足政府补助所附条件； （二）企业能够收到政府补助。	该项下目标公司的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。

	目标公司的主要会计政策	相应的中国企业会计准则摘要	差异分析及对目标公司按中国企业会计准则编制财务报表时的影响
		与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理： （一）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。 （二）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。	
22	股份支付 本集团设立了可能将股份或股份购买权授予董事及员工的股份支付计划。股份支付的成本按照授予日的公允价值计量，并在等待期内按照直线法摊销计入损益。非市场条件的股权激励的公允价值按照本集团预计最终将可行权的股权或期权确认。本集团在每个资产负债表日对很可能在可行权日将可行权的的奖励数量进行估计。可行权日前的累计调整于当期予以确认。可行权日后公允价值不予以调整，即使奖励被取消或未被行使。	《企业会计准则第11号-股份支付》： 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量。权益工具的公允价值，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定。 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整；在可行权日，调整至实际可行权的权益工具数量。 企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。	该项下STATS ChipPAC的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。
23	员工福利计划	《企业会计准则第09号-职工薪酬》	

	目标公司的主要会计政策	相应的中国企业会计准则摘要	差异分析及对目标公司按中国企业会计准则编制财务报表时的影响
	本集团设立了包括不同的设定收益计划及设定提存计划在内的离职后福利。设定提存计划是指本集团向一个独立机构缴存固定费用的计划。在缴存固定费用后，本集团没有法律上或推定的进一步承担支付的义务。本集团在多个国家向设定提存计划缴存费用。 不符合设定提存计划的计划为设定受益计划。本集团的设定受益计划下，设定了员工在退休时根据其服务年限及最终薪水将获得的退休福利。虽然已设定了计划资产以为设定受益计划提供资金，本集团仍然将承担计划的相关义务。计划资产包括特别设定的长期福利基金以及符合条件的保险。 根据员工截至期末已经为本集团合并范围公司提供的服务，预计将不会在未来12个月内支付的职工福利按照预计未来现金流的现值确认。 短期员工福利包括周薪、月薪、年假及病假按照预计支付时的名义金额计量。	企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理： （一）应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入存货成本或劳务成本。 （二）应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。 （三）上述（一）和（二）之外的其他职工薪酬，确认为当期费用。 企业为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，应当在职工为其提供服务的会计期间，根据工资总额的一定比例计算，按照本准则第四条的规定处理。	截至2014年6月30日止已生效的中国企业会计准则对退休金及其他退休后福利相关规范较为简略，未对设定提存养老金计划的会计处理作出如同国际财务报告准则般的详尽规范。目标公司对于设定收益计划的处理原则，与中国企业会计准则中要求将应付职工薪酬在职工为其提供服务的期间确认为负债的原则是一致的，此事项不考虑为准则差异，因此本部分与中国企业会计准则无重大差异。
24	租赁 向所有权人支付以获取某项资产一定期间的使用权的协议按照租赁进行财务处理。将与所有权相关的风险和收益实质上予以转让的租赁为融资租赁，并在租赁开始时按照租赁资产的公允价值和最低付款额现值的孰低确认物业厂房及设备和负债。融资租赁付款区分为利息和本金两部分。其他租赁为经营租赁，无论租赁款是否直线法支付，租赁费用按照直线法确认。	《企业会计准则第21号-租赁》： 承租人和出租人应当在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。 融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。 在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值	该项下目标公司的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。

	目标公司的主要会计政策	相应的中国企业会计准则摘要	差异分析及对目标公司按中国企业会计准则编制财务报表时的影响
		与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。 未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人分摊未确认融资费用时，应当采用实际利率法。 对于经营租赁的租金，承租人应当在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。	
25	预计负债 当本集团存在由于过去的事项形成的、很可能将导致经济利益流出、金额能够可靠计量的现有义务（法律上的或者推定的）时，确认预计负债。预计负债在每个资产负债表日进行重新评估，以使其反映本集团目前的最佳估计。 根据销售合同，本集团在3-12个月内确保本集团的加工及制造没有由于人工、材料和制造而导致产品无法满足标明功能的瑕疵。虽然本集团在产品发出前按照特别的功能标准对产品进行测试，但仍不时收到在本集团质量保证期内的赔偿要求。本集团根据历史经验对质量保证的成本进行估计和预提，如果有特殊项目，则在本集团知道其存在且金额可以确定时确认。	《企业会计准则第13号-或有事项》： 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债： (一) 该义务是企业承担的现时义务； (二) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业； (三) 该义务的金额能够可靠计量。	该项下目标公司的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。
26	研究及开发 由于本集团无法明确区分为了创造无形资产的内部项目的研究阶段和开发阶段，本集团将在这些内部项目上的所	《企业会计准则第06号-无形资产》：	该项下目标公司的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。

	目标公司的主要会计政策	相应的中国企业会计准则摘要	差异分析及对目标公司按中国企业会计准则编制财务报表时的影响
	有支出视为在研究阶段的支出。因此所有的研究和开发费用均确认为费用。	企业内部研究开发项目的支出，应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。 企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。 第九条 企业内部研究开发项目开发阶段的支出，能够证明下列各项时，才能确认为无形资产： （一）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性； （二）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （三）无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； （四）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （五）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。	
27	所得税 在损益中确认的税费包括未在其他综合收益及权益中确认的递延所得税费用和当期所得税费用。当期所得税资产及/或负债包括向税务机关应付或从税务机关应收的、与当期或以前期间相关的、于资产负债表日应付或预计应付的金额。当期所得税费用是和应纳税所得相关的，与财务报表中的损益有所区别。当期所得税费用的计算取决于税率及财务报告期末已生效或实质上已生效的税法。	《企业会计准则第18号-所得税》： 企业应当将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。 存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，应当按照本准则规定确定递延所得税负债或递延所得税资产。	该项下目标公司的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。

	目标公司的主要会计政策	相应的中国企业会计准则摘要	差异分析及对目标公司按中国企业会计准则编制财务报表时的影响
	递延所得税资产和递延所得税负债是根据财务报表中资产和负债的账面价值与其计税基础的差异、可结转待抵扣亏损和税务优惠对未来纳税的影响而确认的。递延所得税资产及负债根据未来将实现时的税率（只要相关税法已经生效或实质上已生效）不折现计算。递延所得税负债以全额确认。递延所得税资产在未来很可能有的应纳税所得额的限额内确认。但是和商誉初始确认相关的递延所得税不确认，与某项资产或负债的初始确认相关的递延所得税也不确认，除非是和企业合并相关且影响应纳税额或会计利润。递延所得税资产和负债只有在本集团有权且有意图在同一个税务机关的管理下将相关的当期所得税资产及负债抵消时可以相互抵消。 在本集团的日常经营中，计算本集团的所得税余额存在内含的不确定性。本集团评估所得税状况，并根据对事实情况及相关信息的评估，确认税务收益。	资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，应当依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 资产负债表日，企业应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，企业应当确认所有应纳税暂时性差异产生递延所得税负债： (一) 商誉的初始确认； (二) 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认： 1. 该项交易不是企业合并； 2. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。 《企业会计准则讲解第19章-所得税》 企业核算所得税，主要是为确定当期应交所得税以及利润表中应确认的所得税费用。按照资产负债表债务法核算所得税的情况下，利润表中的所得税费用由两个部分组成：当期所得税和递延所得税。 当期所得税是指企业按照税法规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应交纳给税务部门的所得税金额，即应交所得税，当期所得税应以适用的税收法规为基础计算确定。 同时满足下列条件时，企业应当将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示。	

	目标公司的主要会计政策	相应的中国企业会计准则摘要	差异分析及对目标公司按中国企业会计准则编制财务报表时的影响
		1．企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利； 2．递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。	
28	每股收益 基本每股收益按照归属于目标公司普通股股东的净利润除以年度平均发行股份计算。稀释每股收益按照视同所有的潜在稀释性认股权已行使、其他稀释性证券例如可转换债券已转换计算。	企业应当按照归属于普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算基本每股收益。 企业存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的当期净利润和发行在外普通股的加权平均数，并据以计算稀释每股收益。稀释性潜在普通股，是指假设当期转换为普通股会减少每股收益的潜在普通股。	该项下目标公司的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。
29	分部报告 经营分部是反映一家企业的组成部分且该组成部分具有单独的财务信息，企业管理层(首席运营决策者)能够定期评价该组成部分的经营成果，以做出分配资源及评价成果的决策。本集团视本集团为一个分部。本集团在判断分部时考虑经营的发展和变化。	《企业会计准则讲解第36章-分部报告》： 经营分部，是指企业内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。	该项下目标公司的会计政策与中国企业会计准则无重大差异。

注：上表中的“本集团”指目标公司。

三、目标公司主要会计政策摘要

截至 2012 年 12 月 30 日止财务年度、截至 2013 年 12 月 29 日止财务年度和截至 2014 年 9 月 28 日止 9 个月期间的财务报表按照新加坡财务报告准则编制。

以下是在编制合并财务报表中采用的重要会计政策的汇总。（下文中“本集团”指目标公司。）

（一）会计年度

目标公司的 52—53 周的会计年度在接近且早于 12 月 31 日前的日期结束。目标公司的会计季度在周日结束，一般有 13 周长。2013 年度的会计年度为 52 周，结束于 2013 年 12 月 29 日，2012 年度的会计年度为 53 周，于 2013 年 12 月 30 日结束。除非有其他描述，所有年份的数据都是指目标公司的会计年度。

（二）合并和子公司

合并财务报表包括目标公司和其拥有多数权益的子公司，即被其控制的公司的合并财务报表。这个控制通常被指当本集团能够决定一个公司的财务和经营政策，从而从它的活动受益，或本集团直接或间接地拥有一个公司的多数投票股权，或通过合同协议控制，除非在特殊情况下，有证据表明所有权不构成控制。

子公司从其被收购日期开始合并，即本集团取得控制的日期，并一直合并直至该控制权终止之日。合并财务报表里的母公司及子公司的会计年度相同，且对子公司可能采用的与本集团会计政策的不同进行调整。本集团内所有的公司间往来、交易，包括由于集团内公司间交易产生的未实现利润，都予以全部抵消。未实现亏损也予以抵消，除非相应的成本无法回收。

少数股东损益和权益代表非由本集团持有的子公司的综合收益和净资产。

（三）企业合并

企业合并采用购买法。合并中获取的可辨认资产、负债和或有负债在合并日以公允价值计量。合并成本包括支付的现金对价、给付的其他资产、发行的权益工具及承担的债务的公允价值计量。合并相关的交易费用在成本发生及服务提供的期间内计入当期损益。合并成本大于合并中过得的可辨认资产、负债和或有负债的公允价值的部分确认为

商誉。

（四）存货

存货按照接近加权平均法下实际成本的标准成本和可变现净值孰低计量。成本以根据正常的产能利用下的标准成本计算，由于实际产能利用低于正常情况而发生的不可弥补的成本计入损益。可变现净值根据预计售价减去至完工时将要发生的成本及费用。对于持有过多以及陈旧的存货，根据预计可销售的情况和预计未来需求计算跌价准备。本集团通常不享有客户提供半导体产品的所有权，因此并未将这些产品记录为本集团的存货。

（五）无形资产

本集团将专利及技术使用权在外购或开发时发生的直接费用资本化。这些成本在使用期及授权期孰短的期间内摊销。此外，在企业合并中获取的无形资产按照购买法在合并日以公允价值于本集团的合并资产负债表内确认。本集团在估计公允价值时考虑一系列因素，包括评估、现金流折现分析、估计授权费率、以及合适的市场参照。

（六）物业厂房及设备

固定资产按照成本减除累计折旧和减值损失计量。处于装配及建设阶段的固定资产以及永久土地不计提折旧。常规的维修及更换在发生时计入费用。而可以延长固定资产使用寿命的维修及更换予以资本化。通过融资租赁获取的固定资产按照最低租赁付款额现值计量，并在预计寿命期内按照直线法计提折旧。

（七）收入确认

收入主要来自晶圆测试、晶圆凸块以及半导体集成电路的封装测试。收入净额按照销售的产品或提供的服务的发票金额减去预计退货及折让并减去产品及服务税的金额列示。

当产品或服务相关的所有主要风险及报酬转移给客户时，本集团确认收入。通常，当客户确认收到产品并没有争议时，本集团认为产品或服务相关的主要风险及报酬已转移。

本集团通常不获取客户提供半导体产品的所有权，因为这些材料只是委托给本集团

的。因此客户提供材料的价值没有包含在营业收入或营业成本内。

本集团根据历史经验、对客户最终销售数量和客户付款时点的估计对预计销售退回及销售数量折让和现金折让计提准备，并作为营业收入的抵减项。个别的退回或折让在已知及金额可以估计时确认。

（八）股份支付

本集团设立了可能将股份或股份购买权授予董事及员工的股份支付计划。股份支付的成本按照授予日的公允价值计量，并在等待期内按照直线法摊销计入损益。非市场条件的股权激励的公允价值按照本集团预计最终将可行权的股权或期权确认。本集团在每个资产负债表日对很可能在可行权日将可行权的的奖励数量进行估计。可行权日前的累计调整于当期予以确认。可行权日后公允价值不予以调整，即使奖励被取消或未被行使。

（九）研究及开发

由于本集团无法明确区分为了创造无形资产的内部项目的研究阶段和开发阶段，本集团将在这些内部项目上的所有支出视为在研究阶段的支出。因此所有的研究和开发费用均确认为费用。

四、目标公司最近两年及一期的财务报表

（一）目标公司最近两年及一期的合并财务报表

1、合并资产负债表

目标公司 2012 和 2013 年财务数据经 PricewaterhouseCoopers LLP (普华古柏会计师事务所有限合伙)审计，并根据新加坡会计准则编制，截止 2014 年 9 月底财务数据未经审计，根据新加坡会计准则编制。

单位：千美元	2014 年 9 月末	2013 年末	2012 年末
流动资产			
货币资金	115,609	129,136	170,558
短期定期存款	61,987	42,042	39,601
应收账款	229,728	238,441	258,043
其他应收款	33,785	15,239	20,726
存货	77,888	71,055	90,203

单位：千美元	2014 年 9 月末	2013 年末	2012 年末
预付费用以及其他流动资产	24,189	18,970	24,559
流动资产合计	**543,186**	**514,883**	**603,690**
非流动资产			
长期定期存款	425	11,604	489
固定资产净值	1,668,817	1,431,247	1,242,950
无形资产	34,599	35,117	36,361
商誉	381,487	381,487	381,487
递延所得税资产	185	186	-
预付费用以及其他非流动资产	3,405	3,146	3,299
非流动资产合计	2,088,918	1,862,787	1,664,586
资产总计	**2,632,104**	**2,377,670**	**2,268,276**
流动负债			
应付账款及其他应付款	185,181	138,004	164,301
应付固定资产相关款项	183,681	141,998	42,746
预提费用	105,189	124,640	113,476
应交所得税	14,518	18,207	13,155
短期借款	73,000	37,947	50,690
应付关联方款项	29	100	28
流动负债合计	**561,598**	**460,896**	**384,396**
非流动负债			
长期借款	1,064,314	874,281	792,609
递延所得税负债	46,559	47,476	47,141
其他非流动负债	15,663	24,228	21,532
非流动负债合计	1,126,536	945,985	861,282
负债合计	**1,688,134**	**1,406,881**	**1,245,678**
所有者权益			
股本	873,666	873,666	873,666
未分配盈余	26,198	51,478	98,971
其它公积	-9,389	-7,712	-1,828
归属母公司股东的所有者权益合计	890,475	917,432	970,809

单位：千美元	2014 年 9 月末	2013 年末	2012 年末
少数股东权益	53,495	53,357	51,789
所有者权益合计	943,970	970,789	1,022,598
负债与所有者权益合计	2,632,104	2,377,670	2,268,276

2、合并利润表

单位：千美元	截止 2014 年 9 月末	2013 年度	2012 年度
营业收入	1,179,160	1,598,522	1,701,549
营业成本	-1,044,751	-1,380,941	-1,414,045
毛利	134,409	217,581	287,504
运营费用			
销售管理费用	72,804	96,140	122,958
研发费用	30,273	46,432	51,722
重组支出	-	1,886	5,715
交换要约及赎回费用	-	15,701	-
债券发行注销费用	-	2,392	-
商誉减值损失	-	-	24,100
设备减值损失	3,713	-	3,819
运营费用合计	106,790	162,551	208,314
不含经常项目前的营业利润	27,619	55,030	79,190
工厂关闭成本	-	-36,909	-
洪水相关保险赔偿	-	19,582	26,741
洪水相关计划费用	-	-3,000	-10,061
扣除非经常项目的营业利润	27,619	34,703	95,870
其它收入（费用），净值			
利息收入	1,330	1,334	1,518
利息费用	-37,932	-54,459	-59,829
汇兑收益	-495	3,641	583
关联方损失份额	-	-	-739
其它非营业收入（费用），净值	238	-1,969	477
其它费用合计，净值	-36,859	-51,453	-57,990
税前利润/(损失）	-9,240	-16,750	37,880
所得税费用	-9,934	-22,329	-14,023

单位：千美元	截止 2014 年 9 月末	2013 年度	2012 年度
净利润/(损失）	-19,174	-39,079	23,857
减:归属于少数股权的净利润		-8,414	-7,294
归属于少数股东的净利润/(损失）	-25,280	-47,493	16,563
每股利润（美元）	-$0.01	-$0.02	$0.01

3、合并现金流量表

单位：千美元	2014 年 1-9 月	2013 年	2012 年
经营活动产生的现金净流量	**243,131**	**380,496**	**375,199**
购买固定资产及无形资产	-432,364	-413,377	-392,491
出售固定资产	4,494	3,927	4,099
投资活动产生的现金净流量	**-436,080**	**-412,681**	**-371,375**
归还银行或短期借款	-121,000	-235,483	-108,300
利息支付	-36,356	-55,750	-56,217
取得银行借款	341,445	314,731	139,300
筹资活动产生的现金净流量	**179,392**	**-9,221**	**-28,059**
现金及现金等价物的净增加（减少）	-13,557	-41,406	-24,235
现金及现金等价物期末余额	115,609	129,136	170,558

（二）目标公司母公司最近两年一期的财务报表

1、母公司简明资产负债表

单位：千美元	2014 年 9 月末	2013 年底	2012 年底
流动资产	590,625	632,037	659,882
非流动资产	1,287,738	1,253,687	1,179,744
总资产	1,878,363	1,885,724	1,839,626
流动负债	231,480	332,706	316,168
非流动负债	966,248	854,709	799,561
总负债	1,197,728	1,187,415	1,115,729
股东权益	680,635	698,309	723,897

2、母公司简明利润表

单位：千美元	截止 2014 年 6 月末	2013 年	2012 年
销售收入	241,319	439,775	451,408

单位：千美元	截止 2014 年 6 月末	2013 年	2012 年
毛利	45,708	93,132	115,304
经营利润（非经常项目前）	7,623	7,968	39,088
净利润	(10,284)	(25,235)	(13,214)

注：目标公司未披露 2014 年前三季度的母公司简明利润表

3、母公司简明现金流量表

单位：千美元	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年
经营活动产生的现金流量净额	22,933	113,505	236,631
投资活动产生的现金流量净额	(131,106)	(103,203)	(182,953)
筹资活动产生的现金流量净额	87,482	(32,957)	(23,229)
现金及现金等价物净增加额	(20,691)	(22,655)	30,449
期末现金及现金等价物期末余额	40,862	61,549	84,204

注：目标公司未披露 2014 年前三季度的母公司简明现金流量表

第十章 风险因素

一、本次交易相关的风险

（一）本次交易存在无法获得批准的风险

本次重大资产收购尚需取得必要备案或审批方可实施，包括但不限于：

（1）本公司股东大会批准本次交易及本次交易涉及的相关事宜；

（2）星科金朋股东大会批准减资及台湾子公司重组，以及根据永续证券条款修订星科金朋公司章程的相关事宜；

（3）新加坡法院批准星科金朋减资及台湾子公司重组；

（4）国家发改委、江苏省商务厅、所在地外汇管理部门关于本次交易的备案或审批；

（5）中国、美国、韩国等地的反垄断审查；

（6）台湾投审会批准台湾子公司剥离的相关事宜；

（7）其他必需的审批、备案或授权（如有）。

上述备案或核准事宜均为本次交易实施的前提条件，能否取得相关的批准、核准，以及最终取得该等批准、核准的时间存在不确定性。因此，本次重大资产收购能否最终成功实施存在不确定性。如果本次交易无法获得批准，本次交易可能被暂停、中止或取消。

（二）本次交易的法律、政策风险

本次交易涉及新加坡、中国大陆及台湾的法律和政策。本公司为中国注册成立的上市公司，而目标公司为新加坡注册的上市公司，且交易涉及剥离台湾子公司，因此本次收购须符合各地关于境外并购、外资并购的政策及法规，存在一定的法律风险。

二、业务整合风险

（一）交易整合风险

目标公司为一家境外公司，其主要资产、业务及工厂位于新加坡、韩国、台湾和上

海，与本公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、公司管理制度、企业文化等经营管理环境方面存在差异。此外，由于本次交易的涉及范围较广，待交易完成后，本公司在产品销售、技术研发、人力资源、管理等方面的整合到位尚需一定时间，因此存在本公司无法在短期内完成业务整合或业务整合效果不佳的风险。

（二）公司国际化经营人才储备不足的风险

本次交易完成后，公司为满足国际化经营的需要，应当建立一支具有丰富国际企业管理经验的人才队伍。倘若在未来期间国际化经营人才储备不能满足战略发展需求，公司存在相关整合计划因缺乏有效执行无法顺利推进的风险。此外，本次交易完成后本公司规模迅速扩大，如果内部机构设置和管理制度不能迅速跟进，将会对本公司经营造成不利影响。

三、目标公司经营风险

（一）行业波动的风险

本公司及目标公司的业务情况和盈利能力受半导体行业的景气状况影响较大，而半导体行业具有周期性波动的特点。

2008 年第四季度和 2009 年受金融危机影响，半导体行业景气度直线下降，跌至谷底；2010 年触底反弹，开始强劲复苏，而我国集成电路市场增速更领先于全球市场。2011 年受欧债危机影响，半导体行业全年景气度呈现前高后低的走势，2012 年延续 2011 年的低迷状态，行业整体在低谷徘徊。2013 年景气度有所回升。

半导体行业在发展过程中的波动会对本公司及目标公司的经营业绩产生一定影响。本公司将会密切关注市场需求动向，加快技术创新步伐，及时进行产品结构调整，降低行业波动给公司带来的经营风险。

（二）目标公司客户依赖风险

目标公司约有 70%的收入来源于美国市场，对大型客户存在一定的依赖性。如果收购完成后，不能和这些客户继续保持良好合作，目标公司销售将受很大影响。本次收购后，本公司将尽快与目标公司的现有主要客户展开沟通，确保客户关系的维持和平稳过渡。

（三）资产负债率较高的风险

目标公司资产负债率始终较高的水平，较高的利息支出也是导致其出现净亏损的原因之一。虽然长电科技不排除对目标公司进行债务替换，但相关方案仍有可能无法顺利实施，导致目标公司资本结构不能有效改善。存在目标公司短期内仍需负担较高的债务利息，营运现金流紧张从而影响执行市场扩张战略的风险。

四、其他风险

（一）股价波动的风险

除经营业绩和财务状况之外，本公司的股票价格还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、投资者预期和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资本公司的股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

（二）汇率波动风险

由于目标公司的日常运营中涉及美元、新元、欧元等多种货币，而本公司的合并报表采用人民币编制。伴随着人民币、美元、新元、欧元等货币之间的汇率变动，将可能给本次交易及公司未来运营带来汇兑风险。

（三）其他风险

本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

第十一章 独立董事及中介机构意见

一、独立董事对于本次交易的意见

根据《重组办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本次收购应当由本公司独立董事发表意见。

本公司的独立董事审阅了本次交易所涉及的相关议案；对议案进行了审议并听取了证券服务机构的汇报。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，对长电科技本次收购发表如下独立意见：

（一）本次交易有利于长电科技提升行业地位，获取先进封装技术，扩大业务规模，有利于公司长远持续发展，从根本上符合公司和全体股东的利益。

（二）本次交易涉及的相关境内的协议及信息披露文件符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司在新加坡市场发出的要约符合新加坡市场的相关规定。本次交易的方案具备可操作性。

（三）本次交易的相关议案已经公司第五届第二十三次临时董事会审议通过，还需提交公司股东大会表决通过。上述董事会会议的的召集召开、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定。为保障公司全体社会公众股股东能够充分行使权利，公司将向全体股东提供网络投票平台。上述程序合法有效，不会损害公司股东的利益，对中小股东公平、合理。

（四）本次交易价格乃基于公平合理的原则，通过谈判确定，并已综合考虑了多方面的影响因素，交易价格合理公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（五）本次交易符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。

（七）本次交易聘请的审计机构具有证券业务资格；该等机构与长电科技及目标公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的报告符合客观、独立、公正、科学的原则。

二、中介机构对于本次交易的意见

（一）独立财务顾问意见

中金公司作为本次交易的独立财务顾问，按照《证券法》、《公司法》、《重组办法》和《财务顾问业务指引》的相关规定和中国证监会的要求，通过对重组报告书等信息披露文件的适当核查，并与本次交易的境内外法律顾问、审计师经过充分沟通后认为：

“本次交易符合有关法律、法规和政策的规定，按照《重组办法》、《上市规则》履行了必要的信息披露程序；本次交易已经长电科技第五届董事会第二十三次会议通过，独立董事为本次交易事项出具了独立意见；本次交易定价合理、公允，不存在损害上市公司和全体股东的合法权益的情形；有利于提高上市公司行业地位、研发能力和综合竞争力，促进上市公司的长远发展，符合上市公司和全体股东的利益。”

（二）法律顾问意见

公司聘请江苏世纪同仁律师事务所作为本次交易的境内法律顾问。根据江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书，对本次交易的总体结论性意见如下：

“一、本次交易方案的内容符合法律、法规、规范性文件的有关规定。

二、上市公司就本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，本次交易的实施尚有待于其他条件的满足。

三、截至法律意见书出具日，上市公司的信息披露符合有关法律、法规及规范性文件的规定；其尚需根据本次交易的进展情况，按照相关法律法规的规定持续履行相关信息披露义务。

四、参与本次交易活动的证券服务机构均具有国家法律、法规、规章及其他规范性文件规定的从事本次交易的必要资格、资质。”

第十二章 本次交易相关证券服务机构

一、独立财务顾问

独立财务顾问：中国国际金融有限公司

法定代表人：丁学东

办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

电话：(86) 10 6505 1166

传真：(86) 10 6505 1156

财务顾问主办人：孙莹、郑天

财务顾问协办人：秦雨清

二、中国法律顾问

中国法律顾问：江苏世纪同仁律师事务所

事务所负责人：王凡

办公地址：南京市中山东路 532-2 号 D 幢 5 楼

电话：025-8331 6106

传真：025-8332 9335

签字律师：阚赢 、邵斌

三、会计师事务所

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所负责人：杨绍信

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

电话：021-2323 8888

传真：021-2323 8800

签字会计师：赵波、宋佳骏

四、新加坡财务顾问

1、新加坡财务顾问（一）：中国国际金融（新加坡）有限公司

办公地址：#39-01, 6 Battery Road, Singapore 049909

电话：+65 6572 1999

传真：+65 6327 1278

项目负责人：林曦

2、新加坡财务顾问（二）：Deutsche Bank AG, Singapore branch

办公地址：One Raffles Quay South Tower Level 17 Singapore 048583

电话：+65 6423 8001

传真：+65 6225 9442

项目负责人：Mayooran Elalingam

五、境外法律顾问

1、国际法律顾问

国际法律顾问：Herbert Smith Freehills LLP

办公地址：50 Raffles Place, #24-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623

电话：+65 6868 8000

传真：+65 6868 8001

项目负责人：Michael Walter

2、新加坡法律顾问

新加坡法律顾问：Drew & Napier LLC

办公地址：10 Collyer Quay #10-01 Ocean Financial Centre, Singapore 049315

电话：+65 65350733

传真：+65 65354864

项目负责人：Sandy Foo / Farhana Siddiqui

3、台湾法律顾问

台湾法律顾问：常在国际法律事务所

办公地址：台北市 106 敦化南路一段 245 号八楼

电话：+ 886 2 2781 4111

传真：+ 886 2 2721 3834

项目负责人：林嘉慧、陈建宇

第十三章 董事会及相关中介机构声明与承诺

一、本公司董事声明

本公司全体董事承诺保证《江苏长电科技股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要的内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

_____	_____	_____
王新潮	沙智慧	沈阳
_____	_____	_____
朱正义	王元甫	蒋守雷
_____		
范永明		

江苏长电科技股份有限公司

年 月 日

二、独立财务顾问声明

中金公司同意《江苏长电科技股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要引用本公司出具的独立财务顾问报告的内容，且所引用内容已经本公司及本公司经办人员审阅，确认《江苏长电科技股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（或其授权代表人）：_____

林寿康

投资银行业务部门负责人：_____

黄朝晖

内核负责人：_____

石芳

独立财务顾问主办人：_____ _____

孙莹 郑天

项目协办人：_____

秦雨清

中国国际金融有限公司

年 月 日

三、法律顾问声明

本所及本所经办律师同意《江苏长电科技股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要引用本所出具的法律意见书的内容，且所引用内容已经本所及本所经办律师审阅，确认《江苏长电科技股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人（签名）：_____

王 凡

经办律师（签名）：

_____ _____

阚 赢 邵 斌

江苏世纪同仁律师事务所

年 月 日

四、审计机构声明

本所及签字注册会计师同意贵公司在本次重大资产购买报告书引用本所对贵公司管理层编制的 STATS ChipPAC Ltd. 截至 2012 年 12 月 30 日财务年度、2013 年 12 月 29 日财务年度及 2014 财务年度截至 2014 年 9 月 28 日止期间根据新加坡财务报告准则编制财务报表时采用的主要会计政策与中国企业会计准则(包括财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定)相关规定之间的差异情况说明出具的鉴证报告。

本所及签字注册会计师确认重大资产购买报告书不致因完整准确地引用本所出具的上述报告而导致在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述报告的真实性、准确性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：_____

李丹

签字注册会计师：_____

赵波

_____

宋佳骏

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

年 月 日

第十四章 备查文件及备查地点

一、备查文件

1、要约人对星科金朋发出的附生效条件的要约

2、长电科技、要约人与星科金朋签署的《要约执行协议》

3、长电科技与产业基金、芯电半导体共同签署的《共同投资协议》

4、长电科技、新潮集团与产业基金签署的《售股权协议》

5、长电科技、新潮集团与芯电半导体签署的《投资退出协议》

6、长电科技第五届第二十次、第二十二次、第二十三次临时董事会决议

7、目标公司第一大股东 STSPL 出具的不可撤销承诺函

8、长电科技、新潮集团与目标公司签署的分手费契约

9、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会计准则差异鉴证报告

10、中国国际金融有限公司出具的独立财务顾问报告

11、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书

12、中国银行为本次交易之目的所出具的承诺函

二、备查文件查阅方式

投资者可在下列地点、报纸或者网址查阅本报告书和有关备查文件：

1、江苏长电科技股份有限公司

地点：江苏省江阴市澄江镇长山路 78 号

联系人：朱正义

电话：0510-86856061

传真：0510-86199179

2、中国国际金融有限公司

地点： 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人：王子龙、刘书林、孙莹、郑天、赵心怡、秦雨清

电话：010-6505 1166

传真：010-6505 1156

3、指定信息披露报刊：上海证券报、中国证券报

4、指定信息披露网站：投资者可在中国证监会指定网站 http://www.sse.com.cn 查阅本报告书全文。

(本页无正文，为《江苏长电科技股份有限公司重大资产购买报告书》盖章页)

江苏长电科技股份有限公司

年 月 日